

股票简称：艾森股份

股票代码：688720

江苏艾森半导体材料股份有限公司

(Jiangsu Aisen Semiconductor Material CO., LTD.)

(江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号)



向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

(申报稿)

保荐机构（主承销商）



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

公告日期：2026 年 8 月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请东方金诚对本次发行的可转债进行了信用评级，根据东方金诚出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 AA_{sti} ，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA_{sti} 。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债

券可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况

根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人员对本次可转债发行的相关事项说明及承诺如下：

（一）公司持股 5%以上股东的认购情况

公司 5%以上的股东张兵、蔡卡敦及宁波艾森将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、本企业/本人及本人配偶、父母、子女将在满足相关法律法规要求的前提下，根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购。如本企业/本人参与本次可转债认购的，本企业/本人承诺相关资金为本企业/本人合法自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案及本企业/本人届时资金状况确定。

2、若本企业/本人及本人配偶、父母、子女参与本次可转债的发行认购并认购成功，自本企业/本人及本人配偶、父母、子女完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减持所持有的公司可转债。

3、本企业/本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式进行违反《证券法》及其他相关规定买卖公司股票或可转换公司债券的行为，不实施或变相实施短线交易等违法违规行为。

4、若本企业/本人及本人配偶、父母、子女出现未能履行上述承诺的情况，由此所得收益归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（二）公司董事、高管参与本次可转债的认购情况

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、本企业/本人及本人配偶、父母、子女将在满足相关法律法规要求的前

提下，根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购。如本企业/本人参与本次可转债认购的，本企业/本人承诺相关资金为本企业/本人合法自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案及本企业/本人届时资金状况确定。

2、若本企业/本人及本人配偶、父母、子女参与本次可转债的发行认购并认购成功，自本企业/本人及本人配偶、父母、子女完成本次可转债认购之日起六个月内，不得以任何方式减持所持有的公司可转债。

3、本企业/本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式进行违反《证券法》及其他相关规定买卖公司股票或可转换公司债券的行为，不实施或变相实施短线交易等违法违规行为。

4、若本企业/本人及本人配偶、父母、子女出现未能履行上述承诺的情况，由此所得收益归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

公司独立董事不参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、本人承诺本人及本人配偶、父母、子女将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

2、本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式进行违反《证券法》及其他相关规定买卖公司股票或可转换公司债券的行为，不实施或变相实施短线交易等违法违规行为。

3、本人及本人配偶、父母、子女放弃本次可转债发行认购系真实意思表示，若本人及本人配偶、父母、子女出现未能履行上述承诺的情况，由此所得收益归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）半导体行业周期风险

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果

宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对电子化学品需求的下降。若全球经济增速放缓、AI 算力需求不及预期，或消费电子、汽车电子等下游市场再度疲软，将直接导致半导体产品需求下滑，进而影响公司光刻胶、电镀液等核心材料的订单量与产品价格。如果由于贸易摩擦等因素引致下游市场整体波动，亦或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

（二）市场竞争的风险

基于下游市场需求，发行人围绕电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大业务板块推出多款产品，其他国内竞争对手也在持续增加研发投入、扩建产能或推出新产品参与市场竞争。同时，半导体下游客户对电镀液、光刻胶等产品的可靠性和稳定性要求极高，更换供应商难度较大，公司与国际巨头争夺高端市场，面临无法抢占其市场份额的竞争风险。如果公司不能根据市场需求持续更新技术和开发产品、降低产品成本、保持产品和技术竞争力，公司可能无法与国内外企业进行有效竞争，从而对公司的市场份额、市场地位、经营业绩造成不利影响。

（三）募投项目产品产业化风险

本次募投项目中，“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”产品包括光刻胶及湿电子化学品两大品类。其中，光刻胶包括先进封装光刻胶、晶圆制造光刻胶、新型显示用光刻胶以及相关配套树脂；湿电子化学品则包括蚀刻液、清洗液等，其中部分产品为公司光刻胶、电镀液业务所研发迭代的新产品。虽然公司已对该募投项目进行了较为充分的可行性论证，但若未来公司客户认证进展不及预期，无法获得充足的客户订单，受技术迭代影响市场需求或单价下降等，可能存在部分新增产能无法消化、项目效益不及预期等风险，进而对公司业绩产生不利影响。

（四）募投项目建设进度或收益不及预期、无法充分实施的风险

在本次募投项目实施过程中，若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，或因产品研发及新客户审核认证进展不及预期等因素，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司本次募

投资项目将会存在不能全部按期建设完成或不能顺利实施的风险。此外，若工程进度、项目质量、产能消化、产业政策、市场需求等方面出现不利变化，将可能导致项目周期延长或项目收益低于预期，进而对公司经营业绩产生不利影响。

六、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况

（一）公司现行利润分配政策

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规对于利润分配政策的规定，本公司《公司章程》规定的利润分配政策如下：

“第一百六十五条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配政策的具体内容及条件

1、利润分配原则：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2、利润分配的形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。

3、公司现金分红的政策目标、具体条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的情况下，公司现金分红的政策目标为每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%；

(3) 中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

4、公司发放股票股利的具体条件：根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

5、利润分配的期间间隔：公司可以进行年度或中期分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。

6、其他：当公司发生以下情形的，可以不进行利润分配：

(1) 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

(2) 分红年度资产负债率高于 70%；

(3) 经营性现金流为负；

(4) 其他不利于公司日常经营的情况。

(二) 公司制定利润分配方案的决策程序及机制

公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大

资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，并提交股东会审议决定。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会审议利润分配方案时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

（三）公司调整利润分配政策的决策程序及机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东会审议。

股东会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。”

（二）本次发行前后公司股利分配政策变化情况

本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

（三）公司最近三年股利分配制度的执行情况

1、最近三年利润分配方案

（1）公司 2025 年度利润分配方案

2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 9,568,823.22 元（含税）。

（2）公司 2024 年度利润分配方案

2024 年 9 月 2 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,952,901.75 元（含税）。

（3）公司 2023 年度利润分配方案

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 13,176,339.15 元（含税）。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	5,123.78	3,347.75	3,265.73
现金分红金额（含税）	956.88	395.29	1,317.63
现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	18.68%	11.81%	40.35%
以现金方式回购股份金额	20.00	6,001.41	-
最近三年现金分红金额小计（含税）	8,691.22		
最近三年年均可分配利润	3,912.42		
最近三年现金分红金额占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比率	222.14%		

综上，公司最近三年现金分红情况符合公司章程的规定，亦符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》对现金分红的相关要求。

3、公司最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司正常生产经营。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风 险.....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项.....	2
四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况	3
五、特别风险提示.....	4
六、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况.....	6
目 录.....	11
第一节 释 义	14
第二节 本次发行概况	17
一、公司基本情况.....	17
二、本次发行的背景和目的.....	17
三、本次发行的基本情况.....	20
四、本次发行的有关机构.....	34
五、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.....	35
第三节 风险因素	36
一、与发行人相关的风险.....	36
二、与行业相关的风险.....	38
三、其他风险.....	38
第四节 发行人基本情况	43
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况.....	43
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.....	43
三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.....	44
四、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况.....	50
五、承诺事项及履行情况.....	52
六、董事、高级管理人员及其他核心人员.....	55

七、发行人所处行业的基本情况.....	65
八、发行人主要业务的有关情况.....	74
九、与产品或服务有关的技术情况.....	87
十、主要固定资产及无形资产.....	92
十一、上市以来的重大资产重组情况.....	102
十二、境外经营情况和境外资产情况.....	102
十三、报告期内的分红情况.....	102
十四、最近三年已公开发行人公司债券或者其他债务是否有违约或者延迟支付本息的情形.....	106
十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息.....	106
第五节 财务会计信息与管理层分析	107
一、审计意见.....	107
二、财务报表.....	107
三、主要财务指标.....	114
四、会计政策变更和会计估计变更.....	116
五、财务状况分析.....	117
六、经营成果分析.....	138
七、现金流量分析.....	150
八、资本性支出分析.....	153
九、技术创新分析.....	154
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	158
十一、本次发行的影响.....	158
第六节 合规经营与独立性	159
一、报告期内发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况.....	159
二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.....	160
三、同业竞争情况.....	160
四、关联方和关联交易.....	161
第七节 本次募集资金运用	168

一、募集资金运用的基本概况.....	168
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性.....	168
三、本次募集资金投资项目的具体情况.....	172
四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	175
五、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系.....	176
六、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性.....	176
七、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....	177
八、本次募集资金投资项目的资本化情况.....	178
第八节 历次募集资金运用	180
一、最近五年内募集资金运用的基本情况.....	180
二、前次募集资金运用情况.....	181
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....	184
四、会计师事务所对前次募集资金运用出具的专项报告结论.....	185
第九节 声明	186
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明.....	186
二、发行人审计委员会成员声明.....	188
三、发行人控股股东、实际控制人声明.....	189
四、保荐机构声明.....	190
五、发行人律师声明.....	192
六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明.....	193
七、为本次发行承担债券信用评级业务的机构声明.....	194
八、董事会声明.....	195
第十节 备查文件	196

第一节 释 义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般释义		
艾森股份/本公司/公司/发行人	指	江苏艾森半导体材料股份有限公司
募集说明书	指	《江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
本次发行/本次向不特定对象发行可转换公司债券	指	江苏艾森半导体材料股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
本次可转债	指	本次发行的可转换公司债券
股东会	指	江苏艾森半导体材料股份有限公司股东会
董事会	指	江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
公司章程	指	《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》
尽职调查报告	指	《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》
信用评级报告	指	东方金诚国际信用评估有限公司出具的《江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》
受托管理协议	指	《江苏艾森半导体材料股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》
募集资金管理制度	指	《江苏艾森半导体材料股份有限公司募集资金管理制度》
艾森世华	指	昆山艾森世华光电材料有限公司，公司全资子公司
南通艾森	指	艾森半导体材料（南通）有限公司，公司全资子公司
武汉艾森	指	武汉艾森晶合半导体有限公司（曾用名：武汉艾森半导体有限公司），公司全资子公司
新加坡艾森	指	INOFINE PTE.LTD.，公司全资子公司
INOFINE	指	INOFINE CHEMICALS SDN BHD，公司控股子公司
艾森芯材	指	南通艾森芯材科技有限公司，公司全资子公司
宁波艾森	指	宁波艾森企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“昆山艾森投资管理企业（有限合伙）”）
宁波艾龙	指	宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）”）
报告期/最近三年	指	2023年度、2024年度及2025年度
保荐人、主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
申报会计师、上会会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、方达	指	上海市方达律师事务所
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
境外法律意见书	指	CHRISTOPHER & LEE ONG（马来西亚律师）于2026年7月31日就INOFINE的相关情况出具的法律意见书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业释义		
芯片、集成电路（IC）	指	Integrated Circuit，缩写为IC；或称微电路（microcircuit）、微芯片（microchip）、晶片/芯片（chip），在电子学中是一种将电路小型化的方式。IC是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
晶圆（wafer）	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品
半导体	指	广义的半导体产业包括集成电路、平板显示、太阳能光伏、半导体照明等行业，上述行业均应用了半导体制造工艺
被动元件	指	无源器件，主要包括电阻，电容，电感等
新型电子元件	指	传感器、片式元器件、光电子器件等
传统封装	指	先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列直插封装（SIP）、双列直插封装（DIP）、小外形封装（SOP）、小晶体管外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）、双平面无引脚封装（DFN）、方形扁平无引脚封装（QFN）、方型扁平式封装技术（QFP）等封装形式
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、2.5D封装、3D封装等均被认为属于先进封装范畴
湿化学用品	指	微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料
电镀液	指	可以扩大金属的阴极电流密度范围、改善镀层的外观、增加溶液抗氧化的稳定性等特点的液体；通常由主盐、导电盐、添加剂及溶剂等构成
光刻	指	通过涂胶、曝光、显影等工艺，利用化学反应进行微细加工图形转移的技术工艺
显影	指	使已曝光的感光材料显出可见影像的过程
蚀刻	指	将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。通过曝光制版、显影后，将要蚀刻区域的保护膜去除，在蚀刻时接

		触化学溶液，达到溶解腐蚀的作用，形成凹凸或者镂空成型的效果
微凸点/Bumping	指	一种先进封装工艺，在晶圆表面制作凸点以实现芯片电气连接，Bumping工艺提高封装密度，具有高性能、高可靠性的特点
混合键合	指	指金属键合（业界主流为铜-铜键合）与熔融键合混合进行的键合方法。混合键合是一种扩展的熔融键合，主要应用于先进逻辑芯片、存储芯片和图像处理器芯片的三维堆叠
Chiplet	指	芯粒，指预先制造好、具有特定功能、可组合集成的晶片
RDL	指	Re-distributed layer，重布线层，一种先进封装工艺。在晶圆表面沉积金属层和相应的介质层，并形成金属布线，对I/O端口进行重新布局，将其布局到新的、占位更为宽松的区域
2.5D/3D封装	指	基于TSV技术，垂直堆叠称为3D封装，互联堆叠称为2.5D封装
HBM	指	High Bandwidth Memory的缩写，即高带宽存储器，是一种基于3D堆栈工艺的高性能动态随机存取存储器，适用于高存储器带宽需求的应用场合
CoWoS	指	Chip-on-Wafer-on-Substrate，将CoW与基板连接，一种先进封装形式
CMP	指	化学机械抛光，是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术
TSV	指	Through Silicon Via，硅通孔技术
TGV	指	Through Glass Via，玻璃通孔技术
光刻胶	指	经光照后，在曝光区能很快地发生光交联或者光分解反应，使树脂的溶解度发生变化的耐蚀刻涂层材料。光刻胶是利用化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由感光树脂、增感剂（见光谱增感染料）和溶剂三种主要成分组成的对光敏感的混合液体
PSPI	指	光敏性聚酰亚胺，拥有优异的热稳定性、良好的机械性能、化学和感光性能，同时具备电介质层以及光刻胶功能
正性光刻胶	指	正胶经过曝光后，受到光照的部分变得容易溶解，经过显影后被溶解，只留下未受光照部分形成图形
负性光刻胶	指	负胶经过曝光后，受到光照的部分变得不易溶解，经过显影后，留下光照部分形成图形
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管
阵列制造	指	半导体显示前段制程，将薄膜电晶体制作于玻璃上，主要包含成膜、微影、蚀刻和检查等步骤
PCB	指	Printed Circuit Board，印刷电路板，是电子元器件的支撑体，并为电子元器件提供电气连结
HDI	指	High Density Interconnect，即“高密度互连”，一种采用细线路、微小孔、薄介电层的高密度印制电路板技术
SLP	指	Substrate-like PCB，指类载板，接近用于半导体封装的IC载板

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司

英文名称：Jiangsu Aisen Semiconductor Material CO., LTD.

注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号

股票简称：艾森股份

股票代码：688720

股票上市交易所：上海证券交易所

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策大力支持高端电子化学品行业的发展

国家高度重视高端电子化学品产业发展，出台一系列政策文件与扶持措施，形成全方位支持体系。在顶层设计层面，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将高端电子化学品纳入鼓励类范畴，明确支持关键核心技术攻关与产业化落地；《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》专门提出加快发展电子化学品等高端材料，助力战略性新兴产业升级。在资金支持方面，国家集成电路产业投资基金（大基金）三期拟投入 500 亿元推动“材料-设备-晶圆厂”联合研发，重点支持光刻胶、超纯电子化学品等品类的研发与量产，缩短验证周期。

2、下游应用领域发展，产品市场空间广阔

当前，全球半导体材料市场在经历 2023 年的周期性回调后，正步入新一轮增长周期。与此同时，AI 产业的爆发式增长也正从“算力、存储、互联”三维重构半导体材料需求，形成“周期复苏+技术创新”的双重增长引擎，直接驱动半导体材料需求呈现“量价齐升+结构升级”的双重发展空间。

根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的报告，2025 年全球半导体材料市场规模约 730 亿美元，其中，AI 相关需求贡献超 30%增量，成为行业增长的核心

心驱动力。2026-2030 年预计复合增速达到 8.5%-12%，其中先进封装材料与第三代半导体增速最快。

3、高端光刻胶供应链安全问题日益凸显

光刻胶是半导体制造的核心关键材料。当前，全球高端电子化学品市场长期被日本 JSR、东京应化、信越化学及巴斯夫等少数企业垄断，尤其是高端光刻胶、光刻胶配套树脂等国内自给率极低，存在严重的供应链安全风险。特别是高端产品对华配额缩减、部分品类供应归零，直接造成国内高端光刻胶生产原料短缺、成本上涨、产能受限三大问题，海外供应链不确定性大幅提升，国内半导体供应链安全风险凸显。

（二）本次发行的目的

1、完善公司高端产品产业化布局，提升公司竞争力

本次募集资金投资项目主要投向光刻胶、光刻胶配套树脂及湿电子化学品等高端产品的产能建设，是公司深化战略布局、响应市场需求、构筑核心竞争壁垒的关键举措。本次项目建成后，将形成光刻胶及配套树脂、湿电子化学品共计 13,000 吨/年的产能规模，产品覆盖多型号光刻胶、光刻胶配套树脂以及湿电子化学品，将大幅提升公司在先进封装及晶圆制造领域高端电子化学品的量产能力，强化公司在核心高端材料领域的产能支撑，从而进一步优化公司产品结构，实现向高附加值、高技术壁垒产品的战略升级。

通过本次项目实施，公司将进一步强化光刻胶树脂等关键原材料的自产能力，增强对下游半导体核心客户的综合服务能力，提升客户粘性与合作深度。同时，规模化产能将有效降低单位生产成本，强化公司在产品定价、市场份额争夺中的竞争优势，显著提升核心市场竞争力与行业影响力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

2、把握市场发展机遇，培育业绩增长新动能

当前，AI 芯片、高带宽存储（HBM）、数据中心光互联（CPO）等市场持续快速扩张。在三维集成与先进封装行业的高速发展下，先进封装对光刻胶及配套试剂的需求逻辑已发生根本性转变。过去，光刻胶需求主要跟随封装产量线性增长；如今，堆叠层数每翻一番，光刻工艺次数便大致翻倍，形成超线性增长的

乘数效应。HBM 正从 8 层向 12 层、16 层演进，SK 海力士已展出全球首款 16 层 HBM4 样品。每一层 DRAM 堆叠都需要独立的光刻工艺，堆叠层数的指数级增长，直接驱动光刻胶及配套试剂的需求量呈超线性扩张。先进封装对光刻胶及配套试剂的需求逻辑，已从线性增长彻底转向以堆叠层数为自变量的超线性扩张新范式。

公司在先进封装光刻胶及电镀液领域深耕多年，已构建起从核心材料研发、配方优化到工艺量产的全链条成熟体系，技术储备与产业化能力处于行业前列。通过持续研发投入，公司已形成覆盖先进封装全部工艺环节的产品矩阵，产品关键性能指标已达到国际同类先进产品水平，可充分匹配下游先进封装技术路线的应用需求。同时，经过长期技术验证与合作磨合，公司已与长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微等国内头部封测厂商建立稳定合作关系，产品通过客户批量验证并实现常态化供货，获得下游市场高度认可。

本次募集资金投资项目将进一步扩大先进封装相关高端产品的产能规模，优化生产工艺与供应链布局，精准匹配下游客户在 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进技术路线下的需求增长。依托在细分领域的技术先发优势与客户资源积累，公司可快速抢占先进封装电子化学品增量市场份额，将技术优势转化为市场竞争力与盈利增长力。同时，高附加值的先进封装配套产品将持续提升公司整体营收规模与盈利水平，培育形成可持续的业绩增长新动能，为公司实现跨越式发展注入核心动力。

3、加速自主创新进程，保障供应链安全

光刻胶是半导体制造的核心关键材料。当前，全球高端电子化学品市场长期被日本 JSR、东京应化、信越化学及巴斯夫等少数企业垄断，尤其是高端光刻胶、光刻胶配套树脂及高纯度电子化学品，国内自给率极低，存在严重的供应链安全风险。

本次募集资金投资项目精准聚焦高端光刻胶及配套树脂、湿电子化学品两大核心品类。其中，光刻胶及配套树脂包括先进封装光刻胶、晶圆制造光刻胶、新型显示光刻胶以及相关配套树脂；湿电子化学品则包括蚀刻液、清洗液等。

依托公司多年积累的核心技术储备、成熟产业化经验及下游客户资源，项目

建成后将实现上述高端产品的规模化、高质量量产，显著提升国内高端电子化学品的自给率，降低国内半导体企业对进口材料的依赖度，保障我国半导体产业链供应链高质量发展。

三、本次发行的基本情况

（一）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行数量、证券面值、发行价格或定价方式

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 51,400.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（三）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额、募集资金专项存储的账户

本次可转债发行预计募集资金总额不超过人民币 51,400.00 万元（含），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

公司已经建立《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。

（四）募集资金投向

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 51,400.00 万元（含），拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）	67,320.00	47,400.00
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
	合计	71,320.00	51,400.00

若扣除发行费用后的本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（五）发行方式与发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（六）承销方式及承销期

本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销。承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（七）发行费用

本次发行费用总额为【】万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	保荐及承销费	【】
2	律师费用	【】
3	审计及验资费	【】
4	资信评级费用	【】
5	发行手续费用、信息披露及其他费用	【】
	合计	【】

（八）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行的主要日程安排如下：

交易日	项目
T-2 日	刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》
T-1 日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演
T 日	1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先配售认购日 3、网下、网上申购日
T+1 日	1、刊登《网上中签率及网下配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
T+2 日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 3、网下投资者根据配售金额缴款
T+3 日	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日	刊登《发行结果公告》

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。申请上市的证券交易所为上海证券交易所。

（九）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。

本次发行的证券不设持有期限限制。

（十）本次发行可转债的基本条款

1、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

2、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

3、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董

事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

4、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

5、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

6、转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额÷该日公司 A 股股票交易总量。

7、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； k 为增发新股或配股率； A 为增发新股价或配股价； D 为每股派送现金股利； P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

8、转股价格向下修正条款

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，将在上交所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

9、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： Q 为转股数量， V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次发行可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及对应的当期应计利息。

10、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额

额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

本次可转换公司债券的赎回条款由股东会授权董事会与保荐人及主承销商在发行前最终协商确定。

11、回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“10、赎回条款”的相关内容。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“10、赎回条款”的相关内容。

可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

12、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

13、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

14、向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

15、债券持有人会议相关事项

（1）本次可转换公司债券持有人的权利

- ①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- ②根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司A股股票；
- ③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
- ⑥按照《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）本次可转换公司债券持有人的义务

- ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- ④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- ⑤法律法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（3）可转换公司债券持有人会议召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，应当召集可转换公司债券持有人会议：

- ①拟变更《募集说明书》的约定；
- ②拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
- ③拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- ④公司不能按期支付本次可转换公司债券的本息；
- ⑤公司减资（因实施股权激励或员工持股计划回购股份、业绩承诺回购股份或者公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
- ⑥公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- ⑦担保人或担保物（如有）发生重大变化；
- ⑧公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人及债券受托管理人书面提议召开；
- ⑨公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性
- ⑩公司提出重大债务重组方案的；
- ⑪发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
- ⑫根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当召开债券持有人会议的其他情形。

（4）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

- ①公司董事会；
- ②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
- ③债券受托管理人；
- ④法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

16、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

17、评级事项

本次可转换公司债券经东方金诚评定，根据东方金诚出具的《信用评级报告》，艾森股份主体信用等级为 AA_{sti}，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA_{sti}。

在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。

（十一）本次可转债的受托管理事项

公司聘任华泰联合证券作为本次可转换公司债券的受托管理人，并同意接受华泰联合证券的监督。在本次可转换公司债券存续期内，华泰联合证券将根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》《受托管理协议》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，行使权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转换公司债券视作同意华泰联合证券作为本次可转换公司债券的受托管理人，并视作同意《受托管理协议》项下的相关约定及可转换公司债券持有人会议规则。

（十二）构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

1、违约情形

以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事件：

（1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

（2）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

(4) 在本期可转债存续期间内, 公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序;

(5) 任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决, 或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令, 或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法;

(6) 在本期可转债存续期间, 公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及承担方式

上述违约事件发生时, 公司应当承担相应的违约责任, 包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等, 并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议, 首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成, 双方约定通过向受托管理人住所所在地有管辖权人民法院提起诉讼方式解决争议。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时, 除争议事项外, 各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利, 并应履行其他义务。

(十三) 本次发行可转债规模合理性分析

截至本募集说明书签署日, 公司不存在任何形式的公司债券。截至 2025 年 12 月 31 日, 发行人合并口径净资产为 103,462.84 万元, 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 51,400.00 万元(含)。本次发行完成后, 假设本次可转债转股期限内投资者均不选择转股, 且不考虑可转债计入所有者权益部分的金额, 预计公司累计债券余额为 51,400.00 万元, 未超过最近一期末净资产的 50%。报告期各期末, 公司资产负债率(合并口径)分别为 20.60%、21.38% 和 25.62%, 具有合理的资产负债结构, 不存在重大偿债风险。

2023 年度、2024 年度和 2025 年度, 公司归属于母公司所有者的净利润(扣

除非经常性损益前后孰低者）分别为 2,716.47 万元、2,439.14 万元和 4,700.36 万元，平均可分配利润为 3,285.32 万元。参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

综上，公司本次发行可转换公司债券的规模具有合理性。

（十四）本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

1、关于本次证券发行的数量

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 51,400.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、关于融资间隔

根据法规规定，上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

公司本次发行可转债不适用上述规定，符合融资时间间隔的要求。

3、关于募集资金金额及投向

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 51,400.00 万元（含），拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）	67,320.00	47,400.00
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		71,320.00	51,400.00

本次发行募集资金投资于“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”及补充流动资金，均围绕公司主营业务展开。本次募投项目实施旨在打造

集光刻胶、光刻胶配套树脂及湿电子化学品研发、生产、检测、销售于一体的高端电子化学品生产基地，提升公司在先进封装及晶圆制造领域高端电子化学品的量产能力，强化公司在核心高端材料领域的产能支撑，有助于公司未来业绩的增长，符合公司长期发展需求及股东利益。因此，符合“本次募集资金主要投向主业”的要求。

综上，公司本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称	江苏艾森半导体材料股份有限公司
法定代表人	沈鑫
住所	千灯镇黄浦江路 1647 号
董事会秘书	陈小华
联系电话	0512-50103288
传真号码	0512-50103111

（二）保荐人（主承销商）、受托管理人

名称	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人	江禹
住所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
保荐代表人	石伟、陈诚
项目协办人	李子尧
项目组成员	姚泽梁、顾峰、谢佳旻
联系电话	010-56839300
传真号码	010-56839500

（三）律师事务所

名称	上海市方达律师事务所
机构负责人	季诺
住所	上海市石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼
经办律师	王梦婕、胡姝雯、吴思灵
联系电话	021-22081166

传真号码	021-52985599
------	--------------

（四）会计师事务所

名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	张晓荣
住所	上海市静安区威海路 755 号 25 层
经办注册会计师	耿磊、周思艺、张扬
联系电话	021-52920000
传真号码	021-52921369

（五）申请上市证券交易所

名称	上海证券交易所
住所	上海市浦东新区杨高南路 388 号
联系电话	021-68808888
传真号码	021-68804868

（六）收款银行

名称	中国工商银行深圳振华支行
开户名称	华泰联合证券有限责任公司
账户号码	4000010209200006013

（七）资信评级机构

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
法定代表人	崔磊
住所	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1
经办人员	任志娟、于易含
联系电话	010-62299800
传真号码	010-62299803

五、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）经营业绩波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为 36,003.93 万元、43,218.84 万元和 59,264.37 万元，净利润分别为 3,265.73 万元、3,347.75 万元和 5,163.46 万元，扣非后归母净利润分别为 2,716.47 万元、2,439.14 万元和 4,700.36 万元。公司未来经营业绩受宏观经济环境、行业下游需求、行业竞争格局、公司技术研发及产业化能力等内外部因素共同影响，如果未来上述因素发生重大不利变化，公司经营业绩将面临波动或下滑的风险。

（二）新产品研发风险

半导体材料属于技术密集、资金密集型行业。近年来全球半导体产业向先进制程、先进封装、超高纯度方向快速演进，下游晶圆制造、封测及显示面板厂商为保障生产良率与工艺稳定性，对上游材料供应商的产品提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。

公司新产品研发需经过研发立项、需求确认、产品设计及实验室小试、样品试制及研发验证、中试及产品认证等多个核心环节，研发周期较长、资金与人力投入规模较大。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制造失败的风险，若公司不能按计划完成新产品的开发，或者所开发的新产品在性能、质量或成本方面不具有竞争优势，将对公司的盈利能力以及在行业内的竞争地位造成不利影响。

（三）核心技术泄密、技术人员流失的风险

目前公司的核心技术中部分为非专利专有技术，以技术秘密的形式予以保护。尽管公司已建立严格的保密管理制度与知识产权保护体系，但不能排除技术人员违反相关管理规定向外泄露核心技术或技术成果被他人不当盗用的可能。同时，在半导体材料行业高端人才稀缺、市场竞争日益激烈的背景下，行业内对核心技术与研发人才的争夺日趋加剧，公司存在核心技术人员流失的风险。若公司未来出现核心技术泄密、技术人员流失等情形，公司在产品和服务方面的技术优

势将被削弱，难以在市场竞争中持续保持优势地位。

（四）毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 27.39%、26.56%和 28.85%，受产品结构及原材料价格等因素的影响，毛利率存在小幅波动。若未来市场竞争加剧、新产品开发失败等因素导致产品价格下降，产品结构发生重大不利变动或原材料价格上涨，公司将面临毛利率下滑的风险，从而对经营业绩造成不利影响。

（五）应收账款回收风险

公司应收账款规模随销售规模的扩大而随之增加。报告期各期末，公司应收账款余额分别为 16,090.94 万元、20,667.81 万元和 20,810.98 万元；2025 年末，公司账龄在 1 年以内的应收账款占比为 98.33%。随着公司销售规模进一步扩大，应收账款将有进一步增加的趋势。未来若全球宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，或个别客户经营状况恶化，公司将面临应收账款难以收回而发生坏账的风险。

（六）存货跌价风险

公司主要经营模式为“以销定产”，期末存货主要包括各种原材料、库存商品和发出商品。随着公司产销规模快速增长，存货规模也随之逐年上升，报告期各期末，公司存货余额分别为 4,077.07 万元、6,372.54 万元和 7,360.49 万元。公司各类存货根据生产周期保持一定的储备量，但如果因产品质量、交货周期等因素不能满足客户订单需求，导致公司产品无法正常销售，进而导致存货可变现净值低于成本，将使得存货发生减值并对公司的经营业绩带来不利影响。

（七）环保风险

公司主要产品的生产过程为配方型复配工艺，以复配、混合、过滤等工艺为主，生产环节不存在重污染的情况，仅涉及少量废水、废气及固体废物。报告期内，公司存在因雨水窖井内的污水管道破损导致生活污水渗透至雨水系统并对外排放的情况，公司已及时整改修复。报告期内，公司不存在环保等领域的重大违法违规行为，但若未来公司出现因环保设备故障、人为操作不当等导致的环境污染或在环保政策发生变化时不能及时规范达到相应的要求等情形，可能存在受到环保主管部门处罚的风险。

二、与行业相关的风险

（一）半导体行业周期风险

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对电子化学品需求的下降。若全球经济增速放缓、AI 算力需求不及预期，或消费电子、汽车电子等下游市场再度疲软，将直接导致半导体产品需求下滑，进而影响公司光刻胶、电镀液等核心材料的订单量与产品价格。如果由于贸易摩擦等因素引致下游市场整体波动，亦或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

（二）市场竞争的风险

基于下游市场需求，发行人围绕电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大业务板块推出多款产品，其他国内竞争对手也在持续增加研发投入、扩建产能或推出新产品参与市场竞争。同时，半导体下游客户对电镀液、光刻胶等产品的可靠性和稳定性要求极高，更换供应商难度较大，公司与国际巨头争夺高端市场，面临无法抢占其市场份额的竞争风险。如果公司不能根据市场需求持续更新技术和开发产品、降低产品成本，保持产品和技术竞争力，公司可能无法与国内外企业进行有效竞争，从而对公司的市场份额、市场地位、经营业绩造成不利影响。

（三）原材料供应及价格上涨的风险

公司原材料主要包括各种溶剂类和固体类的化工原料，以及以锡材（锭）为主的金属材料。上述材料作为大宗工业原材料，其价格易受国际原油价格或国际金属价格的波动影响。若未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司产品销售价格不能同步提高，将对公司的经营业绩产生不利影响。

三、其他风险

（一）与本次募集资金投资项目相关的风险

1、募投项目产品产业化风险

本次募投项目中，“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”

产品包括光刻胶及湿电子化学品两大品类。其中，光刻胶包括先进封装光刻胶、晶圆制造光刻胶、新型显示用光刻胶以及相关配套树脂；湿电子化学品则包括蚀刻液、清洗液等，其中部分产品为公司光刻胶、电镀液业务所研发迭代的新产品。虽然公司已对该募投项目进行了较为充分的可行性论证，但若未来公司客户认证进展不及预期，无法获得充足的客户订单，受技术迭代影响市场需求或单价下降等，可能存在部分新增产能无法消化、项目效益不及预期等风险，进而对公司业绩产生不利影响。

2、募投项目建设进度不及预期、无法充分实施的风险

在本次募投项目实施过程中，若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，或因产品研发及新客户审核认证进展不及预期等因素，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司本次募投项目将会存在不能全部按期建设完成或不能顺利实施的风险。此外，若工程进度、项目质量、产能消化、产业政策、市场需求等方面出现不利变化，将可能导致项目周期延长或项目收益低于预期，进而对公司经营业绩产生不利影响。

3、募集资金投资项目用地尚未取得的风险

截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”用地尚未取得出让土地使用权，目前公司已与南通市经济技术开发区管委会签署《投资协议》及相关补充协议，尚需通过招拍挂程序取得相关土地使用权。如公司不能及时取得相关土地使用权，将导致募集资金投资项目面临施工进度延后的风险。

4、募集资金投资项目新增折旧及摊销影响公司业绩风险

本次募集资金投资项目投资规模较大且主要为资本性支出，建成后公司固定资产、无形资产等资产规模将大幅度增加。若募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的收益水平，导致募集资金投资项目收益未能覆盖新增的折旧摊销费用，则公司存在因资产折旧摊销增加而导致业绩下滑的风险。

（二）与本次可转债相关的风险

1、可转债发行摊薄即期回报的风险

本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。本次可转债发行有助于公司增强盈利能力、提高抗风险能力。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，而募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和净资产收益率等财务指标可能存在下降压力，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。

2、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，如公司经营活动未能实现预期的回报，将可能使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

3、转股风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

（1）公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，本次可转债的转换价值可能降低，并因此影响投资者的投资收益。

（2）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

（3）本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏

好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，公司存在一定的定期偿付财务压力，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

4、可转债价格波动的风险

可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂。其中因可转债附有转股权利，通常可转债的发行利率比相似评级和期限的可比公司债券的利率更低；另外，由于可转债的转股价格为事先约定的价格，随着市场股价的波动，可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形，导致可转债的交易价格降低。因此，公司可转债在上市交易及转股过程中，可转债交易价格均可能出现异常波动或价值背离，甚至低于面值的情况，从而可能使投资者面临一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以及可转债特殊的产品特性，以便作出正确的投资决策。

5、未提供担保的风险

公司本次发行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

6、不实施向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下修正方案，但该方案未能通过股东会的批准。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

此外，公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境和经营业绩等多重因素，在本次可转债触及向下修正条件时，股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司 A 股股票均价存在不确定性，并相应导致转股价格修正幅度的不确定性。

7、信用评级变化的风险

本次可转换公司债券经东方金诚评定，根据东方金诚出具的《信用评级报告》，艾森股份主体信用等级为 AA_{sti}，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA_{sti}。

在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

第四节 发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

截至 2025 年末，公司的股本总额为 88,133,334 股，其中前十大股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
1	张兵	境内自然人	19,031,621	21.59%	19,031,621
2	蔡卡敦	境内自然人	6,847,826	7.77%	6,847,826
3	宁波艾森	其他	5,869,565	6.66%	5,869,565
4	翁伟芳	境内自然人	1,890,665	2.15%	-
5	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	境内非国有法人	1,600,000	1.82%	-
6	宁波艾龙	其他	1,459,002	1.66%	-
7	庄建华	境内自然人	1,236,364	1.40%	-
8	天津宸辉私募基金管理有限公司-天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,210,332	1.37%	-
9	江苏艾森半导体材料股份有限公司回购专用证券账户	其他	1,144,032	1.30%	-
10	上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	995,300	1.13%	-
合计			41,284,707	46.85%	31,749,012

二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

自设立以来，公司始终锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道，以技术创新为核心驱动力深耕行业多年。凭借持续高强度的研发投入与关键技术突破，公司已构建起覆盖半导体全产业链的材料解决方案体系，不仅在半导体封装化学品领域成长为国内市场的核心主力供应商，更在晶圆制造领域已实现深度卡位，通过电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大核心业务板块，为先进制程芯片制造提供关键材料支撑，同时逐步向半导体显示及 IC 载板等高附加值领域延伸。

目前，公司已成为国内少数具备半导体封装、晶圆制造和半导体显示全链条电子材料供应能力的企业，为我国半导体产业的发展提供关键支撑。

（二）保持科技创新能力的机制或措施

公司锚定半导体材料产业高端化、国产化、全球化发展趋势，紧扣下游晶圆制造、先进封装客户对先进制程材料的迫切需求，制定了未来 5-10 年研发路线图，聚焦光刻胶技术升级、先进制程电镀液突破、高纯试剂等新品类拓展三大核心方向，致力于从“单一产品供应商”向“综合材料服务商”战略升级，为客户提供从材料选型到工艺优化的整体解决方案。

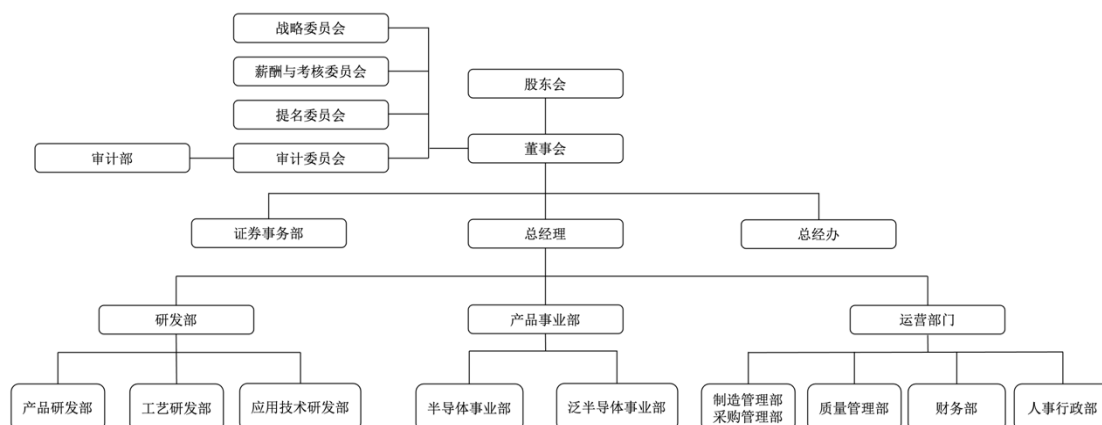
公司坚定实施“研发优先”战略，持续加大研发投入，报告期内研发投入分别为 3,268.79 万元、4,590.17 万元和 6,942.21 万元，保持高速增长，产品技术取得持续突破。

为持续保持科技创新能力，公司始终重视人才梯队的建设，持续引进各细分领域技术领军人才，优化人才结构，提升研发团队实力与创新能力。引进 95 后、00 后硕士及以上人才，通过导师制、项目历练加速成长，提升研发骨干占比。报告期各期末，公司研发人员数量分别为 61 人、78 人和 101 人，研发人员数量快速增长。截至 2025 年末，公司研发人员中，本科及以上学历人员数量占比为 92.08%，公司已拥有一支专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术研发团队。

三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司的内部组织结构图

公司依法设立了股东会、董事会和经营管理层，建立健全了法人治理结构，并规范运作。截至报告期末，公司内部组织机构设置如下：



(二) 公司直接或间接控股公司情况

截至本募集说明书签署日，公司共拥有 6 家控股子公司，各下属子公司所从事的业务具体情况如下：

序号	名称	持股方式	定位	主要业务情况
1	南通艾森	全资子公司	生产	公司在南通的成熟生产基地，负责现有产品的规模化生产与交付
2	艾森世华	全资子公司	销售	公司在华东区域的销售与服务主体，业务包括产品销售、客户服务及技术支持，衔接生产基地与终端客户
3	武汉艾森	全资子公司	销售	公司在华中区域的销售与服务主体，业务包括产品销售、客户服务及技术支持，衔接生产基地与终端客户
4	艾森芯材	全资子公司	生产	公司“集成电路材料华东制造基地项目”实施主体，承接公司光刻胶、电镀液等高端电子化学品的大规模产业化，与昆山、南通基地形成产能互补
5	新加坡艾森	全资子公司	投资	公司在东南亚地区的区域总部和海外投资并购主体
6	INOFINE	通过新加坡艾森持股 80%	生产、销售	马来西亚本地半导体湿电子化学品企业，深耕东南亚市场，拥有成熟的客户与渠道，是公司东南亚制造中心的核心载体

公司下属子公司的具体情况如下：

1、南通艾森

(1) 基本情况

公司名称	艾森半导体材料（南通）有限公司
成立时间	2017 年 3 月 8 日
注册资本	20,000 万元
实收资本	20,000 万元

法定代表人	沈鑫
注册地址	江苏省南通市开发区老洪港管理委员会通达路 86-1 号
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
主营业务及其与发行人主营业务的关系	化学品生产和销售，系发行人主营业务
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年末
总资产	30,055.40
净资产	20,763.53
营业收入	12,238.33
净利润	-34.27

注：上表 2025 年财务数据已经审计。

2、艾森世华

（1）基本情况

公司名称	昆山艾森世华光电材料有限公司
成立时间	2015 年 3 月 6 日
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
法定代表人	徐栋
注册地址	昆山市千灯镇少卿东路 169 号 2 号房
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
主营业务及其与发行人主营业务的关系	化学品销售，系发行人主营业务
经营范围	光电材料、半导体材料、电子材料、金属材料、过滤器材、胶粘制品、无尘室耗材，防静电产品、化工原料及产品（不含危险品）、

	锡制品、锡膏、硅材料、仪器仪表、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务；光电材料相关领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

（2）最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年末
总资产	13,151.05
净资产	1,251.17
营业收入	15,818.51
净利润	-262.89

注：上表 2025 年财务数据已经审计。

3、新加坡艾森

（1）基本情况

企业名称	INOFINE PTE.LTD.
工商登记号	202427475R
注册地址	11 BEACH ROAD#03-01 CRASCO BUILDING SINGAPORE（189675）
成立日期	2024 年 7 月 8 日
企业类型	私人股份有限公司
注册资本	10,000 新加坡元
经营范围	化学品和化学制品批发等；总部活动、管理服务活动等
股权结构	发行人持股 100%

（2）最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年末
总资产	2,293.70
净资产	2,293.70
营业收入	-
净利润	-

注：上表 2025 年财务数据已经审计。

4、INOFINE

(1) 基本情况

企业名称	INOFINE CHEMICALS SDN BHD
工商登记号	200901006583 (849546-H)
注册地址	Suite30C, 3rdFloor, WismaTCL, 470 Jalan Ipoh, 3rdMile, 51200 Kuala Lumpur
成立日期	2009 年 3 月 12 日
企业类型	私人股份有限公司
注册资本	150,000 林吉特
经营范围	各类化学相关产品贸易；其他化学产品制造
股权结构	新加坡艾森持股 80%，Mock Phoi Ching 持股 20%

(2) 最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年末
总资产	4,755.65
净资产	1,865.64
营业收入	4,476.84
净利润	198.39

注：上表 2025 年财务数据已经审计。

5、武汉艾森

(1) 基本情况

公司名称	武汉艾森晶合半导体有限公司
成立时间	2025 年 5 月 12 日
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
法定代表人	徐栋
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B4 栋 18 楼 723
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
主营业务及其与发行人主营业务的关系	化学品销售，系发行人主营业务
经营范围	一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售，电子专用设备销售，新材料技术研发，金属链条及其他金属制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），金属链条及其他金属制品制造，货物进出口，技

	术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	--

（2）最近一年简要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年末
总资产	200.12
净资产	200.06
营业收入	-
净利润	0.06

注：上表 2025 年财务数据已经审计。

6、艾森芯材

（1）基本情况

公司名称	南通艾森芯材科技有限公司
成立时间	2026 年 2 月 11 日
注册资本	20,000 万元
实收资本	3,000 万元
法定代表人	沈鑫
注册地址	江苏省南通市开发区老洪港管理委员会通达路 86-1 号
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
主营业务及其与发行人主营业务的关系	化学品生产和销售，系发行人主营业务
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；合成材料销售；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一年简要财务数据

艾森芯材成立于 2026 年 2 月，故无最近一年财务数据。

四、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况

（一）控股股东和实际控制人

1、控股股东、实际控制人基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人控股股东为张兵，实际控制人为张兵、蔡卡敦夫妇，张兵、蔡卡敦分别直接持有发行人 21.59%和 7.77%的股份，张兵作为执行事务合伙人通过宁波艾森间接控制艾森股份 6.66%的股份。张兵、蔡卡敦夫妇持有及控制发行人合计 36.02%的股份。张兵、蔡卡敦的简历情况如下：

张兵先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于复旦大学微电子与电子固体学专业；苏州市人大代表。曾任职于陶氏化学电子材料、新加坡 PMI 公司。2010 年 3 月至今在艾森股份担任董事长。

蔡卡敦女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学。曾任职于 AVNET CO.、上海龙旗科技股份有限公司、广州慧智微电子有限公司、深圳日海物联技术有限公司。

2、上市以来控股股东、实际控制人变化情况

公司 2023 年 12 月 6 日于上交所科创板上市。自上市以来，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）控股股东和实际控制人投资的其他企业

截至报告期末，除发行人及其子公司以外，公司控股股东、实际控制人投资的其他企业情况如下：

序号	企业名称	类型	经营范围	持股情况
1	宁波艾森	公司控股股东，实际控制人张兵先生控制的其他企业	一般项目：企业管理；品牌管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）	张兵直接持有 37.8970%出资份额
2	安徽特瑞智能遮阳技术有限公司	公司控股股东，实际控制人张兵先生投资的其他企业	建筑遮阳智能化工程领域中的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑节能、建筑遮阳、建筑智能化、建筑内外遮阳产品的研发、设计、制造、销售、安装；建筑装饰工程的设计、施工；智能家居产品的研发、销售、生产、	张兵直接持股 3.9798%

序号	企业名称	类型	经营范围	持股情况
			安装以及技术转让；纺织产品销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定的或法律法规禁止经营的项目除外）；装饰装修产品的设计、研发、销售；布艺窗帘、纱帘、浴帘、医用隔帘、床上用品、酒店用品、办公家具、教学设备、标识标杆、五金电器、电子产品、医疗器械（一类、二类）、医疗辅材、机械设备、地毯、墙纸、墙布、软包、阳光房、铝合金、塑钢门窗、木门系列设计、生产、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
3	上海锐鹄管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人蔡卡敦投资的企业	一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	蔡卡敦直接持有 33.3333% 出资份额
4	凯新化工科技（上海）有限公司	公司实际控制人蔡卡敦投资的企业	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电力电子元器件销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	蔡卡敦直接持股 9.0000%
5	上海世禹精密设备股份有限公司	公司实际控制人蔡卡敦投资的企业	一般项目：货物进出口；技术进出口；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	蔡卡敦直接持股 1.0347%
6	苏州赛尔科技有限公司	公司实际控制人蔡卡敦投资的企业	精密工具、芯片、计算机软硬件、通信技术、生物基因技术、机电一体化技术、电子商务平台的技术研发及相关技术咨询、技术服务、技术转让；生产加工晶圆切割工具、精密工具、磨料模具；并提供相关售后服务；从事上述产品及相关技术的进出口业务。（依法须经批	蔡卡敦直接持股 0.8691%

序号	企业名称	类型	经营范围	持股情况
			准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁；汽车零部件及配件制造；金属链条及其他金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
7	苏州傲蓝电子科技有限公司	公司实际控制人蔡卡敦投资的企业	计算机及数控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、机电设备、仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	蔡卡敦直接持股 8.0000%
8	广州慧智慧芯企业管理合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人蔡卡敦投资的企业	企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）	蔡卡敦直接持有 2.6845% 出资份额
9	上海湾鹄管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人蔡卡敦投资的企业	企业管理及咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	蔡卡敦直接持有 2.0000% 出资份额

（三）控股股东及实际控制人所持股份被质押的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或潜在纠纷的情况。

五、承诺事项及履行情况

（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

报告期内，发行人及相关人员已作出的重要承诺及其履行情况参见公司已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年年度报告》之“第六节 重要事项/一、承诺事项履行情况”相关内容。

截至本募集说明书签署日，上述重要承诺及其履行情况未发生变化。

（二）本次发行相关的承诺事项

1、相关主体对公司填补回报措施能够切实履行做出的承诺

（1）发行人承诺

发行人对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补

措施事宜，作出以下承诺：

“1、加强募集资金的管理和运用，加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到账后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将对募集资金进行专户存储和使用、保障募集资金按照原定用途得到充分有效利用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东会、董事会、审计委员会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东会、董事会、审计委员会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

3、进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和资金管控风险，提升整体运营效率。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性。”

（2）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，郑重作出以下承诺：

“1、本人承诺不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益。

2、自本承诺出具日至发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足该等规定或要求时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和上海证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。”

（3）董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护发行人的合法权益。

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

4、本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

5、本人承诺在职权范围内全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的董事与高级管理人员薪酬方案与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺若公司未来实施股权激励，全力促使拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、自本承诺出具日至发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足该等规定或要求时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

8、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和上海证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。”

2、关于是否参与本次可转债认购的承诺

关于是否参与本次可转债认购的承诺详见“重大事项提示”之“四、公司持股 5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购情况”。

六、董事、高级管理人员及其他核心人员

（一）董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

1、董事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、高级管理人员和核心技术人员如下：

序号	姓名	职务	性别	出生年月	任职起始日期	任职终止日期
1	张兵	董事长	男	1972 年 10 月	2023-08-12	2026-08-11
2	向文胜	董事、总经理、核心技术人员	男	1967 年 10 月	2023-08-12	2026-08-11
3	陈小华	董事、常务副总经理、董事会秘书	男	1978 年 1 月	2023-08-12（常务副总经理任期起始日期为 2023-12-30）	2026-08-11

序号	姓名	职务	性别	出生年月	任职起始日期	任职终止日期
4	杨一伍	董事	男	1983 年 12 月	2023-08-12	2026-08-11
5	沈鑫	董事	男	1984 年 1 月	2025-09-08	2026-08-11
6	孙清清	独立董事	男	1981 年 2 月	2023-08-12	2026-08-11
7	黄晓刚	独立董事	男	1964 年 11 月	2024-02-22	2026-08-11
8	李挺	独立董事	男	1990 年 3 月	2024-02-22	2026-08-11
9	赵建龙	副总经理、核心技术人员	男	1974 年 5 月	2023-08-12	2026-08-11
10	谢立洋	副总经理	男	1979 年 6 月	2023-08-12	2026-08-11
11	程瑛	副总经理	女	1988 年 10 月	2025-09-08	2026-08-11
12	吕敏	财务总监	女	1986 年 8 月	2024-02-05	2026-08-11
13	杜冰	核心技术人员	女	1971 年 10 月	2016-06-01	/
14	刘斌	核心技术人员	男	1988 年 1 月	2022-08-01	/
15	胡青华	核心技术人员	男	1984 年 10 月	2014-09-01	/

注：因第三届董事会任期即将届满，发行人于 2026 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议作出决议提名张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、沈鑫、王嘉赋、陈琳、李挺为公司第四届董事会董事，其中王嘉赋、陈琳、李挺为独立董事。前述董事候选人选尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后方可生效。

（二）现任董事、高级管理人员和其他核心人员的简历

1、董事会成员

截至本募集说明书签署日，公司现任董事共有 8 名，其中独立董事 3 名，公司董事基本情况如下：

（1）张兵先生，公司董事长，简历参见本节“四/（一）控股股东、实际控制人基本情况”。

（2）向文胜先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于国防科技大学，曾先后任职于安靠封装测试（上海）有限公司、珠海越亚半导体股份有限公司，2016 年 5 月至今在艾森股份担任总经理、研发负责人，2017 年 11 月至今任艾森股份董事。

（3）陈小华先生：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南京大学，高级会计师。曾任职于明基电通有限公司。2016 年 10 月至 2024 年 2 月任艾森股份财务总监，2017 年 11 月至 2023 年 12 月任艾森股份副总经理、董事、董事会秘书，2023 年 12 月至今任艾森股份常务副总经

理、董事、董事会秘书。

(4) 杨一伍先生：1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于苏州大学。2010 年 3 月至今历任艾森股份经理、销售总监，2017 年 11 月至今任艾森股份董事。

(5) 沈鑫先生：1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国班尼迪克大学。曾任职于依工特种材料（苏州）有限公司。2017 年加入公司，现任公司制造总监、董事。

(6) 孙清清先生：1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任复旦大学信息学院讲师、副研究员；2013 年 12 月至今任复旦大学微电子学院研究员。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

(7) 李挺先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业博士研究生学历，毕业于上海财经大学。曾任职于上海对外经贸大学，2022 年 8 月至今先后任上海财经大学会计学院讲师、副教授。2024 年 2 月至今任公司独立董事。同时，李挺先生任腾达建设集团股份有限公司独立董事。

(8) 黄晓刚先生：1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历，国际 PMP 项目管理认证专家，北京市自然科学基金会专家库专家评委。2010 年 1 月至今任中国科学院微电子研究所产业化处研究员。2024 年 2 月至今任公司独立董事。

2、高级管理人员

截至本募集说明书签署日，公司现任高级管理人员共有 6 名，其基本情况如下：

(1) 向文胜先生：公司董事、总经理、核心技术人员，简历详见本节“六/（二）/1、董事会成员”。

(2) 陈小华先生：公司董事、常务副总经理、董事会秘书，简历详见本节“六/（二）/1、董事会成员”。

(3) 赵建龙先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历，毕业于上海轻工业高等专科学校（现上海应用技术大学）。曾获“昆山市劳动模范”称号。曾任职于上海罗尼电子材料有限公司等。2010年3月至今任公司制造管理部负责人，2020年8月至今任公司副总经理。

（4）谢立洋先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，淮海工学院本科学历。曾先后任职于星科金朋（上海）有限公司、威旭电子（上海）有限公司等。2014年5月至今任公司销售总监，2023年8月至今任公司副总经理。

（5）程瑛女士：1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州经贸职业技术学院大专学历。2010年3月至今在公司先后担任总经理办公室主任、公共关系副总经理，2023年8月至2025年9月任公司监事会主席；2025年8月至今任公司副总经理。

（6）吕敏女士：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学本科学历。曾先后任职于新宁物流（300013.SZ）、日月新半导体（昆山）有限公司。2017年9月加入公司以来，先后担任公司财务主管、财务经理、财务副总监，2024年2月至今任公司财务总监。

3、核心技术人员

截至本募集说明书签署日，公司现任核心技术人员共有5名，其基本情况如下：

（1）向文胜先生：公司董事、总经理、核心技术人员，简历详见本节“六/（二）/1、董事会成员”。

（2）赵建龙先生：公司副总经理、核心技术人员，简历详见本节“六/（二）/2、高级管理人员”。

（3）杜冰女士：1971年10月出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于美国克拉克森大学（Clarkson University）。曾任职于金柯有色金属有限公司，并在 Nano dynamics Inc.及美国克拉克森大学（Clarkson University）攻读博士后。2006年1月至2014年7月在富士胶片电子材料（美国）有限公司（Fuji film Electronic Materials U.S.A.Inc.）担任高级研发化学家（Senior Research Chemist），2016年6月至今任公司研发总监。

(4) 刘斌先生：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学高分子科学与工程博士研究生学历。曾获“姑苏创新领军人才”、“江苏省创新领军人才”等荣誉。曾任职于济南圣泉集团股份有限公司博士后科研工作站从事博士后研究工作和任圣泉集团聚酰亚胺研究所所长。2022 年 8 月至今任公司研发总监。

(5) 胡青华先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于同济大学，曾获 2019 年昆山市“紧缺产业人才”等荣誉。曾任职于上海新阳研发工程师。2011 年 5 月至 2014 年 8 月在深圳市正天伟科技有限公司担任研发主任，2014 年 9 月至今先后担任艾森股份研发经理、研发副总监、研发总监。

(三) 董事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员的主要对外兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职职务
张兵	董事长	宁波艾森	执行事务合伙人
		安徽特瑞智能遮阳技术有限公司	监事
陈小华	董事、常务副总经理、董事会秘书	宁波艾龙	执行事务合伙人
		宁波艾荣企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
孙清清	独立董事	上海朔集半导体科技有限公司	董事长
		上海世禹精密设备股份有限公司	独立董事
		上海微链和企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
		上海集成电路制造创新中心有限公司	总监
		上海硅产业集团股份有限公司	独立董事
李挺	独立董事	上海财经大学	会计学院副教授
		腾达建设集团股份有限公司	独立董事
		集益威半导体（上海）股份有限公司	独立董事
黄晓刚	独立董事	中国科学院微电子研究所	研究员

截至本募集说明书签署日，除上表所列情况外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员无其他主要对外兼职情况。

（四）董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员及核心技术人员领取的税前报酬总额情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2025 年度薪酬	是否在公司关联方获取报酬
1	张兵	董事长	80.87	否
2	向文胜	董事、总经理、核心技术人员	71.04	否
3	陈小华	董事、常务副总经理、董事会秘书	70.78	否
4	杨一伍	董事	78.06	否
5	沈鑫	董事	45.74	否
6	孙清清	独立董事	8.00	否
7	黄晓刚	独立董事	8.00	否
8	李挺	独立董事	8.00	否
9	赵建龙	副总经理、核心技术人员	65.01	否
10	谢立洋	副总经理	63.34	否
11	程瑛	副总经理	47.01	否
12	吕敏	财务总监	47.04	否
13	杜冰	核心技术人员	14.58	否
14	刘斌	核心技术人员	86.56	否
15	胡青华	核心技术人员	84.07	否

（五）董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人现任董事、高级管理人员及核心技术人员直接持有发行人股份情况如下表：

单位：股

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例
1	张兵	董事长	19,031,621	21.59%
2	陈小华	董事、董事会秘书、常务副总经理	885,997	1.01%
3	杨一伍	董事	679,328	0.77%
4	赵建龙	副总经理、核心技术人员	472,530	0.54%
5	谢立洋	副总经理	286,300	0.32%
6	胡青华	核心技术人员	78,100	0.09%

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例
合计			21,433,876	24.32%

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人现任董事、高级管理人员及核心技术人员间接持有发行人股份情况如下表：

姓名	职务	直接股东名称	直接股东持有公司股份比例	在直接股东中的持股比例	间接持有发行人股份数量（万股）
张兵	董事长	宁波艾森	6.66%	37.90%	222.44
向文胜	董事、总经理、核心技术人员	宁波艾龙	1.66%	54.64%	79.72
杨一伍	董事	宁波艾森	6.66%	10.00%	58.70
杜冰	核心技术人员	宁波艾龙	1.66%	30.19%	44.05

除上述直接或间接方式持有发行人股份外，发行人现任董事、高级管理人员、核心技术人员亦持有发行人限制性股票和通过员工持股计划持有发行人股份，参见“（七）董事、高级管理人员及其他员工的激励情况”。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事、高级管理人员和核心技术人员持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年变动情况

最近三年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况如下：

1、董事变动情况

报告期初（即 2023 年 1 月 1 日），公司的第二届董事会成员包括 6 名非独立董事张兵、向文胜、陈小华、赵烨、杨一伍、孙杨和 3 名独立董事秦舒、孙清清和朱雪珍。

报告期期初至本募集说明书签署之日，公司董事变动情况如下：

时间	董事变动情况
2023 年 1 月	赵烨因个人原因辞去公司非独立董事职务，发行人 2023 年第一次临时股东大会选举俞信华为公司非独立董事
2023 年 8 月	因第二届董事会任期届满，发行人 2023 年第二次临时股东大会选举张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、俞信华、孙杨、秦舒、孙清清和朱雪珍为公司第三届董事会董事，其中秦舒、孙清清和朱雪珍为独立董事
2024 年 2 月	秦舒、朱雪珍因个人原因辞去公司独立董事职务，发行人 2024 年第二次临时股东大会选举黄晓刚、李挺为公司独立董事

时间	董事变动情况
2024 年 9 月	孙杨、俞信华因个人原因辞去公司非独立董事职务。辞任后，孙杨、俞信华不再担任公司任何职务。发行人 2024 年第四次临时股东大会决议将公司董事会成员人数由 9 名调整至 7 名
2025 年 9 月	发行人 2025 年第一次临时股东大会选举沈鑫为公司非独立董事
2026 年 7 月	因第三届董事会任期即将届满，发行人第三届董事会第二十四次会议作出决议提名张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、沈鑫、王嘉赋、陈琳、李挺为公司第四届董事会董事，其中王嘉赋、陈琳、李挺为独立董事。前述董事候选人选尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后方可生效

2、监事变动情况

报告期初（即 2023 年 1 月 1 日），发行人时任监事会成员为谢立洋、庄建华和熊秋丽（职工代表监事）。

报告期期初至本募集说明书签署之日，公司监事变动情况如下：

时间	监事变动情况
2023 年 8 月	因第二届监事会任期届满，发行人 2023 年第二次临时股东大会选举程瑛、庄建华为公司监事，与职工代表监事熊秋丽（系经 2023 年 7 月 26 日召开的发行人职工代表大会选举产生）共同组成公司第三届监事会
2024 年 9 月	庄建华因个人原因辞去公司监事职务，发行人 2024 年第四次临时股东大会选举沈鑫为公司监事，前述临时股东大会选举新任监事前，庄建华仍继续履行其作为监事的职责
2025 年 9 月	发行人 2025 年第一次临时股东大会决议取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权

3、高级管理人员变动情况

报告期初（即 2023 年 1 月 1 日），发行人的高级管理人员包括向文胜、陈小华、赵建龙。

报告期期初至本募集说明书签署之日，发行人高级管理人员变动情况如下：

时间	高级管理人员变动情况
2023 年 8 月	鉴于公司高级管理人员任期届满且出于完善公司治理结构的考虑，发行人第三届董事会第一次会议决议聘任向文胜为公司总经理，陈小华为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，谢立洋、赵建龙为公司副总经理
2023 年 12 月	根据公司战略发展规划及实际经营发展需要，发行人第三届董事会第四次会议决议将陈小华的职务由副总经理调整为常务副总经理
2024 年 2 月	陈小华先生因职务调整原因申请辞去公司财务总监职务，发行人第三届董事会第五次会议决定聘任吕敏女士为公司财务总监
2025 年 8 月	发行人第三届董事会第十七次会议决定聘任程瑛女士为公司副总经理

4、核心技术人员变动情况

报告期初（即 2023 年 1 月 1 日），发行人时任核心技术人员分别为向文胜、杜冰、赵建龙、胡青华。

2025 年 4 月 26 日，公司经研究并综合考虑任职履历、核心技术研发的参与情况以及对公司业务发展贡献等相关因素，新增认定刘斌先生为公司核心技术人员。

（七）董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

1、通过员工持股平台宁波艾森、宁波艾龙实施股权激励

为进一步健全公司激励机制，发行人分别于 2015 年 8 月 7 日和 2017 年 1 月 5 日设立宁波艾森和宁波艾龙两个持股平台对员工实行股权激励。宁波艾森取得发行人股权的价格为 1 元/注册资本，宁波艾龙取得发行人股权的价格为 1 元/注册资本。上述股权激励方案均已经公司内部决策程序审议通过，员工自愿参加股权激励，具体人员及持股数量根据担任职务、工作年限、个人意愿等因素综合协商确定。截至 2025 年 12 月 31 日，宁波艾森、宁波艾龙分别持有公司 6.66%、1.66%股份。

2、2025 年限制性股票激励计划

2025 年 9 月 26 日和 2025 年 10 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。本次股权激励计划拟向 56 名激励对象授予 55 万股第二类限制性股票，授予价格为 26.42 元/股，股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。

2025 年 10 月 24 日，根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合授予条件的 56 名激励对象授予 55 万股限制性股票。激励对象名单及授予情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予第二类限制性股票总数的比例	占授予日当日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	陈小华	董事、常务副总经理、董事会秘书	中国	0.60	1.09%	0.01%
2	沈鑫	董事、制造总监	中国	1.50	2.73%	0.02%
3	程瑛	副总经理	中国	2.00	3.64%	0.02%
4	吕敏	财务总监	中国	2.00	3.64%	0.02%
5	胡青华	核心技术人员、研发总监	中国	2.70	4.91%	0.03%
6	刘斌	核心技术人员、研发总监	中国	2.70	4.91%	0.03%
二、其他激励对象						
中层管理人员、核心业务骨干及公司董事会认为需要激励的其他人员(含1名马来西亚籍)(共50人)				43.50	79.09%	0.49%
合计				55.00	100.00%	0.62%

截至本募集说明书签署日，公司2025年限制性股票激励计划尚未归属。

3、2025年员工持股计划

2025年9月26日和2025年10月17日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的公司A股普通股股票，合计不超过30万股，本次员工持股计划购买回购股票的价格为26.42元/股。截至2025年11月17日止，员工持股计划专户已收到56名参与对象缴纳的标的股票认购款合计人民币792.60万元。

本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股计划所获标的股票。

2025年11月25日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工

持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次持股计划相关事宜的议案》等相关议案。

2025 年 12 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 300,000 股公司股票已于 2025 年 12 月 3 日非交易过户至“江苏艾森半导体材料股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 26.42 元/股。本次员工持股计划持有人对应的权益份额及比例如下表所示：

序号	姓名	职务	国籍	认购份额对 应股份数量 (万股)	认购份额 占持股计 划总份额 的比例	认购份额 对应股份 数量占目 前股本总 额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	陈小华	董事、常务副总经理、董事会秘书	中国	0.50	1.67%	0.01%
2	沈鑫	董事、制造总监	中国	1.50	5.00%	0.02%
3	程瑛	副总经理	中国	2.00	6.67%	0.02%
4	吕敏	财务总监	中国	2.00	6.67%	0.02%
5	胡青华	核心技术人员、研发总监	中国	1.30	4.33%	0.01%
6	刘斌	核心技术人员、研发总监	中国	1.30	4.33%	0.01%
二、其他激励对象						
中层管理人员、核心业务骨干及公司董事会认为需要激励的其他人员（含 1 名马来西亚籍）（共 50 人）				21.40	71.33%	0.24%
合计				30.00	100.00%	0.34%

截至本募集说明书签署日，公司 2025 年员工持股计划员工所获股票尚在锁定期内。

七、发行人所处行业的基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

发行人主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。发行人围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。

根据国家统计局《2017 年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985 电子专用材料制造”。

（二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业监管体制

公司所属行业的监管体制为政府职能部门的宏观管理结合行业自律组织的协调指导发展。国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部作为行业主管部门，主要负责产业政策、行业规划，指导行业科技进步。中国半导体行业协会是公司所属行业的主要自律组织，主要负责提出行业发展相关政策建议，协助有关政策和法规的贯彻落实，推动半导体产业的全球化合作和交流，参与制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等。

2、最近三年监管政策变化

公司从事的电子化学品属于功能湿化学品及光刻胶范畴，功能湿化学品及光刻胶均为国家重点扶持和发展的战略性新兴产业中的新材料产业，在国家经济中占有重要位置。最近三年党中央以及国务院、发改委、科技部、工信部等各部门相继出台了多项支持我国新材料产业发展的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境，加速半导体材料国产化、本土化供应的进程，主要行业法律法规及产业政策如下：

序号	发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
1	2025 年 9 月	工业和信息化部等 7 部门	《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026 年）》	聚焦集成电路、新能源、医疗装备等重点产业链需求，支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关。加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点，持续发挥新材料生产应用验证、测试评价等重点平台作用，用好新材料首批次保险补偿机制，推动创新产品研发和产业化，加快补齐短板弱项。
2	2025 年 8 月	工信部、市场监督管理总局	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	持续提升关键核心技术、强化产业链供应链枢纽等“硬实力”，加强标准、品牌、生态等“软建设”，保持电子信息制造业经济运行在合理区间，为工业经济稳增长提供有力支撑。
3	2024 年 7 月	工业和信息化部等九部门	《精细化工产业创新发展实施方案	加快关键产品攻关，围绕新能源、新材料、生物技术、工业母机、医疗装备需求，提升电子化学

序号	发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
			(2024—2027 年)》	品等领域关键产品供给能力。 加快发展水基（体）型等低 VOCs 胶粘剂、油墨、清洗剂，环保型水处理剂，绿色高效催化剂、溶剂、改性剂/添加剂/表面活性剂，超净高纯试剂。通过应用新技术（纳米技术、辐射固化技术、低氯低色度控制技术、硅树脂分子结构调控及分析检测技术等）、新材料（光固化材料等），提高产品性能和质量一致性。鼓励企业精耕细分领域，打造特色优势产品，并对不同领域客户提供系统化解决方案，增强国际竞争力。
4	2023 年 12 月	工业和信息化部	《重点新材料首次应用示范指导目录（2024 年版）》	超高纯化学试剂、集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、I 型光敏型聚酰亚胺（PI）绝缘材料作为先进半导体材料和新型显示材料之一进入示范指导目录。
5	2023 年 12 月	国家发展和改革委员会	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	“电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”属于第一类“鼓励类”。
6	2023 年 8 月	工信部、财政部	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能。 面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。
7	2023 年 6 月	工业和信息化部、教育部、科学技术部、财政部、国家市场监督管理总局	《制造业可靠性提升实施意见》	聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。电子行业，提升电子化学品、芯片先进封装材料等电子材料性能。

（三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

1、行业近三年在科技创新方面的发展情况

（1）高算力需求驱动先进封装产业加速发展

AI 快速发展驱动算力需求不断增长，而半导体先进制程工艺已逼近摩尔定

律极限，而通过后道封装技术改进可以进一步提高芯片性能，由此先进封装技术应运而生。先进封装的基本原理是通过创新的物理结构设计、高密度互连技术和异构集成方案，突破传统 2D 平面封装的性能、集成度与功耗瓶颈，将多个功能芯粒（Die）或芯片，以更紧密的空间布局、更短的信号路径、更高效率的能量传输方式“重组”，实现“1+1>2”的系统级功能提升。先进封装非单一技术，而是“空间重构（2.5D/3D）+互连升级（微凸点/混合键合）+异构集成（Chiplet 组合）”的协同体系，技术方案不断迭代。

2022-2023 年由于全球消费电子需求疲软，先进封装市场规模亦有所萎缩。2024 年全球半导体市场重回增长轨道，且呈现分化发展态势，其中 AI 芯片、存储芯片等领域需求持续攀升，展现出强劲的发展势头，由此带动先进封装行业重回增长态势。本轮 AI、高性能计算需求驱动的行业周期不同于以往，对封装技术方案提出更高要求，将驱动先进封装行业加速发展。根据 Yole Group 数据，2024 年全球先进封装市场规模约为 460 亿美元，预计到 2030 年将达到约 800 亿美元。根据中商产业研究院数据，2025 年中国先进封装市场规模 852 亿元，预计随着国内技术的不断进步和市场需求的持续增加，中国先进封装市场将保持快速增长的态势，增速将快于全球。

（2）中国半导体材料行业由中低端向高端突破演进

当前中国半导体材料行业整体处于由中低端向高端突破演进的关键阶段，也是国产供应链发展的黄金期。在政策支持、产业链创新发展需求及下游晶圆厂扩产的多重驱动下，国产化进程明显提速。在封装材料领域，传统封装材料基本实现国产化，而先进封装用光刻胶、TSV 填充材料、玻璃基板等成为新一轮技术竞争焦点。在制造材料领域，湿电子化学品、CMP 材料等已实现 14nm 及以上节点的批量供应，部分产品进入 7nm 制程验证阶段。

随着 7nm 及以下制程技术瓶颈显现，半导体产业正式进入“材料驱动”时代。HBM3E、Chiplet3D 堆叠、CoWoS-L 等先进封装技术的商业化应用，直接带动高纯电镀液、TSV/TGV 添加剂等材料需求激增。

（3）中国半导体材料行业进入以技术差异化、生态稳定性、供应链安全为核心的高质量发展阶段

近年来,中国半导体材料行业已告别“低价竞争”模式,进入以技术差异化、生态稳定性、供应链安全为核心的高质量发展阶段。国产化路径清晰化,在 8 英寸硅片、CMP 抛光材料、刻蚀液等细分领域已实现技术突破,而在 EUV 光刻胶、12 英寸硅片等高端材料上仍需攻坚,但技术差距正快速缩小。产业生态形成良性循环,在 AI、新能源汽车等产业驱动下,下游客户主动加大本土材料供应商扶持力度,推动“验证-导入-放量”周期缩短,“需求拉动-技术反哺”的正循环效应显现。

2、行业未来发展趋势

(1) 集成电路湿化学品行业概况及发展趋势

公司的电镀液、光刻胶配套试剂主要面向集成电路湿电子化学品市场。随着我国集成电路国产化进程的加深,在半导体工艺持续升级与下游应用领域的蓬勃发展的背景下,我国半导体材料行业将拥有广阔发展前景。根据中国电子材料行业协会(CEMIA)统计数据,2024 年中国集成电路用湿化学品总体市场规模达到 79.3 亿元,同比增长 10%,预计 2025 年将增长至 86 亿元。其中 2024 年中国集成电路前道晶圆制造(即前道工艺)用湿化学品市场规模 64.5 亿元,同比增长 9.7%。预计 2025 年中国集成电路前道晶圆制造用湿化学品市场规模将增长至 69.7 亿元。2024 年中国集成电路后道封装(即后道工艺,含传统封装与先进封装)用湿化学品市场规模 14.8 亿元,同比增长 11.3%。随着晶圆制造工艺的不断提升,对与之配套的封测技术同步要求提高,传统封装技术的发展将趋于平稳,先进封装技术的应用将进一步加强,对湿化学品的需求也将随之增加,预计 2025 年中国集成电路后道工艺用湿化学品市场规模将达到 16.3 亿元。

(2) 光刻胶行业概况及发展趋势

按曝光光源波长划分,光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。根据中国电子材料行业协会(CEMIA)的数据,当前我国 g/i 线光刻胶的国产化率 20%-25%,仍处于较低水平,KrF 光刻胶整体国产化率约 3%,ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%。

目前,AI 芯片、高带宽存储(HBM)、数据中心光互联(CPO)等市场持

续快速扩张。在三维集成与先进封装行业的高速发展下，先进封装对光刻胶及配套试剂的需求逻辑已发生根本性转变。过去，光刻胶需求主要跟随封装产量线性增长；如今，堆叠层数每翻一番，光刻工艺次数便大致翻倍，形成超线性增长的乘数效应。HBM 正从 8 层向 12 层、16 层演进，SK 海力士已展出全球首款 16 层 HBM4 样品。每一层 DRAM 堆叠都需要独立的光刻工艺，堆叠层数的指数级增长，直接驱动光刻胶及配套试剂的需求量呈超线性扩张。先进封装对光刻胶及配套试剂的需求逻辑，已从线性增长彻底转向以堆叠层数为自变量的超线性扩张新范式。

根据中国电子材料行业协会（CEMIA）统计数据，2024 年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模为 53.54 亿元，预计到 2025 年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模将达到 55.77 亿元；2024 年中国集成电路封装用光刻胶市场规模 11.56 亿元，预计到 2025 年市场规模将增长至 12.25 亿元；2024 年中国 OLED 用光刻胶市场规模 1.62 亿元，预计 2025 年中国 OLED 用光刻胶市场规模将增长至 1.95 亿元。

（四）发行人的行业竞争格局、市场地位及进入壁垒

1、发行人的行业竞争格局

公司从事的电子化学品属于功能湿化学品及光刻胶范畴。全球半导体功能湿化学品与光刻胶行业呈现高端被海外寡头垄断、中低端国产加速发展的分层竞争格局。功能湿化学品领域，美日欧企业凭借高纯配方、核心原料与认证壁垒牢牢掌控先进制程蚀刻液、清洗液、CMP 抛光液等高端市场，美国杜邦、日本石原、德国默克、巴斯夫等为全球第一梯队；韩国及中国台湾企业侧重存储与显示配套化学品，国内企业已在通用级湿化学品实现较高国产化，蚀刻液、清洗液等成熟制程产品逐步导入晶圆厂，但 28nm 及以下先进制程高端功能湿化学品仍依赖进口。

光刻胶行业集中度更高，日本东京应化、JSR、信越化学、富士胶片形成绝对垄断，占据全球七成以上市场，几乎垄断 KrF、ArF、EUV 高端光刻胶供应，欧美企业仅在特种光刻胶领域补缺，中国台湾、韩国企业聚焦面板及 PCB 低端光刻胶；国内市场呈现明显梯队分化，g/i 线成熟制程光刻胶已实现一定比例国

产业化，KrF 光刻胶进入批量供货与产能扩张阶段，ArF 光刻胶仍处于客户验证攻坚期，EUV 光刻胶暂处研发起步阶段。

2、行业主要竞争对手

（1）美国杜邦（DuPont de Nemours, Inc.）

美国杜邦（原名陶氏杜邦）系 2017 年 8 月，陶氏化学与杜邦公司完成对等合并后的一家控股公司。2019 年陶氏杜邦（DowDuPont Inc.）拆分为陶氏（DOW Inc.）、杜邦（Dupont de Nemours, Inc.）及科迪华农业科技（Corteva Agriscience）三家企业。美国杜邦公司从事包括化工、材料、膜产品等在内的综合业务，集中了原陶氏、原杜邦的特种产品业务，包括封装材料及解决方案。

（2）日本石原（Ishihara Chemical Co., LTD）

石原化学株式会社成立于 1920 年，是一家从事金属表面处理剂和设备、电子材料、汽车化工产品以及工业化工产品的开发、制造和销售的公司，其金属表面处理剂（表面处理）广泛应用于电子零部件以锡焊结合为目的的表面处理。

（3）日本 JSR

日本合成橡胶公司（JSR）总部位于日本东京，产品包括合成橡胶，乳胶和合成树脂等石油化学类化学品，涉及电子、精密加工、半导体、新能源、环境、医药等行业。日本 JSR 半导体部门致力于光刻胶和其它周边的材料、研磨液等 CMP 材料的开发、制造和销售，为半导体光刻胶的重要海外供应商之一。

（4）德国默克（Merck KGaA）

德国默克创建于 1668 年，总部位于德国达姆施塔特市（Darmstadt），下设有显示材料事业部、颜料和功能性材料事业部、先进技术事业部和集成电路材料事业部。2014 年，公司完成了对国际化工知名制造商安智电子材料（AZ）的收购，进一步扩大了其在亚洲市场的布局。德国默克在国内显示领域光刻胶市场占有率较高的市场份额。

（5）上海新阳

上海新阳成立于 2004 年，深圳证券交易所上市公司，总部位于上海。上海新阳主要从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售，同时开发配套的

专用设备，主要产品包括晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品、晶圆制造用清洗液系列产品、半导体封装用电子化学材料等。

（6）安集科技

安集科技成立于 2006 年，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的自主创新型高科技微电子材料企业，主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。安集科技产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。

（7）晶瑞电材

晶瑞电材成立于 2001 年，是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、新能源等行业，主要应用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺环节。

（8）天承科技

天承科技成立于 2010 年，主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售，其产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等，应用于沉铜、电镀、棕化、粗化、退膜、微蚀、化学沉锡等多个生产环节。

3、发行人的行业市场地位

在电镀液及配套试剂领域，公司通过持续的技术创新，产品性能指标已达到国际一流水准，部分关键参数实现行业领先，成功打破国外厂商长期垄断的市场格局，成为行业的引领者。目前，公司电镀液产品已构建起丰富且极具竞争力的产品矩阵，在传统封装和先进封装领域均实现了全品类覆盖，并成功实现晶圆 28nm、5-14nm 先进制程等高端应用领域的市场突破。

在光刻胶领域，公司以先进封装光刻胶、晶圆制造 PSPI 以及 OLED 阵列制造用光刻胶等特色工艺光刻胶为突破口，覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域，成功打破国外垄断，并逐步向先进制程延伸，如 ICA 光刻胶、KrF

光刻胶等。

4、发行人所处行业的壁垒

（1）技术壁垒

电子化学品行业属于化学、化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科，属于典型的技术密集型产业，产业链壁垒较高，对技术、工艺、专利等要求严格。

长期以来，以欧美和日本企业为代表的综合性材料厂商利用先发优势，掌握核心技术，并在研发和生产方面不断革新，同时实行非常严格的保密和专利保护措施，对新进入行业的企业构筑了难以突破的技术壁垒。特别是对于新产品开发而言，开发周期长、技术要求高，对企业的研发能力、技术水平和生产工艺提出了更高的要求。

（2）人才壁垒

公司所处行业具有很强的人才密集型特征，需要大批掌握电子化学品材料化学特性、综合性能及下游应用的高素质、高技能以及跨学科的专业技术人员，并且需要在长期实践工作中积累应用经验，以深刻理解生产工艺中的关键技术环节，开发出满足下游客户需求的产品。

全球范围内，欧美和日本等国外综合性材料厂商人才储备充足，而国内集成电路材料产业起步较晚，滞后的人才培养导致国内专业人才匮乏，构成新进入企业的主要壁垒之一。

（3）客户壁垒

公司产品作为半导体封装、晶圆制造以及显示面板等领域的关键材料，其产品质量、性能指标直接决定了终端产品的品质和稳定性，下游客户实施严格的供应商认证机制，只有通过严格的认证满足客户对质量标准和性能的要求，才能成为下游客户的合格供应商。

电子化学品行业认证周期较长，新产品从研发到正式投入产业化需要经历相当长的时间，需要通过客户长期的严格认证。产品一旦通过下游客户的认证，客户更换供应商时通常需要评估成本、所需的时间和对生产的影响，更换时间长、

成本高。因此供应商一旦通过下游客户的认证成为其合格供应商，就会形成相对稳定的合作关系。新进入企业只有在技术水平、供应价格、产品质量和后续服务等方面显著超过原有供应商，才有可能获得客户订单。

（4）资金壁垒

电子化学品行业前期研发投入大，实现量产及盈利周期较长，系资金密集型行业。研发投入、厂房建设、购置设备及市场拓展等方面均需要大量资金的支持，如果企业无法持续地投入资金进行技术更新和产品创新，将难以在激烈的市场竞争中保持领先地位。

（五）上下游行业之间的关联性及影响

公司所属行业的上游行业为基础化工材料、精细化工材料或有色金属（铜、锡等）。公司上游行业受到原油、煤炭及采矿冶金等行业的影响，原材料供应和价格也可能产生一定的波动。

公司产品主要应用于半导体封装、晶圆制造以及显示面板等领域，最终产品广泛应用于国民经济的各个领域，涵盖消费电子、通信设备、服务器与数据中心、工业控制及汽车电子等多个应用领域。国内集成电路产业在汽车电子、消费电子、人工智能等下游应用的带动下，预计将保持快速增长态势。

八、发行人主要业务的有关情况

（一）公司主营业务、主营产品或服务

1、公司主营业务

公司主营业务为电子化学品的研发、生产和销售。作为国内半导体材料领域的领军企业，公司始终锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道，以技术创新为核心驱动力深耕行业多年。凭借持续高强度的研发投入与关键技术突破，公司已构建起覆盖半导体全产业链的材料解决方案体系，不仅在半导体封装化学品领域成长为国内市场的核心主力供应商，更在晶圆制造领域已实现深度卡位，通过电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大核心业务板块，为先进制程芯片制造提供关键材料支撑，同时逐步向半导体显示及 IC 载板等高附加值领域延伸。目前，公司已成为国内少数具备半导体封装、晶圆制造和半导体显示全链条电子

材料供应能力的企业。

公司下游客户主要集中在集成电路及泛半导体领域，涵盖了中芯国际、京东方、华虹半导体、长鑫科技、臻鼎科技、长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微、日月新、奥特斯等行业知名企业。

2、主要产品及其用途

目前，公司产品主要包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂和电镀配套材料，主要产品具体情况如下：

（1）电镀液及配套试剂

①电镀液

电镀液是半导体制造过程中的核心材料之一，由主盐、导电剂及多种功能性电镀添加剂组成，其中电镀添加剂是调控镀层均匀性、致密性及微观形貌的关键核心，直接决定电镀工艺的最终性能表现。

随着半导体器件特征尺寸持续微缩至 5nm 及以下制程，以及先进封装技术如 3D IC、Chiplet 的快速迭代，不同应用场景对电镀液的配方精准度、杂质控制水平及性能适配性提出了严苛要求。公司凭借深厚的技术积累，打造了覆盖传统封装、先进封装、晶圆制造及玻璃基板、IC 载板、HDI 等全应用领域的电镀液产品矩阵，可针对不同工艺节点与封装形式提供定制化解决方案，满足半导体产业链各环节的高端制造需求。

按不同下游应用领域，公司电镀液主要产品的具体情况如下：

应用领域	主要产品	应用环节
传统封装、电子元件	主盐、导电剂、络合剂、添加剂等	芯片及电子元件的引脚表面镀锡
先进封装	高纯硫酸铜基液、电镀锡银添加剂、电镀铜添加剂等	先进封装中硅通孔（TSV）、再布线层（RDL）、微凸点（Bumping）等核心工艺
晶圆制造	28nm 大马士革铜互连工艺镀铜基液及添加剂，5-14nm 钴制程电镀基液及添加剂等	晶圆制造过程中高密度互连
HDI、IC 载板、玻璃基板等	快速填孔铜电镀液、高均匀性填孔电镀液、MSAP 用填孔铜电镀液、TGV 镀铜添加剂等	HDI、IC 载板填孔、玻璃基板通孔技术

传统封装领域，公司的电镀液产品主要应用于芯片引脚表面镀锡，主要为基于甲基磺酸的电镀体系。作为业务起点，公司传统封装用电镀液产品已完成全面

量产供应，引脚线镀锡电镀液系列产品市场占有率持续领先，确立了公司在传统封装材料市场的主导地位。

先进封装领域，随着集成电路向高密度、高性能方向演进，先进封装技术成为产业升级的核心驱动力。互连层数的持续增加，以及 RDL（再布线层）、铜柱等结构的广泛应用，推动铜互连材料需求快速增长；同时，2.5D/3D 集成封装（包括 HBM 封装、CoWoS 封装等形式）、混合键合、玻璃基板封装等尖端技术路线不断涌现，对电镀材料的配方精准度、工艺适配性提出了严苛要求。公司前瞻性布局先进封装全工艺链条，构建起覆盖硅通孔（TSV）、再布线层（RDL）、微凸点（Bumping）等核心工艺的完整产品矩阵。目前，高纯硫酸铜基液已实现先进封装头部客户的稳定供应，另有多项前沿产品已进入商业化关键阶段：电镀锡银添加剂（包括超低 α 粒子的锡浓缩液、锡阳极）小批量生产，并在多家头部客户同步验证中；电镀铜添加剂处于关键批次稳定性验证阶段；TSV 电镀添加剂在客户端测试验证中。

晶圆制造领域，全球半导体产业加速向 5nm 及以下先进制程演进，晶圆制造关键材料需求愈发迫切，大马士革工艺是实现高密度铜互连的核心技术，直接决定芯片的性能与良率。公司大马士革电镀铜添加剂覆盖 7–55nm 全制程节点，确保铜互连具有优异的填充能力与低缺陷率，可满足不同客户的工艺需求；针对 5–14nm 节点对互连阻抗和可靠性的更高要求，公司钴制程电镀液提供优异的电迁移耐受性与界面稳定性。目前公司 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂，5-14nm 钴制程电镀基液已在主流晶圆客户端小批量供货中，同步在头部存储客户端验证顺利；适应不同深宽比孔型的 TSV 工艺高速镀铜添加剂也在客户端验证中。

HDI、IC 载板、玻璃基板领域，随着 AI 芯片、汽车及消费电子驱动先进封装需求攀升，其市场规模也快速扩容。公司精准把握市场机遇，将电镀铜产品逐步推向 HDI、SLP、IC 载板、玻璃基板等高端应用领域，有效提高国产化率。目前，公司快速填孔镀铜产品已成功导入头部 HDI 和 SLP 供应链，实现批量供货。针对 IC 载板兼具高均匀性与精细图形能力的电镀工艺要求，公司专门开发了高均匀性填孔电镀液，可同时满足微孔填充与图形电镀的双重需求，大幅提升产品一致性与良率。公司 MSAP 用电镀配套试剂已在 IC 载板客户端实现批量供货，

MSAP 用填孔镀铜产品目前正处于 IC 载板客户端测试阶段；公司 TGV 镀铜添加剂应用于玻璃基板通孔技术中，亦在配合头部玻璃基板客户测试。

②电镀液配套试剂

公司电镀液配套试剂产品主要应用于传统封装及电子元件引脚表面镀锡工艺的前后处理以及晶圆制造大马士革铜互联制程中的清洗。

集成电路或电子元件在进入电镀前的加工处理和清理工序总称为电镀前处理。公司提供的电镀前处理化学品包括祛毛刺液、除油剂、活化剂等。在电镀后的加工处理和清理工序总称为电镀后处理。公司提供的电镀后处理化学品包括中和剂、退镀剂等。

晶圆制造大马士革铜互联制程中，大马士革电镀后通过 CMP（化学机械研磨）平坦化，研磨后需要清洗表面去除研磨粒子和其他颗粒。公司应用在技术节点 28nm 铜制程清洗液已进入量产放大阶段；新一代 PCMP 产品应用于技术节点 7nm 钴先进制程清洗液在客户端验证阶段。

（2）光刻胶及配套试剂

①光刻胶

公司以先进封装光刻胶、晶圆制造 PSPI 以及 OLED 阵列制造用光刻胶等特色工艺光刻胶为突破口，覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域，成功打破国外垄断，并逐步向先进制程延伸，如 ICA 光刻胶、KrF 光刻胶等。

先进封装领域，公司凭借技术与客户资源优势，已构建起极具竞争力的光刻胶产品矩阵，涵盖可应用于 GHI-line、I-line 光源的光刻胶产品，包括正性、化学放大型光刻胶及负性光刻胶，不同产品膜厚兼容 7-300 μm ，在 Bumping、RDL、TSV、finepitchRDL、 $\mu\text{Bumping}$ 、 μPad 、Mega Bumping 等先进封装核心工艺环节，正稳步构建光刻胶全场景产业化覆盖能力。同时，公司正加速推进用于 Bumping、WLCSP、2.5D/3D 封装的 PSPI 的验证与量产，产品包括高温固化、低温固化、超低温固化系列，其中低温 PSPI 在客户端小量产中，具备低应力、高可靠性及高分辨率的 PSPI 产品在客户端验证中。公司目标成为国内先进封装光刻胶和 PSPI 领域的主力供应商，全面提升国产光刻材料的市场渗透率。

晶圆制造领域，具有化学放大效能的 I-Line 光刻胶系列产品及可应用于功率器件的 PSPI 已实现小批量供货，并同步在多家头部客户，包括存储芯片厂商推广验证中。高深宽比 KrF 光刻胶（深宽比达 13:1）目前在客户端验证阶段，在高厚膜下，通过优化树脂和 PAG，提升分辨率，相应提高光刻胶深宽比，主要应用在 CIS 芯片、存储芯片中，力求填补国内空白。

半导体显示领域，公司 OLED 阵列用高感度 PFASFree 正性光刻胶，已顺利通过了头部面板客户的验证，并取得小批量供货订单，在多家 OLED 显示客户端同步验证中。另外公司在特色工艺光刻胶领域取得突破：负性光刻胶已成功拓展至玻璃基封装应用场景，获得头部客户量产订单。

②光刻胶配套试剂

先进封装要求在晶圆划片前融入封装工艺步骤，具体包括晶圆研磨薄化、RDL、Bumping 及 TSV 等工艺技术，涉及与晶圆制造相似的涂胶、显影、去胶、蚀刻等工序步骤。公司应用于先进封装领域光刻胶配套试剂已形成规模化供应，主要产品包括附着力促进剂、显影液、蚀刻液、去除剂等。

在晶圆制造领域，公司针对先进技术节点，用于光刻胶干法蚀刻后残留物去除的清洗液（PERR），适用铜/钴互联制程，正在晶圆客户端验证中。

（3）电镀配套材料

除电子化学品外，公司还可以提供电镀工艺配套的锡球、镍饼等阳极金属材料及阳极袋、退镀用胶条等辅材，以满足客户的整体需求。公司销售的锡球主要采用外协加工模式。

（二）主要业务经营模式

1、销售模式

公司产品销售为直销模式。公司建立了较为完善的市场营销体系，与国内多家知名半导体封测厂商、晶圆制造厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司的产品销售流程包括了解客户需求、取得测试机会、通过客户认证、通过终端客户测试（如有）、小规模量产（如有）及批量供货。

公司有能力为客户提供 Turnkey 整体解决方案，即除了提供实现特定功能相

匹配的电子化学品及配套材料外，还能够提供与产品相适应的应用工艺方案和技术支持等，使得相关产品能够适配不同客户的产线标准和生产工艺，满足下游产品的功能、质量要求。

2、生产模式

公司主要按照以销定产的总体原则安排生产计划，分为按计划生产和按需生产两种生产模式。在按计划生产的模式下，公司根据客户销售需求，综合考虑安全库存量和生产能力，制定生产计划。计划人员会根据近三个月的销售情况与销售部门确认后制定生产计划，一般情况下公司制定的生产计划能够满足客户的定期下单需求。按需生产的模式，是指在客户临时加单的情况下，公司根据临时加单的需求，针对性安排额外的生产计划。

3、采购模式

采购环节是公司品质控制和成本控制的关键环节。公司制定了《采购控制程序》《供应商管理办法》等制度对采购活动进行严格控制。

公司产品应用于集成电路、新型电子元件、显示面板及新能源等行业，生产所需原材料的规格、型号、品种繁多，因此公司原材料采购具有频率高、品类多的特点。公司报告期内主要原材料采购包括化工原料、金属材料及包材辅品等。

公司采购管理部负责开发供应商，组织对供应商的评审，建立合格供应商名录和档案，定期对供应商进行评定，及时调整合格供应商名单，实施动态管理。采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等向供应商下发采购订单。公司基于市场行情、向供应商询价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。

4、研发模式

公司研发流程主要包括以下过程：

（1）研发立项阶段

研发部门设立年度/月计划，以对研发项目实施总体规划。研发项目因市场调研情况及产品规划开立课题，由各产品事业部或研发部负责人收集信息、分析需求，并出具相关的需求报告，经研发总监或总经理审核通过后提交管理层会议审议，审议通过后进行相应的项目立项。项目通过可行性评估后，签发研发任务

至研发部。研发部负责人确定项目负责人，研发任务转化为研发计划。

（2）研发需求确认阶段

项目负责人根据研发计划的规划，确定研发的需求，主要包括以下内容：①产品的主要性能指标，主要来源于应用需求；②法律法规及国家相关强制性标准；③历史类似研发项目积累的适用信息；④新产品安全性和适用性至关重要的特性要求，如安全、包装、运输、贮存、环境、卫生等。

（3）产品设计及实验室小试阶段

项目负责人根据研发需求，在实验室内组织开展配方设计及测试评估工作，并根据测试结果优化调整配方。

（4）样品试制及研发验证阶段

研发部组织有关部门评审研发项目的阶段性结果。研发部负责人负责审核样品试制技术要求，并核准试制样品。试制完成的样品由研发部安排进行产品性能验证，样品检验合格的进入下一研发阶段。如不合格，研发部门分析技术原因，并重新试制或变更配方设计。

为确保产品能够满足客户的使用及预期用途要求，发行人送样至客户现场，使用客户的产线资源对样品进行验证。

（5）中试及产品认证阶段

研发部门完成工艺标准和控制标准的制定，并根据研发验证结果持续优化和调整产品，直至研发成果通过客户实际产线测试，完成最终产品认证。

（三）生产、销售情况和主要客户

1、产能、产量及销售情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量、销量及产能利用率、产销率情况如下表所示：

项目	产品类别	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	产能（吨）	13,000.00	13,000.00	12,500.00
产量	电镀液及配套试剂	4,753.84	3,840.26	3,458.18

项目	产品类别	2025 年度	2024 年度	2023 年度
(吨)	光刻胶及配套试剂	6,801.27	5,229.60	3,419.53
	其他电子化学品	-	9.07	14.43
	合计	11,555.11	9,078.93	6,892.14
销量 (吨)	电镀液及配套试剂	4,629.03	3,737.89	3,383.89
	光刻胶及配套试剂	7,734.86	5,070.66	3,055.53
	其他电子化学品	-	9.68	13.62
	合计	12,363.89	8,818.23	6,453.04
产能利用率		80.86%	63.61%	50.34%
产销率		107.00%	97.13%	93.63%

注：上表中产量及销量不包括外购产品；为保持数据口径统一，在计算产能利用率剔除外协产品产量。

2、主要客户情况

报告期各期，公司前五名客户及其销售情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售金额	销售占比
2025 年度	1	第一名	11,553.94	19.50%
	2	第二名	5,142.76	8.68%
	3	第三名	3,628.98	6.12%
	4	第四名	2,613.21	4.41%
	5	第五名	1,876.99	3.17%
	合计		24,815.88	41.87%
2024 年度	1	第一名	9,773.77	22.61%
	2	第二名	4,294.02	9.94%
	3	第三名	3,300.26	7.64%
	4	第四名	1,628.23	3.77%
	5	第五名	1,497.17	3.46%
	合计		20,493.44	47.42%
2023 年度	1	第一名	8,009.80	22.25%
	2	第二名	3,805.71	10.57%
	3	第三名	2,261.39	6.28%
	4	第四名	2,243.54	6.23%
	5	第五名	1,545.95	4.29%

年度	序号	客户名称	销售金额	销售占比
		合计	17,866.39	49.62%

报告期各期，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 49.62%、47.42%和 41.87%，客户集中度保持在合理水平。

（四）采购情况和主要供应商

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司采购的原材料包括化工类、金属类和包材辅品三大类，其中，化工类主要包括甲基磺酸锡、硫酸亚锡、甲基磺酸、环戊酮、甲基吡咯烷酮、硫酸钡、磷酸、钠盐等化学品；金属类主要包括锡材（锭）、镍饼、镍珠、钢珠等固体金属；包材辅品主要包括塑料桶、一体盖、过滤芯及备品备件等。报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

单位：万元

类别	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
化工类	20,446.35	54.41%	13,869.58	48.55%	12,032.56	52.28%
金属类	14,012.02	37.29%	12,317.20	43.12%	9,163.92	39.82%
包材辅品	3,117.34	8.30%	2,380.37	8.33%	1,819.60	7.91%
合计	37,575.71	100.00%	28,567.14	100.00%	23,016.08	100.00%

注：上表中采购额包括主营业务相关的原材料、辅料及外协加工等采购内容，不包括其他业务中设备贸易业务相关采购，下同。

2、主要能源耗用情况

报告期内，公司耗用的能源主要为电和水，具体耗用情况如下：

类别	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
电	用量（万度）	939.79	535.24	270.79
	采购金额（万元）	732.67	442.33	208.86
水	用量（吨）	44,740.00	50,410.60	26,855.40
	采购金额（万元）	16.56	19.83	9.82

3、主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	采购金额	采购占比
2025 年度	1	第一名	11,012.37	29.31%
	2	第二名	2,037.30	5.42%
	3	第三名	1,845.46	4.91%
	4	第四名	1,501.48	4.00%
	5	第五名	867.88	2.31%
	合计		17,264.49	45.95%
2024 年度	1	第一名	11,857.02	41.51%
	2	第二名	819.49	2.87%
	3	第三名	727.41	2.55%
	4	第四名	690.39	2.42%
	5	第五名	547.16	1.92%
	合计		14,641.46	51.25%
2023 年度	1	第一名	8,827.11	38.35%
	2	第二名	1,556.32	6.76%
	3	第三名	841.00	3.65%
	4	第四名	535.21	2.33%
	5	第五名	473.22	2.06%
	合计		12,232.86	53.15%

报告期内，公司主要供应商保持稳定。报告期各期，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 53.15%、51.25%和 45.95%。公司不存在向单个供应商采购比例超过 50%的情况，不存在严重依赖少数供应商的情况。

（五）境外采购、销售情况

1、境外采购

报告期内，公司境内外采购情况及占比情况如下：

单位：万元

类别	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内采购	34,532.37	91.90%	28,481.27	99.70%	22,944.12	99.69%
境外采购	3,043.34	8.10%	85.87	0.30%	71.96	0.31%
合计	37,575.71	100.00%	28,567.14	100.00%	23,016.08	100.00%

报告期各期，公司境外采购金额占比分别为 0.31%、0.30%和 8.10%，境外采购比例较低。2025 年度，公司境外采购金额大幅增加，主要为马来西亚子公司 INOFINE 的境外采购。公司境外采购涉及的原材料均为非受限产品，采购来源不存在障碍。

截至本募集说明书签署日，公司主要境外采购地的出口贸易政策未对公司生产经营造成重大不利影响或重大不确定风险。

2、境外销售

报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元

类别	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内销	50,222.50	87.50%	39,257.46	93.68%	32,657.63	94.70%
外销	7,172.27	12.50%	2,646.79	6.32%	1,828.72	5.30%
合计	57,394.77	100.00%	41,904.25	100.00%	34,486.36	100.00%

报告期内，公司主营业务收入以内销为主。2025 年度，公司外销收入同比增长 170.98%，收入大幅增长，主要系完成马来西亚 INOFINE 80%股权的收购，INOFINE 纳入合并范围所致。

（六）安全生产及污染治理情况

公司主要产品的生产过程为配方型复配工艺，以复配、混合、过滤等工艺为主，生产环节不存在高危险、重污染的情况。

公司及子公司报告期内严格遵守安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发生重大安全事故，也不存在安全生产方面的行政处罚。

针对生产过程中少量“三废”排放，公司已采取相应的防治措施，以确保污染物的排放符合相关法律法规的要求。2025 年 5 月，南通艾森因雨水窖井内的污水管道破损，导致发生生活污水渗透至雨水系统并对外排放的情况。公司发现后已对破损的生活污水管道进行了修复，并对厂区的雨水管网进行了全面清理冲洗。南通经济技术开发区生态环境局于 2025 年 7 月针对上述事项对南通艾森进行责令整改，并罚款 1.06 万元，南通艾森已及时足额缴纳上述罚款并完成整改。

关于该笔行政处罚的具体情况参见本募集说明书“第六节 合规经营与独立性”之“一/（一）发行人报告期内重大违法违规行为及行政处罚的情况”。

除上述情况外，报告期内公司不存在其他因违反有关环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情况，污染处理设施运转正常有效，未发生环保事故。

（七）现有业务发展安排及未来发展战略

1、现有业务发展安排

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务，围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局。

公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应半导体制造关键材料本土化发展趋势，经过多年努力，公司逐步取代国外材料公司成为传统封装电镀化学品领域的国内主力供应商，并逐步向先进封装、晶圆制造及显示面板等领域延伸，成为国内少数能同时覆盖半导体封装、晶圆制造和半导体显示的全链条电子材料公司。

公司将进一步加强在电子化学品材料的应用领域创新，积极开拓新的产业应用场景；在现有核心技术、产品以及市场资源的基础上，加强研发升级，强化在电镀液及配套试剂方面的优势；集中研发人才资源，加大光刻胶的研发和技术储备，进一步拓展产品线，确立在中国电子化学品材料行业的领先地位；重点聚焦晶圆制造用光刻胶、显示面板用光刻胶及配套试剂，通过持续的技术创新与工艺创新，实现核心技术持续迭代，快速满足客户日益增长的高端功能需求，打造国际先进水平的功能性材料服务能力，进一步夯实公司在电子化学品材料领域的产品竞争力和品牌影响力。

2、未来发展战略

公司以“成为全球领先的半导体关键材料供应商”为战略锚点，聚焦先进封装与晶圆制造两大核心赛道，构建“电镀液+光刻胶”双轮驱动的产品矩阵，通过技术创新、人才驱动、研发升级与规范运作，全面提升公司核心竞争力，为实现长期战略目标奠定坚实基础。

（1）研发投入与技术创新

持续投入光刻胶领域，重点推进 KrF 光刻胶、超高感度 PSPI 光刻胶及先进封装系列光刻胶的技术迭代与稳定量产；完善“树脂设计-合成-纯化-光刻胶配方-工艺验证”全链条研发体系，加大光刻胶树脂自研自产力度；电镀液领域，推动 28nm、14nm 及以下晶圆制造电镀产品的稳定量产；优化添加剂配方，进一步提升产品稳定性与性能表现。与国内知名高校、科研机构建立长期深度合作，共建半导体材料研发实验室，引进行业顶尖技术人才，持续扩充研发团队规模，筑牢技术创新根基。

（2）产品竞争力提升与市场拓展

公司将持续深化与盛合晶微、长电科技、华天科技、通富微电等国内头部封装客户的合作。晶圆制造领域，公司将重点突破中芯国际、华虹集团等客户，实现 28nm 制程电镀液批量供货，并逐步向 14nm 及以下制程渗透。存储芯片领域，适配 HBM、3DNAND 等先进存储技术需求，目标成为国内存储芯片材料核心供应商；半导体显示领域，加快 OLED 光刻胶客户验证进度，实现向华星光电、京东方等头部企业批量供货，并拓展至海外面板企业。

（3）持续深化国际化战略

2025 年起，马来西亚子公司 INOFINE 正式纳入合并报表范围，成为公司开拓东南亚及全球市场的核心支点。INOFINE 在当地拥有成熟的客户资源与渠道优势，借助其本土团队，公司将光刻胶、电镀液等核心产品推向海外市场，填补东南亚高端半导体材料供给缺口，海外业务成为未来盈利增长的重要部分。未来，公司将以 INOFINE 为桥头堡，深化渠道建设、扩大国际客户覆盖，并提升全球供应链韧性。

（4）加快产能布局，支撑未来增长

公司公告拟投资建设“艾森集成电路材料华东制造基地项目”，规划年产 23,000 吨集成电路材料，涵盖光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等产品，其中一期项目为本次募集资金投资项目。项目建成后，将与昆山基地、南通基地、东南亚基地形成“国内+海外”的全球化产能网络，匹配光刻胶、先进制程电镀液等高端产品的市场爆发需求，有效缩短产品交付周期；同时通过光刻胶产业链

闭环、先进制程材料配套与现有业务形成深度协同，进一步巩固公司在高端封装光刻胶领域的领先地位，实现“技术突破-产能落地-市场扩张”的正向循环，为公司长期高速增长筑牢核心支撑。

九、与产品或服务有关的技术情况

（一）研发投入情况

报告期内，公司聚焦光刻胶、先进制程电镀液等高端产品的技术攻关，持续加大研发投入。报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	6,942.21	4,590.17	3,268.79
营业收入	59,264.37	43,218.84	36,003.93
占比	11.71%	10.62%	9.08%

公司报告期内研发投入有效提升了公司的整体研发能力。报告期内，公司累计获得已授权专利 29 项，其中发明专利 24 项，均应用于公司主营业务。

（二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术及其应用情况

报告期内，公司研发形成的重要专利及其应用情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	应用于生产或服务的环节
1	具有高附着力的 PCB 板制程用 UV 固化喷墨打印油墨	发明专利	ZL202011494678.1	2023-5-9	应用于 PCB 板制程中喷墨打印工序的油墨制备及电路板表面标识、字符喷印环节的 UV 固化处理。
2	一种超支化聚酰亚胺树脂及其制备方法和应用	发明专利	ZL202111491623.X	2023-7-7	应用于半导体封装、柔性电路板制程中的绝缘涂层、保护膜制备。
3	一种厚膜负性光刻胶及配胶方法	发明专利	ZL202210909623.5	2023-6-13	应用于先进半导体封装制程中的晶圆级封装、凸点制备、再布线工艺等工艺环节。
4	一种应用于芯片封装工艺的高膜厚负性光刻胶	发明专利	ZL202011491006.5	2023-8-1	应用于先进半导体封装制程中的晶圆级封装、凸点制备、再布线工艺等工艺环节。
5	一种半导体被动元件封装用绝缘油墨、制备方法及应用	发明专利	ZL202210836641.5	2023-9-22	应用于电阻、电容、电感等半导体被动元件的封装绝缘层制备环节。
6	感光性聚酰亚胺	发明	ZL202211663749.5	2023-9-12	应用于半导体封装、柔性电子

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	应用于生产或服务的环节
	组合物、图形的制造方法、固化物和电子部件	专利			的绝缘涂层制备、保护层制备、芯片表面钝化层涂覆及柔性电子器件绝缘保护层涂覆固化工序环节。
7	一种光刻胶去胶液及其制备方法和应用	发明专利	ZL202011486530.3	2023-11-21	应用于光刻工艺后的去胶环节
8	感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	ZL202310402271.9	2024-12-20	应用于半导体封装、柔性电子的绝缘涂层制备、保护层制备、芯片表面钝化层涂覆及柔性电子器件绝缘保护层涂覆固化工序环节。
9	一种负性感光性聚酰亚胺组合物、图形的制造方法以及电子部件	发明专利	ZL202210491940.X	2024-12-20	应用于半导体及微电子加工环节，用于负性光刻工艺形成聚酰亚胺图形，满足精细线路和热稳定性要求。
10	感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	ZL202310403361.X	2025-2-7	应用于半导体封装、柔性电子的绝缘涂层制备、保护层制备、芯片表面钝化层涂覆及柔性电子器件绝缘保护层涂覆固化工序环节。
11	具有低温交联和低弹性模量的感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	ZL202310403373.2	2025-2-7	应用于对热敏感基材上的聚酰亚胺图形化环节，实现低温固化并降低内应力，适用于柔性电子或先进封装。
12	一种用于先进封装负性厚膜光刻胶	发明专利	ZL202211411263.2	2025-2-11	应用于 2.5D/3D 先进封装制程中的厚膜光刻、再布线、凸点工艺、高深宽比图形制备、晶圆级封装再布线层光刻及凸点制备工序环节。
13	感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	ZL202310403034.4	2025-2-18	应用于半导体封装、柔性电子的绝缘涂层制备、保护层制备、芯片表面钝化层涂覆及柔性电子器件绝缘保护层涂覆固化工序环节。
14	感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	ZL202310403043.3	2025-2-25	应用于半导体封装、柔性电子的绝缘涂层制备、保护层制备、芯片表面钝化层涂覆及柔性电子器件绝缘保护层涂覆固化工序环节。
15	一种负性感光性聚酰亚胺组合物、图形的制造方法以及电子部件	发明专利	ZL202210494614.4	2025-6-13	应用于半导体微纳加工与先进封装中的图形化绝缘层制备、微纳结构绝缘层光刻及先进封装再布线层图形化加工工序环节。
16	一种电镀液及其	发明	ZL202111227	2023-6-20	应用半导体封装中的大马士革

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	应用于生产或服务的环节
	应用、镀铜工艺及镀件	专利	990.9		电镀、通孔镀铜、高密度线路板通孔镀铜及半导体封装大马士革结构铜层沉积工序环节。
17	动态阳极遮挡结构	发明专利	ZL202210572164.6	2024-4-16	应用于半导体电镀工艺中的阳极防护、电镀过程中阳极电流分布调控及镀层厚度均匀性优化工序环节。
18	半导体被动元件封装用油墨及其制备方法、器件及设备	发明专利	ZL202310910550.6	2025-9-26	应用于半导体被动元件封装过程中的标识制备、绝缘涂层制备、元件表面标识印刷及封装绝缘层涂覆固化工序环节。
19	一种封装用油墨及其制备方法、器件及设备	发明专利	ZL202410222597.8	2025-10-3	应用于电阻、电容等被动元件封装的表面印刷、绝缘防护、元件标识喷印及封装绝缘层涂覆与固化工序环节。
20	一种高附着力且弯折性好的UV喷印油墨	发明专利	ZL202110979943.3	2023-6-30	应用柔性电路板制程中的表面标识、字符喷印、柔性基材表面字符喷印、UV快速固化及弯折性标识制备工序环节。
21	一种丙烯酸树脂、光刻胶及其制备方法与应用	发明专利	ZL202211548780.4	2025-1-28	应用于半导体制程中的光刻胶制备、微纳图形化加工、光刻胶树脂合成、半导体微纳结构光刻工序环节。
22	高速光亮电镀添加剂及电镀液	发明专利	ZL202310111768.5	2025-2-7	应用于半导体封装及电子元件制造中的高速电镀、光亮镀铜、线路板线路电镀及电子元件表面光亮镀层制备工序环节。
23	一种蚀刻液组合物及其应用	发明专利	ZL202310291744.2	2025-10-21	应用于半导体制造的金属层蚀刻、线路图形蚀刻、晶圆表面蚀刻及电路板多余金属层去除工序环节。
24	一种光敏性树脂组合物及其应用	发明专利	ZL202310230128.6	2025-11-28	应用于半导体封装微纳加工中的光敏层制备、图形化光刻、绝缘层光刻及精细线路图形化加工工序环节。

报告期内，公司研发形成的重要非专利技术及其应用情况如下：

序号	技术名称	技术先进性及具体表征	技术来源	应用情况
1	晶圆制造用PSPI制备及应用技术	1、满足6吋、8吋晶圆制造工艺主流应用要求，多项指标达到国际竞品水平，已完成客户认证并小批量供应； 2、自主设计开发PSPI树脂结构，开发聚合过程控制技术，有效对PSPI树脂的批次稳定性进行控制，核心指标波动<0.1%； 3、采用PSPI树脂、架桥剂、光敏剂等，获得了优异机械性能、高热稳定性、高韧性、高可靠性的膜，满	自主研发	用于功率半导体器件应力缓冲层及平坦绝缘层

序号	技术名称	技术先进性及具体表征	技术来源	应用情况
		足功率半导体器件制造的要求； 4、引入嵌段共聚方法，和架桥剂形成协同作用，相较于竞品，进一步降低了 PSPI 在后固化过程中产生的残余热应力； 5、采用特殊的增黏剂，有效的增加 PSPI 和基材的粘附性。		
2	化学放大型高感度 PSPI 制备及应用技术	1、满足 12 吋晶圆制造工艺主流应用要求，多项指标达到国际竞品水平，满足客户需求； 2、自主设计开发改性 PSPI 树脂结构，其 ADR<100A/s。开发聚合过程控制技术，有效对 PSPI 树脂的批次稳定性进行控制，核心指标波动<0.1%； 3、采用 PSPI 树脂、产酸剂、架桥剂等，获得了极高感度（<150mJ/cm ² @10μmF.T.），优异机械性能、高热稳定性、高韧性、高可靠性的膜，满足功率半导体器件制造的要求； 4、采用特殊的增黏剂，有效的增加 PSPI 和基材的粘附性。	自主研发	用于 12 吋晶圆制造的应力缓冲层及平坦化绝缘层
3	先进封装用 PSPI 制备及应用技术	1、满足 8 吋、12 吋晶圆 Bumping、RDL 工艺主流应用要求，多项指标达到国际竞品水平； 2、自主设计开发 PSPI 树脂结构，其金属离子含量<100ppb，氯含量<1ppm。开发聚合过程控制技术，有效对 PSPI 树脂的批次稳定性进行控制，核心指标波动<0.1%； 3、采用 PSPI 树脂、交联剂、光引发剂等，获得了优异机械性能、高热稳定性、高韧性、高可靠性的膜，满足先进封装制造的要求； 4、采用特殊的增黏剂，有效的增加 PSPI 和各种基材的粘附性。	自主研发	用于先进封装应力缓冲层、平坦绝缘层、RDL 层间绝缘层等
4	高 AR 比厚膜 KrF 光刻胶制备及应用技术	1、采用特殊 PHS 类型树脂及光致产酸剂（PAG）实现厚膜条件下的高透过性，以形成陡直的侧壁，使光刻图形的纵横比达到较高的数值； 2、采用新型表面活性剂，提升高厚膜的涂布均一性，光刻胶涂布后的膜厚差异<1.5%； 3、调整使用新型 PAG，控制阴离子大小即 H ⁺ 扩散能力，提高 KrF 光刻胶的 DOF 和 EL； 4、采用低金属含量的纯化溶剂和其他组分，控制金属离子浓度低于 10ppb，满足晶圆厂生产需求。	自主研发	用于晶圆制造的光刻工艺
5	树脂生产工艺技术	1、不同光刻胶用树脂的性能指标存在明显差异，基于大量实验数据及经验针对不同产品，选取最优工艺路线，以满足光刻胶应用需求； 2、对各工艺段分别制定不同的检测方式和标准，细化各工艺段的需求，明确各工艺段与树脂性能之间的联系，充分保障生产工艺的稳定性。	自主研发	通过各阶段工艺路线设计和优化，选用合适生产工艺完成对应树脂的稳定量产
6	高厚膜 i/g 线化学放	1、创新性的丙烯酸树脂结构设计以实现良好润湿性/脱保护后的高碱溶性/合理的模量等应用指标；	自主研发	用于高分辨率的凸

序号	技术名称	技术先进性及具体表征	技术来源	应用情况
	大光刻胶制备及应用技术	2、高分辨率可实现 70um 膜厚下的 10umvia 制作； 3、高感度：400mj/cm2 曝光能量实现 50um 膜厚的曝光，600mj/cm2 曝光能量实现 70um 膜厚的曝光； 4、高垂直度及完美形貌。		块/微凸块制作
7	超高厚度凸块制作用 g/h 线负性制备及应用技术	1、高透明的丙烯酸树脂架构设计及高效光引发剂的应用实现超高膜厚下的光透过及高引发效率； 2、高感度及高分辨率的兼顾：1400mj/cm2 曝光能量可实现 240um 膜厚的曝光和 60um via 的制作； 3、高垂直度和完美形貌。	自主研发	用于超高厚度铜凸块制作，光刻胶膜厚达 240~300um
8	细线宽 RDL 制作用化学放大 i 线光刻胶制备及应用技术	1.带保护基团的丙烯酸树脂架构设计及高效产酸剂的应用实现膜厚和线宽的兼顾，4um 膜厚下可实现亚微米级线宽的 RDL 制作/6um 膜厚下可实现 1.5um 细线宽 RDL 制作； 2.特殊结构的防锈剂引入实现铜与酸反应的遏制以避免底部 footing 不良，同时不对显影/去胶产生负面影响。	自主研发	用于超细线宽的多层 RDL 制作
9	晶圆制造用 i 线光刻胶制备及应用技术	1、采用特殊结构酚醛树脂、光致产酸剂 PAG 和交联剂体系，实现 4~6um 膜厚下高陡直度图形的形成以及优秀的 CD 均一性控制，达到 2um±0.08um； 2、采用低金属含量的纯化溶剂和其他组分，控制金属离子浓度低于 10ppb，满足晶圆厂生产需求； 3、采用高活性 PAG 和高活性交联剂，加快光照后，热固化速率，提高光刻胶对比度，分辨率可达 1.5um 以内。	自主研发	用于晶圆制造的光刻工艺

(三) 核心技术人员、研发人员情况

1、公司研发人员情况

公司拥有一支专业的研发人才队伍，截至 2025 年末，公司共有研发人员 101 名，占公司员工总数的 41.06%。报告期各期末，公司研发人员人数及占比情况如下：

单位：人

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发人员	101	78	61
员工总数	246	207	177
占比	41.06%	37.68%	34.46%

2、核心技术人员情况

截至 2025 年末，公司核心技术人员包括向文胜、赵建龙、杜冰、刘斌和胡青华。报告期内，公司核心技术人员保持稳定，变动主要为 2025 年 4 月新增认

定刘斌为核心技术人员。公司核心技术人员介绍详见本节“六/（二）/3、核心技术人员”。

（四）核心技术来源及其对发行人的影响

截至本募集说明书签署日，公司共有核心技术 25 项，除 OLED 光刻胶制备及应用技术系在受让技术的基础上自主研发，其他核心技术均来源于公司及研发团队的自身积累、自主研发，各项核心技术所对应的专利均为发行人及子公司自主申请，不存在争议或纠纷。

公司核心技术均应用于公司的主要产品及服务，提升了公司产品的竞争优势，为公司的可持续发展提供了技术保障。

十、主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具等，上述资产使用状况良好，可满足公司生产经营需要。截至 2025 年末，公司固定资产原值 48,954.18 万元，累计折旧 9,812.35 万元，固定资产账面价值 39,141.83 万元，固定资产成新率为 79.96%。

截至 2025 年末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	20,910.14	3,166.01	17,744.13	84.86%
机器设备	26,975.36	6,149.28	20,826.08	77.20%
运输工具	357.65	172.82	184.83	51.68%
通用设备	711.03	324.24	386.80	54.40%
合计	48,954.18	9,812.35	39,141.83	79.96%

1、房屋所有权

截至本募集说明书签署日，公司及境内子公司共拥有 4 项房屋所有权，具体情况如下：

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	用途	他项 权利
1	艾森股份	苏(2021)昆山市不动产权第3025088号	昆山市千灯镇黄浦江路1647号	4,207.61	门卫配电泵房消防水池、厂房、仓库	无
2	艾森股份	苏(2024)昆山市不动产权第3052105号	昆山市千灯镇中庄路299号	6,997.09	厂房	无
3	艾森股份	苏(2024)昆山市不动产权第3006102号	昆山市千灯镇中庄路299号	9,387.60	配电间、厂房	无
4	南通艾森	苏(2023)南通开发区不动产权第0018102号	通达路86-1号	14,035.43	综合楼(含控制室)、公用工程楼(含地下消防水池)、甲类车间、甲类仓库(含危废库)、丙类仓库一、丙类仓库二(含固废库)	无

截至本募集说明书签署日，公司境外子公司在中国境外拥有3处自有物业，具体情况如下：

序号	所有权人	土地使用权及地上物所有权证书	坐落	面积(平方米)	土地性质	建成区域面积(平方英尺)
1	INOFINE	HSD52219	位于槟城州威南县第12区，地号为Lot20416	1,382	永久产权	6,673
2	INOFINE	HSD52231	位于槟城州威南县第12区，地号为Lot20428	1,382	永久产权	6,673
3	INOFINE	HSD52232	位于槟城州威南县第12区，地号为Lot20429	1,382	永久产权	6,673

2、租赁物业情况

截至本募集说明书签署日，发行人及其境内子公司用于生产经营的租赁房产共计3处，为艾森世华及武汉艾森租赁的房产，具体情况如下：

序号	承租人	出租人	地址	租赁期限	面积(平方米)
1	艾森世华	昆山书豪仪器科技有限公司	昆山市千灯镇石浦中节路419号1#和2#厂房一层	2023.6.10-2030.2.28	2,500
2	艾森世华	昆山金千灯投资发展集团有限公司	昆山市千灯镇少卿东路169号2号房(昆山精细材料产业园管理办公室大院内)	2025.11.1-2026.10.31	42
3	武汉艾森	武汉光谷科创服务有限公司	光谷筑芯科技产业园2#A座10层1001室	2026.3.1-2029.2.28	279

截至本募集说明书签署日，产权人已就上述租赁物业取得产权证书，上述第1项、第2项租赁物业的出租方即为产权人；上述第3项租赁物业的出租方为武汉光谷科创服务有限公司，产权人为武汉光谷集成电路发展有限公司，根据武汉光谷集成电路发展有限公司与武汉光谷科创服务有限公司签署的《房屋租赁合同》，武汉光谷科创服务有限公司有权在租赁期限内（2024年11月1日至2034年10月31日）将租赁物业转租给其他主体，前述《房屋租赁合同》中亦未约定转租需要产权人同意的条款。

截至本募集说明书签署日，公司境外子公司租赁房产共计2处，具体情况如下：

序号	承租人	出租人	坐落	主要用途	租期
1	INOFINE	Chan Yoke Lan	马来西亚雪兰莪州莎阿南市，U5区，坪格兰梳邦镇，阿波罗U5/189路，12号（以下简称“阿波罗物业”）	各类化学相关产品的贸易	2024年3月1日至2027年2月28日
2	INOFINE	Miles & Universal Sdn Bhd	马来西亚雪兰莪州双溪毛糯，爱美那商业园，乌沙哈万2/1路，31号（以下简称“爱美那物业”）	各类化学相关产品的办公及仓储（以贸易为目的）	2025年8月1日至2027年7月31日

根据境外法律意见书，截至境外法律意见书出具之日：“INOFINE 目前承租的阿波罗物业和爱美那物业受租赁协议约束，该等租赁协议依据马来西亚法律合法有效”。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，公司及境内子公司拥有的土地使用权如下：

序号	所有权人	证号	坐落	地类（用途）	权利性质	土地使用权面积（m²）	他项权利
1	艾森股份	苏（2021）昆山市不动产权第3025088号	昆山市千灯镇黄浦江路1647号	工业（仓储）	出让	6,666.7	无
3	艾森股份	苏（2024）昆山市不动产权第3052105号	昆山市千灯镇中庄路299号	工业用地	出让	2,594.10	无
3	艾森股份	苏（2024）昆山市不动产权第3006102号	昆山市千灯镇中庄路299号	工业用地	出让	3,450.40	无

序号	所有人	证号	坐落	地类（用途）	权利性质	土地使用权面积（m²）	他项权利
4	南通艾森	苏（2023）南通开发区不动产权第0018102号	通达路86-1号	工业用地	出让	20,052.03	无

截至本募集说明书签署日，公司境外子公司在中国境外拥有 3 处土地所有权，具体情况如下：

序号	所有权人	土地使用权及地上物所有权证书	坐落	面积（平方米）	土地性质	建成区域面积（平方英尺）
1	INOFINE	HSD52219	位于槟城州威南县第 12 区，地号为 Lot20416	1,382	永久产权	6,673
2	INOFINE	HSD52231	位于槟城州威南县第 12 区，地号为 Lot20428	1,382	永久产权	6,673
3	INOFINE	HSD52232	位于槟城州威南县第 12 区，地号为 Lot20429	1,382	永久产权	6,673

根据境外法律意见书，截至最后实际可行日期，“据 INOFINE 所知，INOFINE 目前拥有的所有土地均不存在任何可能对该等土地权益造成不利影响的抵押、权利负担、索偿、主张、司法指令或各类书面告知”。

2、商标

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司共拥有 4 项商标权，具体情况如下：

序号	权利人	注册号	图案	类别	有效期限
1	艾森股份	5606834	ASEM	40	2029-12-13
2	艾森股份	61479192	GASEM	42	2032-6-6
3	艾森股份	61490492	GASEM	2	2032-6-13
4	艾森股份	61490788	GASEM	1	2032-6-13

3、专利

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司共拥有 57 项境内已授权专利，均已取得国家知识产权局出具的《专利证书》，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	权利期限	取得方式
1	艾森股份、南通艾森	一种封装用油墨及其制备方法和应用、器件及设备	发明专利	2024102225978	自 2024 年 2 月 28 日起 20 年	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	权利期限	取得方式
2	艾森股份、南通艾森	半导体被动元件封装用油墨及其制备方法、器件及设备	发明专利	2023109105506	自 2023 年 7 月 24 日起 20 年	原始取得
3	艾森股份	一种负性感光性聚酰亚胺组合物、图形的制造方法以及电子部件	发明专利	2022104946144	自 2022 年 5 月 7 日起 20 年	原始取得
4	艾森股份	感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	2023104030433	自 2023 年 4 月 14 日起 20 年	原始取得
5	艾森股份	感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	2023104030344	自 2023 年 4 月 14 日起 20 年	原始取得
6	艾森股份	一种用于先进封装负性厚膜光刻胶	发明专利	2022114112632	自 2022 年 11 月 11 日起 20 年	原始取得
7	艾森股份	具有低温交联和低弹性模量的感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	2023104033732	自 2023 年 4 月 14 日起 20 年	原始取得
8	艾森股份	感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	202310403361X	自 2023 年 4 月 14 日起 20 年	原始取得
9	艾森股份	感光性聚酰亚胺组合物、固化物和电子部件	发明专利	2023104022719	自 2023 年 4 月 14 日起 20 年	原始取得
10	艾森股份	一种负性感光性聚酰亚胺组合物、图形的制造方法以及电子部件	发明专利	202210491940X	自 2022 年 5 月 7 日起 20 年	原始取得
11	艾森股份	动态阳极遮挡结构	发明专利	2022105721646	自 2022 年 5 月 24 日起 20 年	继受取得
12	艾森股份	一种光刻胶去胶液及其制备方法和应用	发明专利	2020114865303	自 2020 年 12 月 16 日起 20 年	原始取得
13	艾森股份	一种半导体被动元件封装用绝缘油墨、制备方法及应用	发明专利	2022108366415	自 2022 年 7 月 15 日起 20 年	原始取得
14	艾森股份	感光性聚酰亚胺组合物、图形的制造方法、固化物和电子部件	发明专利	2022116637495	自 2022 年 12 月 23 日起 20 年	原始取得
15	艾森股份	一种应用于芯片封装工艺的高膜厚负性光刻胶	发明专利	2020114910065	自 2020 年 12 月 17 日起 20 年	原始取得
16	艾森股份	一种超支化聚酰亚胺树脂及其制备方法和应用	发明专利	202111491623X	自 2021 年 12 月 8 日起 20 年	原始取得
17	艾森股份	一种电镀液及其应用、镀铜工艺及镀件	发明专利	2021112279909	自 2021 年 10 月 21 日起 20 年	继受取得
18	艾森股份	一种厚膜负性光刻胶及配胶方法	发明专利	2022109096235	自 2022 年 7 月 29 日起 20 年	原始取得
19	艾森股份	具有高附着力的 PCB 板制程用 UV 固化喷墨打印油墨	发明专利	2020114946781	自 2020 年 12 月 17 日起 20 年	原始取得
20	艾森股份	一种滚镀中性镀锡工艺	发明专利	2021112830821	自 2021 年 11 月 1 日起 20 年	原始取得
21	艾森股份	一种防止高温回流焊聚锡的保护剂及制备方法	发明专利	2020105076854	自 2020 年 6 月 5 日起 20 年	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	权利期限	取得方式
		和使用方法				
22	艾森股份	用于 CIS 行业的正性厚膜光刻胶	发明专利	2018114516786	自 2018 年 11 月 30 日起 20 年	原始取得
23	艾森股份	高分散性的哑光阻焊油墨	发明专利	2019101513816	自 2019 年 2 月 28 日起 20 年	原始取得
24	艾森股份	一种用于先进封装的高速电镀铜添加剂及电镀液	发明专利	2020108749606	自 2020 年 8 月 27 日起 20 年	原始取得
25	艾森股份	一种 LED 环氧封装用改性聚苯硫醚光扩散剂及其制备方法	发明专利	2020109412106	自 2020 年 9 月 9 日起 20 年	原始取得
26	艾森股份	低无机成分的哑光阻焊油墨	发明专利	2019101680503	自 2019 年 3 月 6 日起 20 年	原始取得
27	艾森股份	高阻燃性阻焊油墨	发明专利	2019101440764	自 2019 年 2 月 27 日起 20 年	原始取得
28	艾森股份	一种光刻胶组合物及其应用	发明专利	2020109358563	自 2020 年 9 月 8 日起 20 年	原始取得
29	艾森股份	盲孔填孔电镀工艺及采用该工艺得到的镀件、镀件的应用、电子产品	发明专利	2020102061490	自 2020 年 3 月 23 日起 20 年	继受取得
30	艾森股份	一种用于电解沉积铜的组合物及酸铜电镀液	发明专利	2019113643435	自 2019 年 12 月 26 日起 20 年	原始取得
31	艾森股份	用于半导体封装工艺的负性光刻胶	发明专利	2018115532095	自 2018 年 12 月 19 日起 20 年	原始取得
32	艾森股份	一种 PCB 板水性膨松剂及其使用方法	发明专利	2016105176409	自 2016 年 7 月 5 日起 20 年	原始取得
33	艾森股份	一种化学镀铜剂及其制备方法	发明专利	2016101315455	自 2016 年 3 月 9 日起 20 年	原始取得
34	艾森股份	一种锡球浸泡液及其制备方法	发明专利	2016102863230	自 2016 年 5 月 4 日起 20 年	原始取得
35	艾森股份	一种电解去溢料溶液及其制备方法	发明专利	2016103213193	自 2016 年 5 月 16 日起 20 年	原始取得
36	艾森股份	一种甲基磺酸锡用抗氧化剂及其制备方法和使用方法	发明专利	201610124607X	自 2016 年 3 月 4 日起 20 年	原始取得
37	艾森股份	一种可循环使用环保型电解退镀液及其制备方法和使用方法	发明专利	2012103172640	自 2012 年 8 月 31 日起 20 年	原始取得
38	艾森股份	环保型弱碱性低温去毛刺软化液及其制备方法和使用方法	发明专利	2012103190348	自 2012 年 8 月 31 日起 20 年	原始取得
39	艾森股份	一种环保型弱酸性去毛刺软化液及其制备方法和使用方法	发明专利	2012103190333	自 2012 年 8 月 31 日起 20 年	原始取得
40	艾森股份	高温回流用锡层防变色剂及其制备方法和使用方法	发明专利	2012101182686	自 2012 年 4 月 20 日起 20 年	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	权利期限	取得方式
41	南通艾森	一种光敏性树脂组合物及其应用	发明专利	2023102301286	自 2023 年 3 月 10 日起 20 年	原始取得
42	南通艾森	一种蚀刻液组合物及其应用	发明专利	2023102917442	自 2023 年 3 月 23 日起 20 年	原始取得
43	南通艾森	高速光亮电镀添加剂及电镀液	发明专利	2023101117685	自 2023 年 2 月 14 日起 20 年	原始取得
44	南通艾森	一种丙烯酸树脂、光刻胶及其制备方法与应用	发明专利	2022115487804	自 2022 年 12 月 5 日起 20 年	原始取得
45	南通艾森	一种高附着力且弯折性好的 UV 喷印油墨	发明专利	2021109799433	自 2021 年 8 月 25 日起 20 年	原始取得
46	南通艾森	一种钛钨蚀刻液及其制备方法和应用	发明专利	2021102032810	自 2021 年 2 月 23 日起 20 年	继受取得
47	南通艾森	光学透明性良好的有机硅改性脂环族环氧树脂及制备方法	发明专利	2020109404218	自 2020 年 9 月 9 日起 20 年	原始取得
48	南通艾森	一种环氧树脂用高折射率聚酰亚胺光扩散剂	发明专利	2020112211456	自 2020 年 11 月 5 日起 20 年	原始取得
49	南通艾森	一种 LED 封装用纳米二氧化硅改性环氧树脂组合物	发明专利	2019110043190	自 2019 年 10 月 22 日起 20 年	原始取得
50	南通艾森	一种 OLEDarray 制程用正性光刻胶	发明专利	2020103063987	自 2020 年 4 月 17 日起 20 年	原始取得
51	南通艾森	一种电镀锡添加剂及其制备方法和使用方法	发明专利	2016101239894	自 2016 年 3 月 4 日起 20 年	继受取得
52	艾森世华	一种晶圆挂篮装置	实用新型	2024216568574	自 2024 年 7 月 12 日起 10 年	原始取得
53	艾森世华	电镀载具	实用新型	2024217894918	自 2024 年 7 月 26 日起 10 年	原始取得
54	艾森世华	一种钯金热交换装置	实用新型	2024215121205	自 2024 年 6 月 28 日起 10 年	原始取得
55	艾森世华	一种镍热交换装置	实用新型	2024209425044	自 2024 年 4 月 30 日起 10 年	原始取得
56	艾森世华	一种储液槽液体快速排放装置	实用新型	2024205683920	自 2024 年 3 月 22 日起 10 年	原始取得
57	艾森世华	用于半导体组件有机膜的粘合剂及其制备方法和应用	发明专利	2016104040577	自 2016 年 6 月 8 日起 20 年	原始取得

截至报告期末，公司拥有的中国境内已获得授权的专利不存在权属纠纷或潜在争议，不存在质押、冻结及其他设定第三方权益的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 1 项美国已授权专利，具体情况如下：

序号	权利人	专利名称	国家	专利号	申请日	授权日	取得方式
1	发行人	NEGATIVE PHOTORESIST USED FOR SEMICONDUCTOR	美国	US11,644,750B2	2020 年 9 月 23 日	2023 年 5 月 9 日	原始取得

序号	权利人	专利名称	国家	专利号	申请日	授权日	取得方式
		TOR ENCAPSULATI ON PROCESS					

截至报告期末，上述中国境外授权专利不存在权属纠纷或潜在争议，不存在质押、冻结及其他设定第三方权益的情形。

4、软件著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司共拥有 1 项软件著作权，已取得国家版权局出具的登记证书，具体情况如下：

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期
1	艾森世华	自动化学镀镍钯金设备监控软件 V1.0	2024SR0842716	2024-06-20

5、主要经营资质

截至本募集说明书签署之日，发行人及其境内子公司已根据中国境内法律的要求取得从事主营业务所需的资质和许可，具体如下：

（1）危险化学品生产、经营相关资质

序号	公司名称	资质名称	注册/备案编号	注册/备案机关	注册/备案日期	有效期
1	发行人	危险化学品经营许可证	32050013202500147	苏州市应急管理局	2025 年 11 月 24 日	2024 年 8 月 16 日至 2027 年 8 月 15 日
2		非药品类易制毒化学品经营备案证明	（苏）3J32058300241	昆山市应急管理局	2025 年 12 月 5 日	2025 年 12 月 5 日至 2027 年 8 月 15 日
3		易制爆危险化学品单位备案登记表	/	昆山市公安局	2021 年 4 月 7 日	/
4		生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表	320583-2026-394	昆山市应急管理局	2026 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日
5	南通艾森	安全生产许可证	苏（WH）安许证字（F00540）	江苏省应急管理厅	2026 年 6 月 19 日	2026 年 6 月 19 日至 2029 年 6 月 18 日
6		危险化学品登记证	32062500212	江苏省应急管理厅化学品登记中心	2025 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 12 日至 2028 年 9 月 11 日
7		危险化学品经营许可证	苏（F）危化经字（J）00993 号	南通市经济技术开发区管理委员会	2025 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日
8		易制爆危险化学品单位备案登记表	/	南通市公安局开发区分局	2022 年 4 月 24 日	/

序号	公司名称	资质名称	注册/备案编号	注册/备案机关	注册/备案日期	有效期
9		生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表	320602 开 2025S010	南通经济技术开发区应急管理局	2025 年 4 月 11 日	2025 年 4 月 11 日至 2028 年 4 月 10 日
10	艾森世华	危险化学品经营许可证	32050013202500062	苏州市应急管理局	2025 年 9 月 25 日	2025 年 9 月 25 日至 2028 年 9 月 24 日
11		非药品类易制毒化学品经营备案证明	(苏) 3J320583230100044	昆山市应急管理局	2025 年 10 月 10 日	2025 年 10 月 10 日至 2028 年 9 月 24 日
12		易制爆危险化学品单位备案登记表	/	昆山市公安局	2023 年 9 月 18 日	/
13		生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表	320583-2025-500	昆山市应急管理局	2025 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日

1) 就发行人报告期内购买第三类易制毒化学品硫酸、硫酸（试剂）、丙酮、丙酮（试剂）、醋酸酐（试剂）、盐酸、盐酸（试剂）、 γ -丁内酯、甲基乙基酮（试剂）的事项，发行人每次购买均已根据《易制毒化学品管理条例》的规定，将购买的品种、数量向江苏省昆山市公安局进行备案并取得《第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明》；

2) 就南通艾森报告期内购买第三类易制毒化学品盐酸、硫酸用于生产的事项，南通艾森均已根据《易制毒化学品管理条例》的规定，将购买的品种、数量向江苏省南通市公安局开发区分局进行备案并取得《第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明》。

(2) 排污相关资质

序号	公司名称	资质名称	注册/登记	注册/登记地址	注册/登记日期	有效期至
1	发行人	排污许可证	9132058355253262X1001Q	江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号	2025 年 10 月 15 日	2030 年 10 月 14 日
2		固定污染源排污登记回执	登记编号：9132058355253262X1002W	千灯镇中庄路 299 号	2024 年 12 月 6 日	2029 年 12 月 5 日
3	南通艾森	排污许可证	91320691MA1NHJKG23001U	南通开发区通达路 86-1 号	2026 年 3 月 20 日	2031 年 3 月 19 日

(3) 排水相关资质

序号	公司名称	资质名称	注册/登记	注册/登记地址	注册/登记日期	有效期至
1	发行人	城镇污水排入排水管网许可证	苏（EM）字第 F2024070801 号	昆山市千灯镇中庄路 299 号（1#厂房）	2024 年 7 月 8 日	2029 年 7 月 8 日
2		城镇污水排入排水管网许可证	苏（EM）字第 F2023112205 号	昆山市千灯镇中庄路 299 号（2#厂房、配电间）	2023 年 11 月 22 日	2028 年 11 月 22 日
3		城镇污水排入排水管网许可证	苏（EM）字第 F2025092901 号	千灯镇黄浦江路 1647 号	2023 年 4 月 7 日	2028 年 4 月 7 日
4	南通艾森	城镇污水排入排水管网许可证	苏通开排水字第 220708 号	开发区通达路 86-1 号	2022 年 7 月 26 日	2027 年 7 月 25 日

（4）进出口相关资质

序号	公司名称	资质名称	注册/备案编号	注册/备案机关	注册/备案日期	有效期
1	发行人	出入境检验检疫报检企业备案表	编号：1801191029060000173；备案号码：3204606602	江苏出入境检验检疫局	2018 年 1 月 22 日	/
2		海关报关单位注册登记证书	3223962798	昆山海关	2018 年 1 月 22 日	长期
3	南通艾森	报关单位备案证明	/	南通海关	2022 年 6 月 20 日	/
4	艾森世华	出入境检验检疫报检企业备案表	编号：18070413421500001017；备案号码：3204500084	昆山海关	2018 年 7 月 4 日	/
5		海关报关单位注册登记证书	海关注册编码：32239609DY	昆山海关	2018 年 7 月 4 日	长期

截至本募集说明书签署之日，发行人通过新加坡艾森所控制的境外子公司 INOFINE 在境外开展经营活动，新加坡艾森作为控制境外子公司 INOFINE 的境外持股平台，无实际经营业务。

就 INOFINE 的业务经营情况，根据境外法律意见书：“INOFINE 的主营业务为各类化学相关产品的贸易；截至最后实际可行日期，INOFINE 持有根据马来西亚法律开展其业务所需的各项授权、批准、证书、营业执照及许可；INOFINE 为开展其业务而持有的所有执照和许可，自取得以来持续有效且存续，未发生任何失效、暂停、撤销或续期中断的情形”。

十一、上市以来的重大资产重组情况

公司自首次公开发行股票并在科创板上市以来，未实施过重大资产重组。

十二、境外经营情况和境外资产情况

2024 年末，公司完成对马来西亚 INOFINE 的 80%股权收购事宜。INOFINE 作为马来西亚本土较早从事半导体湿电子化学品业务的公司，在当地市场具有一定的影响力。本次收购 INOFINE 是公司快速布局东南亚市场、加快国际化脚步的重要战略举措，将进一步夯实公司在湿电子化学品领域的领先地位。

INOFINE 的基本情况 & 经营情况详见本节“三/（二）公司直接或间接控股公司情况。”

十三、报告期内的分红情况

（一）公司现行利润分配政策

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规对于利润分配政策的规定，本公司《公司章程》规定的利润分配政策如下：

“第一百六十五条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配政策的具体内容及条件

1、利润分配原则：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2、利润分配的形式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。

3、公司现金分红的政策目标、具体条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的情况下，公司现金分红的政策目标为每年以现金方式分

配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%；

（3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

4、公司发放股票股利的具体条件：根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

5、利润分配的期间间隔：公司可以进行年度或中期分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。

6、其他：当公司发生以下情形的，可以不进行利润分配：

（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定

性段落的无保留意见；

（2）分红年度资产负债率高于 70%；

（3）经营性现金流为负；

（4）其他不利于公司日常经营的情况。

（二）公司制定利润分配方案的决策程序及机制

公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并根据本章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，并提交股东会审议决定。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会审议利润分配方案时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上表决通过。

（三）公司调整利润分配政策的决策程序及机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东会审议。

股东会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。”

（二）本次发行前后公司股利分配政策变化情况

本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

（三）公司最近三年股利分配制度的执行情况

1、最近三年利润分配方案

（1）公司 2025 年度利润分配方案

2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 9,568,823.22 元（含税）。

（2）公司 2024 年度利润分配方案

2024 年 9 月 2 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,952,901.75 元（含税）。

（3）公司 2023 年度利润分配方案

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 13,176,339.15 元（含税）。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	5,123.78	3,347.75	3,265.73
现金分红金额（含税）	956.88	395.29	1,317.63
现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	18.68%	11.81%	40.35%
以现金方式回购股份金额	20.00	6,001.41	-
最近三年现金分红金额小计（含税）	8,691.22		

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
最近三年年均可分配利润	3,912.42		
最近三年现金分红金额占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比率	222.14%		

综上，公司最近三年现金分红情况符合公司章程的规定，亦符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》对现金分红的相关要求。

3、公司最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司正常生产经营。

十四、最近三年已公开发行公司债券或者其他债务是否有违约或者延迟支付本息的情形

最近三年，公司未公开发行公司债券，不存在其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。

十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 2,716.47 万元、2,439.14 万元和 4,700.36 万元，最近三年平均可分配利润为 3,285.32 万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 51,400.00 万元计算，参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

第五节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了本公司最近三年的财务状况、经营业绩与现金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度经审计的财务报告。涉及追溯重述的，采用重述后的财务数据；财务指标以
上述财务报表为基础编制。

公司根据自身业务特点和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与财务信息相关的重大事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评估业务是否属于经常性业务，是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断金额大小的重要性时，公司综合考虑其占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额的比例情况，具体标准为：财务状况方面主要分析占资产或负债总额 5%以上事项；经营成果方面主要分析影响利润总额 5%以上事项；其他方面主要分析金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相关事项。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、 审计意见

公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度财务报告已经上会会计师审计，并分别出具了上会师报字（2024）第 6531 号、上会师报字（2025）第 7068 号、上会师报字（2026）第 8008 号标准无保留意见审计报告。

二、 财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动资产：			
货币资金	19,382.78	9,494.00	38,721.84

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
交易性金融资产	0.14	10,206.67	20,522.40
应收票据	1,736.35	1,751.15	2,277.82
应收账款	19,678.74	19,563.02	15,211.89
应收款项融资	424.40	1,184.33	786.10
预付款项	1,265.01	1,551.95	368.41
其他应收款	144.33	118.75	117.21
其中：应收利息	-	-	-
其中：应收股利	-	-	-
存货	7,000.85	6,157.42	3,959.04
合同资产	449.63	261.21	158.19
一年内到期的非流动资产	9,724.81	4,187.52	5,480.09
其他流动资产	448.12	698.35	781.04
流动资产合计	60,255.16	55,174.38	88,384.04
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	45.37	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	39,141.83	31,459.60	23,158.21
在建工程	4,583.70	224.65	4,083.72
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	312.31	157.77	203.95
无形资产	1,585.80	1,708.47	1,166.54
开发支出	-	-	-
商誉	485.70	485.70	-
长期待摊费用	1,077.64	361.04	318.94
递延所得税资产	1,264.90	926.14	925.75
其他非流动资产	30,345.81	33,912.82	9,747.77
非流动资产合计	78,843.06	69,236.19	39,604.87

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
资产总计	139,098.22	124,410.57	127,988.91
流动负债：			
短期借款	20,734.19	15,364.81	9,393.13
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	1,046.03	2,697.74	1,302.50
应付账款	6,444.90	5,170.15	10,015.81
预收款项	-	-	-
合同负债	333.76	345.41	77.20
应付职工薪酬	1,461.90	1,064.92	809.42
应交税费	178.67	181.27	98.36
其他应付款	947.39	186.60	108.78
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	394.64	57.96	58.90
其他流动负债	891.36	252.92	383.46
流动负债合计	32,432.84	25,321.78	22,247.56
非流动负债：			
长期借款	1,500.00	-	3,603.90
应付债券	-	-	-
租赁负债	247.59	134.27	154.40
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	1,139.25	832.71	-
递延所得税负债	315.69	312.16	358.35
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,202.53	1,279.14	4,116.65
负债合计	35,635.37	26,600.92	26,364.21
所有者权益：			
实收资本（或股本）	8,813.33	8,813.33	8,813.33
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
资本公积	79,025.78	79,246.67	79,246.67
减：库存股	5,563.68	6,002.07	-
其他综合收益	134.87	39.61	-
专项储备	1,236.03	1,082.91	982.82
盈余公积	2,456.67	1,920.39	1,580.49
未分配利润	16,883.81	12,296.31	11,001.38
归属于母公司所有者权益合计	102,986.82	97,397.15	101,624.69
少数股东权益	476.02	412.50	-
所有者权益合计	103,462.84	97,809.65	101,624.69
负债和所有者权益总计	139,098.22	124,410.57	127,988.91

2、合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	59,264.37	43,218.84	36,003.93
其中：营业收入	59,264.37	43,218.84	36,003.93
二、营业总成本	55,411.19	40,753.61	33,445.57
其中：营业成本	42,073.35	31,801.30	26,219.59
税金及附加	249.17	191.66	183.19
销售费用	3,516.58	2,552.12	2,012.30
管理费用	3,099.73	2,472.09	2,043.16
研发费用	6,942.21	4,590.17	3,268.79
财务费用	-469.85	-853.73	-281.46
其中：利息费用	439.72	218.41	227.92
利息收入	1,019.48	1,068.03	514.88
加：其他收益	1,023.16	322.80	717.99
投资收益（损失以“－”号填列）	234.85	422.68	40.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10.86	-16.18	22.40
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-49.76	-206.07	-157.71
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-154.44	-75.48	-8.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5.25	7.55	-1.41

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,901.39	2,920.53	3,171.11
加：营业外收入	129.07	386.61	141.70
减：营业外支出	31.81	2.62	14.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,998.65	3,304.52	3,298.21
减：所得税费用	-164.81	-43.23	32.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,163.46	3,347.75	3,265.73
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,163.46	3,347.75	3,265.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	5,123.78	3,347.75	3,265.73
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	39.68	-	-
六、其他综合收益的税后净额	119.10	49.49	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95.26	39.61	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	95.26	39.61	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	95.26	39.61	-
（7）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23.84	9.87	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
七、综合收益总额	5,282.57	3,397.24	3,265.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,219.04	3,387.37	3,265.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	63.52	9.87	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.59	0.38	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）	0.59	0.38	0.49

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	51,092.59	29,563.73	21,282.39
收到的税费返还	208.07	209.35	1,212.45
收到其他与经营活动有关的现金	846.55	1,803.87	853.84
经营活动现金流入小计	52,147.22	31,576.95	23,348.68
购买商品、接受劳务支付的现金	30,491.07	23,324.20	21,023.77
支付给职工及为职工支付的现金	7,136.17	5,794.29	4,575.10
支付的各项税费	787.51	634.66	2,705.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,624.67	4,295.66	3,497.45
经营活动现金流出小计	44,039.42	34,048.81	31,801.86
经营活动产生的现金流量净额	8,107.80	-2,471.86	-8,453.18
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	55,680.65	52,661.01	16,513.31
取得投资收益收到的现金	446.74	965.67	335.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.45	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	56,137.84	53,626.68	16,849.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,480.60	9,221.42	6,249.44
投资支付的现金	52,563.18	63,315.09	38,333.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,547.09	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	67,043.79	74,083.60	44,582.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,905.95	-20,456.92	-27,733.64
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	792.60	-	57,131.54
取得借款收到的现金	33,784.26	26,233.16	26,246.82
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	34,576.86	26,233.16	83,378.36
偿还债务支付的现金	26,150.00	22,721.42	8,937.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455.18	1,890.22	293.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	104.35	8,120.44	57.79
筹资活动现金流出小计	26,709.53	32,732.08	9,287.99
筹资活动产生的现金流量净额	7,867.33	-6,498.92	74,090.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60.37	-0.26	2.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,008.81	-29,427.96	37,905.55
加：期初现金及现金等价物余额	9,261.93	38,689.89	784.34
六、期末现金及现金等价物余额	14,270.74	9,261.93	38,689.89

（二）财务报表编制基础及报告期合并报表范围的变化

1、财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、合并报表范围及变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人财务报表合并范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	持股比例		取得方式
		直接	间接	
1	昆山艾森世华光电材料有限公司	100%	-	同一控制下企业合并

序号	子公司名称	持股比例		取得方式
		直接	间接	
2	艾森半导体材料（南通）有限公司	100%	-	设立
3	INOFINE PTE. LTD.	100%	-	设立
4	INOFINE CHEMICALS SDN BHD	-	80%	非同一控制下企业合并
5	武汉艾森晶合半导体有限公司	100%	-	设立

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

变更方式	公司名称	备注
2025 年度		
新增	武汉艾森晶合半导体有限公司	设立，持股比例 100%
2024 年度		
新增	INOFINE CHEMICALS SDN BHD	非同一控制下企业合并，持股比例 80%
新增	INOFINE PTE. LTD.	设立，持股比例 100%
2023 年度		
合并范围无变更		

三、主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动比率	1.86	2.18	3.97
速动比率	1.64	1.94	3.79
资产负债率（合并）	25.62%	21.38%	20.60%
资产负债率（母公司）	22.62%	21.90%	18.46%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	11.69	11.05	11.53
项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	3.02	2.49	2.75
存货周转率（次/年）	6.39	6.29	7.07
利息保障倍数	12.37	16.13	15.47
归属于发行人股东的净利润（万元）	5,123.78	3,347.75	3,265.73
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.92	-0.28	-0.96
每股净现金流量（元）	0.57	-3.34	4.30

注：上述指标如无特别说明，均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产－存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额；应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值平均数；

存货周转率=营业成本/存货平均净值；

利息保障倍数=（净利润+所得税+利息支出）/利息支出；

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及每股收益计算如下：

1、加权平均净资产收益率

项目	加权平均净资产收益率		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.13%	3.29%	7.17%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.70%	2.39%	5.96%

2、每股收益

单位：元/股

项目	基本每股收益		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.38	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.28	0.41
项目	稀释每股收益		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.38	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.28	0.41

（三）非经常性损益明细表

单位：万元

主要财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2.02	6.96	-1.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	300.11	671.87	603.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	223.99	406.51	62.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	15.86	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.26	-2.03	-14.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减：所得税影响额	76.77	190.55	101.23
少数股东权益影响额	-0.32	-	-
合计	423.42	908.62	549.26

四、会计政策变更和会计估计变更

（一）会计政策变更情况

1、公司自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自 2024 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

报告期内，公司无会计估计变更。

（三）前期会计差错更正情况

报告期内，公司不存在前期差错更正。

五、财务状况分析

（一）资产状况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	60,255.16	43.32%	55,174.38	44.35%	88,384.04	69.06%
非流动资产	78,843.06	56.68%	69,236.19	55.65%	39,604.87	30.94%
合计	139,098.22	100.00%	124,410.57	100.00%	127,988.91	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 127,988.91 万元、124,410.57 万元和 139,098.22 万元，随着业务规模的扩大，公司资产规模整体呈增长态势，与公司业务运营情况相匹配。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	19,382.78	32.17%	9,494.00	17.21%	38,721.84	43.81%
交易性金融资产	0.14	0.00%	10,206.67	18.50%	20,522.40	23.22%
应收票据	1,736.35	2.88%	1,751.15	3.17%	2,277.82	2.58%
应收账款	19,678.74	32.66%	19,563.02	35.46%	15,211.89	17.21%
应收款项融资	424.40	0.70%	1,184.33	2.15%	786.10	0.89%
预付款项	1,265.01	2.10%	1,551.95	2.81%	368.41	0.42%
其他应收款	144.33	0.24%	118.75	0.22%	117.21	0.13%
存货	7,000.85	11.62%	6,157.42	11.16%	3,959.04	4.48%
合同资产	449.63	0.75%	261.21	0.47%	158.19	0.18%
一年内到期的非流动资产	9,724.81	16.14%	4,187.52	7.59%	5,480.09	6.20%
其他流动资产	448.12	0.74%	698.35	1.27%	781.04	0.88%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合计	60,255.16	100.00%	55,174.38	100.00%	88,384.04	100.00%

报告期各期末，公司流动资产分别为 88,384.04 万元、55,174.38 万元和 60,255.16 万元，占总资产的比例分别为 69.06%、44.35%和 43.32%，主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等构成。

2023 年末，公司流动资产占比较高，主要系公司于 2023 年 12 月首次发行股票并在科创板上市募集资金到账所致。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
库存现金	2.84	2.35	5.63
银行存款	18,820.90	8,449.17	38,716.21
其他货币资金	559.04	1,042.48	-
存放财务公司存款	-	-	-
合计	19,382.78	9,494.00	38,721.84
其中：存放在境外的款项总额	468.08	746.61	-

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 38,721.84 万元、9,494.00 万元和 19,382.78 万元，主要由银行存款构成。2024 年末，公司货币资金同比大幅下降，主要系公司使用闲置资金进行现金管理所致。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
债务工具投资	0.14	10,206.67	20,522.40
合计	0.14	10,206.67	20,522.40

报告期各期末，公司交易性金融资产主要为使用暂时闲置资金购买的结构性存款。2025 年末，公司交易性金融资产金额同比大幅下降，主要系结构性存款

到期赎回所致。

(3) 应收票据与应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资均由银行承兑汇票构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收票据	1,736.35	1,751.15	2,277.82
应收款项融资	424.40	1,184.33	786.10
合计	2,160.75	2,935.48	3,063.92

报告期各期末，公司应收票据账面金额分别为 2,277.82 万元、1,751.15 万元和 1,736.35 万元，占流动资产的比例分别为 2.58%、3.17%和 2.88%；应收款项融资账面金额分别为 786.10 万元、1,184.33 万元和 424.40 万元，占流动资产的比例分别为 0.89%、2.15%和 0.70%。报告期内，应收票据及应收款项融资规模整体呈现下降趋势。

(4) 应收账款

①应收账款变动情况

报告期各期末，公司应收账款情况具体如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收账款余额	20,810.98	20,667.81	16,090.94
减：坏账准备	1,132.24	1,104.80	879.05
应收账款账面价值	19,678.74	19,563.02	15,211.89
营业收入	59,264.37	43,218.84	36,003.93
应收账款账面价值占营业收入的比例	33.21%	45.27%	42.25%

报告期各期末，公司应收账款价值分别为 15,211.89 万元、19,563.02 万元和 19,678.74 万元，占流动资产的比例分别为 17.21%、35.46%和 32.66%，占当期营业收入的比例分别为 42.25%、45.27%和 33.21%。2025 年末，公司应收账款占营业收入的比例大幅下降，主要原因系 2025 年上半年行业景气度持续提升，公司营业收入季节性分布减弱，上半年收入占比提高所致。

②应收账款账龄情况

报告期内，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,463.91	98.33%	20,183.81	97.66%	15,640.70	97.20%
1 至 2 年	221.24	1.06%	393.08	1.90%	332.27	2.06%
2 至 3 年	72.37	0.35%	28.45	0.14%	25.90	0.16%
3 至 4 年	3.78	0.02%	20.41	0.10%	70.37	0.44%
4 至 5 年	18.90	0.09%	22.56	0.11%	4.35	0.03%
5 年以上	30.77	0.15%	19.51	0.09%	17.36	0.11%
合计	20,810.98	100.00%	20,667.81	100.00%	16,090.94	100.00%

报告期各期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款账面余额占比分别为 97.20%、97.66%和 98.33%，应收账款账龄绝大多数在 1 年以内，应收账款质量较好。

③坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况具体如下：

单位：万元

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
2025-12-31					
按单项计提坏账准备的应收账款	24.89	0.12%	24.89	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	20,786.09	99.88%	1,107.35	5.33%	19,678.74
合计	20,810.98	100.00%	1,132.24	5.44%	19,678.74
2024-12-31					
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	20,667.81	100.00%	1,104.80	5.35%	19,563.02
合计	20,667.81	100.00%	1,104.80	5.35%	19,563.02
2023-12-31					
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	16,090.94	100.00%	879.05	5.46%	15,211.89
合计	16,090.94	100.00%	879.05	5.46%	15,211.89

报告期各期末，公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款均为账龄组合。

2023 年末和 2024 年末，公司无单项计提坏账准备的应收账款。2025 年末，公司单项计提坏账准备的应收账款主要系应收广东超导电子有限公司、珠海市秋志辰电子科技有限公司预计难以回收，全额计提。公司坏账准备计提充分。

④应收账款余额前五大客户情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元

序号	名称	应收账款余额	余额占比
2025-12-31			
1	第一名	3,795.30	18.24%
2	第二名	1,441.03	6.92%
3	第三名	1,099.74	5.28%
4	第四名	1,012.11	4.86%
5	第五名	919.93	4.42%
合计		8,268.11	39.73%
2024-12-31			
1	第一名	4,674.72	22.62%
2	第二名	1,436.08	6.95%
3	第三名	1,239.33	6.00%
4	第四名	1,000.07	4.84%
5	第五名	836.16	4.05%
合计		9,186.36	44.45%
2023-12-31			
1	第一名	3,853.52	23.95%
2	第二名	978.61	6.08%
3	第三名	977.72	6.08%

序号	名称	应收账款余额	余额占比
4	第四名	921.19	5.72%
5	第五名	787.45	4.89%
合计		7,518.49	46.72%

注：本表所列示为报告期各期合并口径应收账款前五大客户。

（5）预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 368.41 万元、1,551.95 万元和 1,265.01 万元，占流动资产比例分别为 0.42%、2.81%和 2.10%，金额较小，主要为采购材料的预付款。

（6）合同资产

报告期各期末，公司合同资产分别为 158.19 万元、261.21 万元和 449.63 万元，占流动资产比例分别为 0.18%、0.47%和 0.75%，主要为寄售模式下客户期末已领用但未结算的金额。

（7）存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
2025-12-31				
原材料	1,472.55	20.01%	111.22	1,361.33
委托加工物资	720.81	9.79%	-	720.81
在产品	693.37	9.42%	7.83	685.54
库存商品	3,748.44	50.93%	240.59	3,507.85
发出商品	715.81	9.73%	-	715.81
合同履约成本	9.51	0.13%	-	9.51
合计	7,360.49	100.00%	359.64	7,000.85
2024-12-31				
原材料	1,356.62	21.29%	38.15	1,318.47
委托加工物资	480.59	7.54%	-	480.59
在产品	108.00	1.69%	11.29	96.71
库存商品	3,759.20	58.99%	165.68	3,593.52
发出商品	662.12	10.39%	-	662.12

项目	账面余额	占比	跌价准备	账面价值
合同履约成本	6.01	0.09%	-	6.01
合计	6,372.54	100.00%	215.12	6,157.42
2023-12-31				
原材料	910.88	22.34%	49.82	861.06
委托加工物资	511.00	12.53%	-	511.00
在产品	54.38	1.33%	-	54.38
库存商品	1,479.15	36.28%	68.21	1,410.94
发出商品	1,112.83	27.29%	-	1,112.83
合同履约成本	8.83	0.22%	-	8.83
合计	4,077.07	100.00%	118.02	3,959.04

报告期各期末，公司存货余额分别为 4,077.07 万元、6,372.54 万元和 7,360.49 万元，存货账面价值分别为 3,959.04 万元、6,157.42 万元和 7,000.85 万元，占流动资产的比例分别为 4.48%、11.16%和 11.62%。2024 年末，公司存货余额及占比大幅提高，主要原因系：①营业收入增长，为保障订单及时交付，公司相应增加备货；②2024 年末，公司完成 INOFINE 80%股权收购，纳入合并报表。

公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本构成，报告期各期存货结构整体较为稳定。

（8）一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
一年内到期的定期存款及利息	9,724.81	4,187.52	5,480.09
合计	9,724.81	4,187.52	5,480.09

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 5,480.09 万元、4,187.52 万元和 9,724.81 万元，占流动资产的比例分别为 6.20%、7.59%和 16.14%，均为一年内到期的定期存款及利息。

（9）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 781.04 万元、698.35 万元和 448.12 万元，占流动资产的比例分别为 0.88%、1.27%和 0.74%，主要为多缴税金或留

抵税额。

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	39,141.83	49.65%	31,459.60	45.44%	23,158.21	58.47%
在建工程	4,583.70	5.81%	224.65	0.32%	4,083.72	10.31%
使用权资产	312.31	0.40%	157.77	0.23%	203.95	0.51%
无形资产	1,585.80	2.01%	1,708.47	2.47%	1,166.54	2.95%
商誉	485.70	0.62%	485.70	0.70%	-	-
长期待摊费用	1,077.64	1.37%	361.04	0.52%	318.94	0.81%
递延所得税资产	1,264.90	1.60%	926.14	1.34%	925.75	2.34%
其他非流动资产	30,345.81	38.49%	33,912.82	48.98%	9,747.77	24.61%
其他非流动金融资产	45.37	0.06%	-	-	-	-
合计	78,843.06	100.00%	69,236.19	100.00%	39,604.87	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产分别为 39,604.87 万元、69,236.19 万元和 78,843.06 万元，占资产总额比例分别为 30.94%、55.65%和 56.68%，主要由固定资产、在建工程与其他非流动资产等构成。报告期内，公司非流动资产金额和占比持续增长，主要系随着募投项目持续投入建设，固定资产和在建工程金额增加所致。

（1）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下所示：

单位：万元

期间	项目	账面余额	累计折旧	减值准备	账面价值
2025-12-31	房屋及建筑物	20,910.14	3,166.01	-	17,744.13
	机器设备	26,975.36	6,149.28	-	20,826.08
	运输工具	357.65	172.82	-	184.83
	通用设备	711.03	324.24	-	386.79
	合计	48,954.18	9,812.35	-	39,141.83

期间	项目	账面余额	累计折旧	减值准备	账面价值
2024-12-31	房屋及建筑物	20,195.19	2,190.83	-	18,004.36
	机器设备	16,947.85	4,134.82	-	12,813.03
	运输工具	357.42	136.07	-	221.35
	通用设备	639.97	219.11	-	420.86
	合计	38,140.43	6,680.83	-	31,459.60
2023-12-31	房屋及建筑物	13,860.79	1,401.54	-	12,459.25
	机器设备	13,222.00	2,711.75	-	10,510.25
	运输工具	279.28	181.56	-	97.73
	通用设备	246.01	155.03	-	90.98
	合计	27,608.08	4,449.88	-	23,158.21

报告期内，公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、运输工具和通用设备构成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 23,158.21 万元、31,459.60 万元和 39,141.83 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 58.47%、45.44%和 49.65%。报告期内，公司固定资产余额持续增长，主要系募投项目持续建设，达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

报告期内，公司固定资产运行状况良好，未发现由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不存在计提资产减值准备的情形。

（2）在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
建筑物工程	2,549.56	-	2,801.60
生产线工程	1,006.24	-	1,282.12
设备工程	1,027.91	224.65	-
合计	4,583.70	224.65	4,083.72

2024 年末，公司在建工程余额同比大幅降低，主要系集成电路测试中心项目建筑物工程达到预定可使用状态转固所致。

2025 年末，公司在建工程余额大幅增加，主要系集成电路测试中心设备工

程、马来西亚厂房建设项目以及南通艾森生产线技改项目持续推进所致。

报告期各期末，公司在建工程均在正常建设中，整体情况良好，不存在资产可能已经发生减值的迹象。

（3）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产的账面价值分别为 203.95 万元、157.77 万元和 312.31 万元，占非流动资产的比例分别为 0.51%、0.23%和 0.40%，金额较小，主要为租赁的房屋及建筑物、运输设备。

（4）无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	855.18	53.93%	878.36	51.41%	901.54	77.28%
非专利技术	205.00	12.93%	235.00	13.75%	265.00	22.72%
财务及管理软件	59.09	3.73%	11.95	0.70%	-	-
客户资源	466.53	29.42%	583.17	34.13%	-	-
合计	1,585.80	100.00%	1,708.47	100.00%	1,166.54	100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 1,166.54 万元、1,708.47 万元和 1,585.80 万元，主要由土地使用权、非专利技术、财务及管理软件、客户资源等构成。2024 年末，公司无形资产大幅增加，主要系非同一控制下企业合并 INOFINE 确认相关客户资源所致。

（5）商誉

2024 年末和 2025 年末，公司商誉账面价值为 485.70 万元，系收购子公司 INOFINE 形成，金额较小。公司每年末对商誉所在的资产组进行减值测试，经测算均不存在商誉减值的情形。

（6）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
装修费	1,075.80	361.04	318.94
工程项目管理平台	1.84	-	-
合计	1,077.64	361.04	318.94

报告期各期末，公司长期待摊费用金额分别为 318.94 万元、361.04 万元和 1,077.64 万元，主要系装修费。2025 年末，公司长期待摊费用账面金额大幅增加，主要系公司及子公司实验室更新改造、罐区及仓库等装修改造所致。

（7）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产构成如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失及资产减值准备	1,582.55	288.67	1,317.60	227.65	1,036.05	175.95
内部交易未实现利润	162.89	30.24	96.44	21.04	215.54	50.82
可抵扣亏损	3,002.52	656.44	3,073.98	510.76	3,731.25	646.36
租赁负债	323.29	78.85	167.11	41.78	210.50	52.63
递延收益	1,139.25	170.89	832.71	124.91	-	-
股份支付	231.79	39.11	-	-	-	-
金融资产公允价值变动	4.63	0.70	-	-	-	-
合计	6,446.92	1,264.90	5,487.84	926.14	5,193.34	925.76

报告期各期末，公司递延所得税资产账面金额分别为 925.76 万元、926.14 万元和 1,264.90 万元，主要为可抵扣亏损、递延收益和信用减值损失及资产减值准备。

（8）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预付长期资产类款项	1,271.64	4.19%	2,076.62	6.12%	467.90	4.80%
定期存款	29,074.18	95.81%	31,836.20	93.88%	9,279.87	95.20%
合计	30,345.81	100.00%	33,912.82	100.00%	9,747.77	100.00%

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 9,747.77 万元、33,912.82 万元和 30,345.81 万元，占非流动资产的比例分别为 24.61%、48.98%和 38.49%，主要为定期存款。2024 年末，公司非流动资产金额大幅增加，主要系使用暂时闲置资金购买大额存单或存入定期存款所致。

（二）负债状况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	32,432.84	91.01%	25,321.78	95.19%	22,247.56	84.39%
非流动负债	3,202.53	8.99%	1,279.14	4.81%	4,116.65	15.61%
合计	35,635.37	100.00%	26,600.92	100.00%	26,364.21	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 26,364.21 万元、26,600.92 万元和 35,635.37 万元，负债规模随着公司业务的发展整体呈上升趋势。

报告期内，公司负债主要由流动负债构成。报告期各期末，公司流动负债总额分别为 22,247.56 万元、25,321.78 万元和 32,432.84 万元，占各期末负债总额的比例分别为 84.39%、95.19%和 91.01%，主要系短期借款、应付票据、应付账款等。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	20,734.19	63.93%	15,364.81	60.68%	9,393.13	42.22%

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	1,046.03	3.23%	2,697.74	10.65%	1,302.50	5.85%
应付账款	6,444.90	19.87%	5,170.15	20.42%	10,015.81	45.02%
合同负债	333.76	1.03%	345.41	1.36%	77.20	0.35%
应付职工薪酬	1,461.90	4.51%	1,064.92	4.21%	809.42	3.64%
应交税费	178.67	0.55%	181.27	0.72%	98.36	0.44%
其他应付款	947.39	2.92%	186.60	0.74%	108.78	0.49%
一年内到期的非流动负债	394.64	1.22%	57.96	0.23%	58.90	0.26%
其他流动负债	891.36	2.75%	252.92	1.00%	383.46	1.72%
合计	32,432.84	100.00%	25,321.78	100.00%	22,247.56	100.00%

(1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 9,393.13 万元、15,364.81 万元和 20,734.19 万元，占公司流动负债的比例分别为 42.22%、60.68%和 63.93%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
已贴现未到期应收票据	15,531.96	11,162.53	5,593.53
银行贷款	3,002.23	4,202.28	-
国内信用证	2,200.00	-	3,799.60
合计	20,734.19	15,364.81	9,393.13

2024 年末，公司短期借款余额大幅增加，主要系公司因回购股份银行短期贷款增加所致。2025 年末，公司短期借款进一步增加，主要系公司业务扩张，为提高资金使用效率，向银行贴现未到期应收票据以及向银行申请开具国内信用证所致。报告期内，公司银行信用记录良好，未发生过债务本金及利息逾期或无法支付等违约情形，期末短期借款余额中无不良贷款。

(2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 1,302.50 万元、2,697.74 万元和 1,046.03 万元，占各期末流动负债的比例分别为 5.85%、10.65%和 3.23%，均为银行承兑汇票。为提高资金使用效率，切实保障公司日常运营资金的需求，公司

灵活采用银行承兑汇票方式与供应商进行货款结算。

(3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 10,015.81 万元、5,170.15 万元和 6,444.90 万元，占各期末流动负债比例分别为 45.02%、20.42%和 19.87%，主要由应付供应商原材料采购款、工程设备款构成。2023 年末，公司应付账款余额较大，主要系应付上市费用及工程设备款所致。

报告期各期末，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	占比	款项性质
2025-12-31				
1	第一名	1,170.60	18.16%	工程款
2	第二名	375.00	5.82%	设备采购款
3	第三名	229.86	3.57%	原材料采购款
4	第四名	189.72	2.94%	设备采购款
5	第五名	188.88	2.93%	原材料采购款
合计		2,154.06	33.42%	-
2024-12-31				
1	第一名	997.00	19.28%	设备采购款
2	第二名	511.21	9.89%	工程款
3	第三名	309.60	5.99%	原材料采购款
4	第四名	171.47	3.32%	原材料采购款
5	第五名	166.39	3.22%	设备采购款
合计		2,155.67	41.69%	-
2023-12-31				
1	第一名	3,086.30	30.81%	工程款
2	第二名	1,035.00	10.33%	设备采购款
3	第三名	1,002.17	10.01%	审计费
4	第四名	828.63	8.27%	工程款
5	第五名	607.92	6.07%	律师费
合计		6,560.02	65.49%	-

报告期末，公司应付账款前五名中不存在持有本公司 5%以上表决权股份股东。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债余额分别为 77.20 万元、345.41 万元和 333.76 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.35%、1.36%和 1.03%，占比较小，主要系预收客户款项。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 809.42 万元、1,064.92 万元和 1,461.90 万元，占各期末流动负债比例分别为 3.64%、4.21%和 4.51%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
短期薪酬	1,450.61	1,064.92	809.42
离职后福利-设定提存计划	11.29	-	-
合计	1,461.90	1,064.92	809.42

报告期内，随着公司业务的持续发展，各期末应付职工薪酬金额总体呈上升趋势。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 98.36 万元、181.27 万元和 178.67 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.44%、0.72%和 0.55%。报告期各期末，公司应交税费主要由增值税、企业所得税、房产税、个人所得税等构成。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 108.78 万元、186.60 万元和 947.39 万元，占流动负债的比例分别为 0.49%、0.74%和 2.92%。2025 年末，公司其他应付款余额较 2024 年末增加较多，主要系本期授予职工限制性股票确认回购义务所致。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 58.90 万元、57.96 万元和 394.64 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.26%、0.23%和 1.22%。2025 年末，公司一年内到期的非流动负债增加较多，主要系一年内到期的长期

借款金额变动所致。

（9）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 383.46 万元、252.92 万元和 891.36 万元，占各期末流动负债的比例分别为 1.72%、1.00%和 2.75%，主要为未终止确认的背书未到期票据以及待转销项税。2025 年末，公司其他流动负债金额较大，主要系当期末未终止确认的背书未到期票据增加所致。

2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	1,500.00	46.84%	-	-	3,603.90	87.54%
租赁负债	247.59	7.73%	134.27	10.50%	154.40	3.75%
递延收益	1,139.25	35.57%	832.71	65.10%	-	-
递延所得税负债	315.69	9.86%	312.16	24.40%	358.35	8.70%
合计	3,202.53	100.00%	1,279.14	100.00%	4,116.65	100.00%

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 3,603.90 万元、0 万元和 1,500.00 万元，占非流动负债的比例分别为 87.54%、0%和 46.84%，均为银行信用借款。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债的余额分别为 154.40 万元、134.27 万元和 247.59 万元，占各期末非流动负债的比例分别为 3.75%、10.50%和 7.73%，主要系租赁房产相关费用。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 0 万元、832.71 万元、1,139.25 万元，占各期末非流动负债的比例分别为 0%、65.10%和 35.57%，均为与资产相关的政府补助。2024 年末和 2025 年末，公司递延收益金额大幅增加，主要系收到设备补贴所致。

（4）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 358.35 万元、312.16 万元和 315.69 万元，占各期末非流动负债的比例分别为 8.70%、24.40%和 9.86%，主要系固定资产一次性抵扣税额、使用权资产账面价值与计税价值差异而产生的应纳税暂时性差异。

（三）营运能力分析

1、发行人资产周转能力指标分析

报告期内，公司资产周转能力相关指标情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	3.02	2.49	2.75
存货周转率（次/年）	6.39	6.29	7.07

注 1：应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值平均数；

注 2：存货周转率=营业成本/存货平均净值。

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 2.75 次/年、2.49 次/年和 3.02 次/年，整体呈上升趋势，主要系公司持续优化应收账款管理，应收账款规模增长幅度小于营业收入增长幅度。

报告期内，公司存货周转率分别为 7.07 次/年、6.29 次/年和 6.39 次/年，存货周转情况良好，整体相对较为稳定。

2、与同行业可比公司相关指标对比分析

报告期各期末，公司应收账款周转率、存货周转率与同行业可比上市公司的对比情况如下：

证券代码	公司简称	应收账款周转率（次/年）		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
300236.SZ	上海新阳	3.05	2.60	2.45
688019.SH	安集科技	5.30	5.44	4.78
300655.SZ	晶瑞电材	3.96	3.52	3.55
688603.SH	天承科技	2.52	2.55	2.35
可比公司平均值		3.71	3.53	3.28
发行人		3.02	2.49	2.75

证券代码	公司简称	应收账款周转率（次/年）		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
证券代码	公司简称	存货周转率（次/年）		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
300236.SZ	上海新阳	3.14	2.98	2.74
688019.SH	安集科技	1.30	1.46	1.38
300655.SZ	晶瑞电材	7.50	7.32	7.81
688603.SH	天承科技	5.41	6.25	5.56
可比公司平均值		4.34	4.50	4.37
发行人		6.39	6.29	7.07

注：可比上市公司数据根据可比公司公开披露数据计算。

报告期内，公司应收账款周转率高于天承科技，与上海新阳较为接近，处于可比上市公司中间水平；存货周转率处于可比上市公司较高水平，高于可比上市公司的平均值。

（四）偿债能力分析

1、发行人偿债能力指标分析

报告期内，公司的主要偿债能力指标情况如下：

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动比率（倍）	1.86	2.18	3.97
速动比率（倍）	1.64	1.94	3.79
资产负债率（合并）	25.62%	21.38%	20.60%

注 1：流动比率=流动资产/流动负债；

注 2：速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；

注 3：资产负债率=总负债/总资产。

报告期各期末，公司流动比率分别为 3.97 倍、2.18 倍和 1.86 倍，速动比率分别为 3.79 倍、1.94 倍和 1.64 倍。公司流动比率、速动比率均处于合理水平，与当前的生产经营模式相适应。公司流动资产状况良好，具有良好的短期偿债能力。

报告期内，公司合并口径资产负债率分别为 20.60%、21.38%和 25.62%。公司业务模式和信用政策未发生重大变化，资产负债率维持在较低水平，资产负债结构合理，长期偿债能力较强。

2、与同行业上市公司相关指标对比分析

报告期内，公司主要偿债指标与同行业可比上市公司对比如下：

证券代码	公司简称	流动比率		
		2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
300236.SZ	上海新阳	1.86	2.41	2.64
688019.SH	安集科技	6.81	4.34	6.96
300655.SZ	晶瑞电材	5.23	5.00	3.36
688603.SH	天承科技	9.00	12.91	25.65
可比公司平均值		5.73	6.17	9.65
发行人		1.86	2.18	3.97
证券代码	公司简称	速动比率		
		2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
300236.SZ	上海新阳	1.57	2.00	2.28
688019.SH	安集科技	4.66	3.02	4.74
300655.SZ	晶瑞电材	4.89	4.69	3.13
688603.SH	天承科技	8.49	12.45	24.83
可比公司平均值		4.90	5.54	8.75
发行人		1.64	1.94	3.79
证券代码	公司简称	资产负债率		
		2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
300236.SZ	上海新阳	25.80%	22.03%	24.35%
688019.SH	安集科技	29.92%	21.75%	18.41%
300655.SZ	晶瑞电材	27.87%	29.53%	32.46%
688603.SH	天承科技	10.16%	9.72%	6.29%
可比公司平均值		23.44%	20.76%	20.38%
发行人		25.62%	21.38%	20.60%

注：可比公司数据根据可比公司公开披露数据计算。

报告期内，公司流动比率、速动比率与上海新阳较为接近。报告期内，公司资产负债率整体处于较低水平，与可比上市公司平均水平较为接近。

（五）财务性投资

1、财务性投资的认定

根据《注册办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大

的财务性投资。”

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第18号》第一条等相关规定，“财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。”

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”

2、公司财务性投资的情况

截至2025年12月31日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形，具体说明如下：

单位：万元

序号	科目	账面价值	财务性投资金额
1	货币资金	19,382.78	-
2	交易性金融资产	0.14	-
3	其他应收款	144.33	-
4	一年内到期的非流动资产	9,724.81	-
5	其他流动资产	448.12	-

序号	科目	账面价值	财务性投资金额
6	其他非流动资产	30,345.81	-
7	其他非流动金融资产	45.37	-
8	长期股权投资	-	-
9	其他权益工具投资	-	-

（1）货币资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金账面价值为 19,382.78 万元，主要为银行存款、其他货币资金（回购公司股票款、银行信用证保证金、收到的政府补贴等），不属于财务性投资。

（2）交易性金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产账面价值为 0.14 万元，主要为低风险债务工具投资，不属于财务性投资。

（3）其他应收款

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 144.33 万元，主要为押金、保证金，不属于财务性投资。

（4）一年内到期的非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动资产为 9,724.81 万元，为一年内到期的定期存款及利息，不属于财务性投资。

（5）其他流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他流动资产账面价值为 448.12 万元，主要为多缴税金或留抵税额，不属于财务性投资。

（6）其他非流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产账面价值为 30,345.81 万元，为定期存款和预付长期资产类款项，不属于财务性投资。

（7）其他非流动金融资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 45.37 万元，主要系公司投资苏州钧华 5%股权。苏州钧华主营业务为半导体设备的研发、生

产和销售。公司投资苏州钧华系基于战略布局及业务协同的需要开展，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。

3、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司已实施或拟实施的财务性投资情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资及类金融业务。

六、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	57,394.77	96.85%	41,904.25	96.96%	34,486.36	95.78%
其他业务	1,869.60	3.15%	1,314.60	3.04%	1,517.57	4.22%
合计	59,264.37	100.00%	43,218.84	100.00%	36,003.93	100.00%

报告期各期，公司营业收入分别为 36,003.93 万元、43,218.84 万元和 59,264.37 万元，收入规模持续扩张。公司主营业务突出，报告期各期主营业务收入占营业收入的比重均超过 95%，具有良好的盈利能力和持续发展能力。公司其他业务收入主要为零星的设备贸易收入，占比较小。

2、主营业务收入分产品分析

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电镀液及配套试剂	28,775.70	50.14%	19,608.44	46.79%	17,879.96	51.85%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
光刻胶及配套试剂	13,591.69	23.68%	9,468.74	22.60%	6,877.32	19.94%
电镀配套材料	14,812.90	25.81%	12,665.31	30.22%	9,474.39	27.47%
其他电子化学品	214.48	0.37%	161.76	0.39%	254.69	0.74%
合计	57,394.77	100.00%	41,904.25	100.00%	34,486.36	100.00%

（1）电镀液及配套试剂

电镀液及配套试剂为公司目前的主导产品，广泛应用于半导体传统封装及先进封装领域的电镀工艺。在电镀液及配套试剂方面，公司已逐步取代美国杜邦等外资厂商，成为国内该领域的主力供应商之一，市场地位较为稳固。

报告期内，公司电镀液及配套试剂销售收入分别为 17,879.96 万元、19,608.44 万元和 28,775.70 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 51.85%、46.79%和 50.14%，是公司报告期内主营业务收入的主要来源之一。2024 年度，公司电镀液及配套试剂销售收入保持增长，但随着光刻胶及配套试剂、电镀配套材料销售收入的增长，电镀液及配套试剂的占比有所下降。2025 年度，公司电镀液及配套试剂销售收入大幅增长，主要系 INOFINE 纳入合并范围所致。

（2）光刻胶及配套试剂

光刻胶及配套试剂主要应用于先进封装、晶圆制造和半导体显示领域，具体产品包括各型号光刻胶以及光刻工艺所涉及的附着力促进剂、去除剂、显影液、蚀刻液等。

报告期各期，公司光刻胶及配套试剂产品销售收入分别为 6,877.32 万元、9,468.74 万元和 13,591.69 万元，保持持续快速增长，主要原因系下游需求持续景气，公司在相关产品完成国内主要先进封装厂商的产品导入后，采取较为积极的市场策略，快速抢占市场份额，销售收入随着市场需求持续快速增长。

（3）电镀配套材料

电镀配套材料主要包括锡球、镍珠等金属材料，以锡材为主。报告期各期，公司电镀配套材料的销售收入分别为 9,474.39 万元、12,665.31 万元和 14,812.90 万元。报告期内电镀配套材料销售收入持续增长，主要系锡材价格在报告期内整

体呈上涨趋势所致。

3、主营业务收入分地区构成分析

报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
内销	50,222.50	87.50%	39,257.46	93.68%	32,657.63	94.70%
外销	7,172.27	12.50%	2,646.79	6.32%	1,828.72	5.30%
合计	57,394.77	100.00%	41,904.25	100.00%	34,486.36	100.00%

报告期内，公司主营业务以内销为主，外销收入占主营业务收入的比例分别为 5.30%、6.32%和 12.50%。报告期内，公司积极开拓海外市场。2025 年度，公司外销收入同比增长 170.98%，增速较快，主要系 2024 年末完成收购 INOFINE 的 80%股权，2025 年度纳入合并范围所致。

4、主营业务收入的季节性变动

报告期内，公司主营业务收入按季度划分的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	12,512.87	21.80%	8,166.96	19.49%	6,482.33	18.80%
第二季度	15,199.40	26.48%	9,792.55	23.37%	8,164.24	23.67%
第三季度	15,501.99	27.01%	12,563.68	29.98%	9,201.02	26.68%
第四季度	14,180.51	24.71%	11,381.06	27.16%	10,638.77	30.85%
合计	57,394.77	100.00%	41,904.25	100.00%	34,486.36	100.00%

受春节假期、下游半导体行业排产计划等因素影响，公司经营业绩存在一定的季节性特征。一般来说，每年第一季度通常为出货淡季，第三季度和第四季度产品销售相对较好，主要系为应对春节假期，避免造成订单延期交付，客户一般会在第三季度和第四季度月份加大开工量，提前完成客户订单。2023 年度和 2024 年度，公司销售收入均呈现三、四季度占比较高的特征。2025 年度，受 AI 芯片、存储芯片等领域需求持续攀升，行业景气度持续上升，季节性特征有所下降。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成情况

报告期内，公司营业成本具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	40,836.88	97.06%	30,775.94	96.78%	25,038.98	95.50%
其他业务	1,236.47	2.94%	1,025.36	3.22%	1,180.62	4.50%
合计	42,073.35	100.00%	31,801.30	100.00%	26,219.59	100.00%

报告期内，公司营业成本分别为 26,219.59 万元、31,801.30 万元和 42,073.35 万元。公司营业成本主要由主营业务成本构成，与当期主营业务收入占营业收入的比例相匹配。

2、主营业务成本构成情况

报告期内，公司主营业务成本按产品分类情况如下表：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电镀液及配套试剂	17,614.63	43.13%	10,820.09	35.16%	10,719.26	42.81%
光刻胶及配套试剂	8,764.64	21.46%	7,366.19	23.93%	4,932.83	19.70%
电镀配套材料	14,295.40	35.01%	12,411.42	40.33%	9,317.71	37.21%
其他电子化学品	162.21	0.40%	178.24	0.58%	69.18	0.28%
合计	40,836.88	100.00%	30,775.94	100.00%	25,038.98	100.00%

报告期各期，公司电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂和电镀配套材料产品销售成本占主营业务成本的比例分别为 99.72%、99.42%和 99.60%，系主营业务成本的主要构成部分。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利分析

报告期内，公司毛利构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	16,557.89	96.32%	11,128.30	97.47%	9,447.38	96.56%
其他业务	633.13	3.68%	289.24	2.53%	336.96	3.44%
合计	17,191.02	100.00%	11,417.54	100.00%	9,784.34	100.00%

报告期内，公司主营业务突出，毛利主要来自于主营业务。报告期内，公司主营业务毛利按产品分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电镀液及配套试剂	11,161.07	67.41%	8,788.35	78.97%	7,160.70	75.80%
光刻胶及配套试剂	4,827.05	29.15%	2,102.55	18.89%	1,944.48	20.58%
电镀配套材料	517.50	3.13%	253.89	2.28%	156.68	1.66%
其他电子化学品	52.27	0.32%	-16.49	-0.15%	185.52	1.96%
合计	16,557.89	100.00%	11,128.30	100.00%	9,447.38	100.00%

报告期内，公司电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂对主营业务毛利的贡献率分别为 96.38%、97.86%和 96.56%，是公司毛利的主要贡献来源。

2、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务分产品毛利率情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
电镀液及配套试剂	38.79%	50.14%	44.82%	46.79%	40.05%	51.85%
光刻胶及配套试剂	35.51%	23.68%	22.21%	22.60%	28.27%	19.94%
电镀配套材料	3.49%	25.81%	2.00%	30.22%	1.65%	27.47%
其他电子化学品	24.37%	0.37%	-10.20%	0.39%	72.84%	0.74%
合计	28.85%	100.00%	26.56%	100.00%	27.39%	100.00%

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 27.39%、26.56%和 28.85%，受产品结构及原材料价格波动影响，毛利率存在小幅波动。

（1）电镀液及配套试剂

报告期各期，公司电镀液及配套试剂毛利率分别为 40.05%、44.82%和 38.79%，毛利率有所波动。

2024 年度，公司电镀液及配套试剂毛利率同比提高 4.77 个百分点，主要原因系：①产品结构优化，应用于先进封装等领域的高毛利产品销售收入增长；②电镀液及配套试剂类产品中毛利率较高的添加剂产品收入占比提升，带动新能源领域业务毛利率提升。

2025 年度，公司电镀液及配套试剂毛利率有所下降，主要原因系：①2025 年 INOFINE 纳入合并范围，因 INOFINE 目前主要从事电镀液及相关配套试剂的贸易业务，毛利率低于公司自产产品；②2025 年度，公司电镀液及配套试剂中，新能源行业销售金额增长，产品毛利率低于半导体行业。随着公司马来西亚厂房及生产线的建设，以及自产产品销售占比的提升，预计 INOFINE 的毛利率将持续改善。

（2）光刻胶及配套试剂

报告期内，公司光刻胶及配套试剂毛利率分别为 28.27%、22.21%和 35.51%，受产品结构的影响毛利率有所波动。

2024 年度，公司光刻胶及配套试剂毛利率同比下降 6.06 个百分点，主要原因系：①2024 年度，受下游客户产品替换进度的影响，公司先进封装负性光刻胶收入规模有所下降，自研光刻胶收入占比有所下滑，导致光刻胶毛利率下滑较多；②公司加强蚀刻液等产品的市场拓展力度，蚀刻液产品收入增长，但单价下降，毛利率下滑所致。

2025 年度，公司光刻胶及配套试剂毛利率同比提高 13.30 个百分点，毛利率大幅提高，主要原因系：①2025 年度，公司先进封装负性光刻胶在多家客户完成产品导入，进入放量阶段，收入规模大幅增长，带动自研光刻胶占比大幅提高，毛利率回升；②随着南通工厂产能的持续释放，规模效应的有效发挥，叠加 NMP、环戊酮等主要原材料价格的下滑，公司显影液、去除剂产品单位成本下降，毛利率大幅回升。

3、与同行业上市公司的毛利率比较

报告期内，公司与同行业可比公司综合毛利率对比如下：

证券代码	公司简称	综合毛利率		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
300236.SZ	上海新阳	41.00%	39.29%	35.16%
688019.SH	安集科技	56.72%	58.45%	55.81%
300655.SZ	晶瑞电材	24.94%	19.23%	23.61%
688603.SH	天承科技	40.04%	39.85%	35.70%
可比公司平均值		40.68%	39.21%	37.57%
发行人		29.01%	26.42%	27.18%
发行人（剔除电镀配套材料）		37.51%	36.54%	36.29%

注：数据来源为同行业上市公司定期报告。

报告期内，公司各期毛利率高于晶瑞电材，低于同行业可比公司平均水平，主要系产品结构差异所致。发行人电镀配套材料业务主要系电镀工艺配套的锡球、镍饼等阳极金属材料及阳极袋、退镀用胶条等辅材，以满足客户的整体需求，不属于电子化学品。剔除电镀配套材料的影响，报告期内公司毛利率分别为 36.29%、36.54%和 37.51%，与同行业可比公司不存在重大差异。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	收入占比	金额	收入占比	金额	收入占比
销售费用	3,516.58	5.93%	2,552.12	5.91%	2,012.30	5.59%
管理费用	3,099.73	5.23%	2,472.09	5.72%	2,043.16	5.67%
研发费用	6,942.21	11.71%	4,590.17	10.62%	3,268.79	9.08%
财务费用	-469.85	-0.79%	-853.73	-1.98%	-281.46	-0.78%
合计	13,088.67	22.09%	8,760.65	20.27%	7,042.79	19.56%

报告期内，公司期间费用总额分别为 7,042.79 万元、8,760.65 万元和 13,088.67 万元，占各期营业收入比例分别为 19.56%、20.27%和 22.09%，整体呈上升趋势，主要系公司研发费用增长较快所致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	1,859.24	52.87%	1,562.01	61.20%	1,258.57	62.54%
业务招待费	676.38	19.23%	503.75	19.74%	452.55	22.49%
销售服务费	451.17	12.83%	90.44	3.54%	46.20	2.30%
差旅费	260.58	7.41%	186.20	7.30%	152.33	7.57%
折旧及摊销	100.77	2.87%	103.35	4.05%	42.90	2.13%
股份支付	50.16	1.43%	-	-	-	-
办公费	39.28	1.12%	22.50	0.88%	13.94	0.69%
运输快递费	6.96	0.20%	2.10	0.08%	3.01	0.15%
其他	72.04	2.05%	81.77	3.20%	42.80	2.13%
合计	3,516.58	100.00%	2,552.12	100.00%	2,012.30	100.00%

报告期各期，公司销售费用分别为 2,012.30 万元、2,552.12 万元和 3,516.58 万元，主要由职工薪酬、业务招待费、差旅费构成。报告期内，公司销售费用持续增长，主要系公司加大先进封装、晶圆领域的市场开拓，销售团队建设及商务活动增加，相应的职工薪酬、业务招待费和差旅费增加所致。2025 年度，公司销售服务费大幅增加，主要系 INOFINE 纳入合并范围销售佣金增加所致。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	1,430.73	46.16%	1,027.02	41.54%	957.43	46.86%
服务费	329.65	10.63%	436.10	17.64%	278.05	13.61%
折旧及摊销	597.75	19.28%	424.31	17.16%	238.34	11.67%
办公费	274.60	8.86%	254.99	10.31%	214.85	10.52%
业务招待费	227.27	7.33%	189.45	7.66%	121.52	5.95%
宣传费	47.54	1.53%	1.37	0.06%	87.82	4.30%
汽车费用	25.93	0.84%	53.96	2.18%	46.76	2.29%
董事会费	24.00	0.77%	22.17	0.90%	18.00	0.88%
差旅费	18.97	0.61%	18.95	0.77%	14.98	0.73%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
修理费	17.90	0.58%	0.20	0.01%	11.74	0.57%
股份支付	56.96	1.84%	-	-	-	-
其他	48.43	1.56%	43.57	1.76%	53.67	2.63%
合计	3,099.73	100.00%	2,472.09	100.00%	2,043.16	100.00%

报告期各期，公司管理费用分别为 2,043.16 万元、2,472.09 万元和 3,099.73 万元，占各期营业收入的比例分别为 5.67%、5.72%和 5.23%，主要由职工薪酬、服务费、折旧及摊销、办公费以及业务招待费等构成。报告期内，公司管理费用持续增长，主要原因系：（1）随着公司经营规模扩大和组织结构优化，管理人员数量有所增加，工资、奖金、办公费等费用相应增长；（2）随着公司资产规模的持续扩张，折旧摊销费用增加。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	2,884.33	41.55%	2,236.95	48.73%	1,582.63	48.42%
材料费	1,839.72	26.50%	1,085.53	23.65%	1,165.63	35.66%
技术服务费	437.21	6.30%	387.47	8.44%	164.77	5.04%
维护费	7.30	0.11%	14.82	0.32%	23.65	0.72%
折旧及摊销	1,104.06	15.90%	517.89	11.28%	200.54	6.13%
差旅费	137.39	1.98%	120.25	2.62%	89.08	2.73%
股份支付	100.32	1.45%	-	-	-	-
其他	431.88	6.22%	227.26	4.95%	42.49	1.30%
合计	6,942.21	100.00%	4,590.17	100.00%	3,268.79	100.00%

报告期各期，公司研发费用分别为 3,268.79 万元、4,590.17 万元和 6,942.21 万元，占各期营业收入的比例分别为 9.08%、10.62%和 11.71%，整体呈快速增长趋势。公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、技术服务费以及折旧和摊销等构成。报告期内，公司研发费用快速增长，主要原因系：（1）公司聚焦光刻胶、先进制程电镀液等高端产品的技术攻关，持续加大研发投入；（2）随着公司集

成电路测试中心大楼的建成使用，折旧及摊销费用有所增加。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息费用	439.72	218.41	227.92
减：利息收入	1,019.48	1,068.03	514.88
汇兑损益	93.87	-16.52	-2.26
手续费及其他	16.04	12.41	7.76
合计	-469.85	-853.73	-281.46

报告期各期，公司财务费用分别为-281.46 万元、-853.73 万元和-469.85 万元和，主要由利息费用、利息收入等组成。

（五）利润表其他项目分析

1、税金及附加

报告期各期，公司税金及附加分别为 183.19 万元、191.66 万元和 249.17 万元，主要由房产税、印花税等构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	13.90	4.31	28.36
教育费附加	8.34	2.59	17.02
房产税	159.01	128.51	78.92
土地使用税	11.55	11.55	11.55
印花税	50.45	42.50	27.16
地方教育费附加	5.56	1.72	11.34
环境保护税	-	-	8.41
其他	0.36	0.48	0.43
合计	249.17	191.66	183.19

2、其他收益

报告期各期，公司其他收益分别为 717.99 万元、322.80 万元和 1,023.16 万元，主要由政府补助、增值税加计抵减等构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	216.82	303.41	461.94
增值税加计抵减	797.57	14.87	251.36
个税手续费返还	8.77	4.52	4.69
合计	1,023.16	322.80	717.99

报告期内，公司其他收益金额变动幅度较大，主要系增值税加计抵减金额变动较大所致。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
交易性金融资产在持有期间的投资收益	234.85	422.68	40.46
合计	234.85	422.68	40.46

报告期内，公司投资收益金额变动幅度较大，主要系公司使用暂时闲置资金购买结构性存款的规模差异所致。

4、公允价值变动收益

报告期各期，公司公允价值变动收益分别为 22.40 万元、-16.18 万元和-10.86 万元，主要来源于理财产品，金额较小。

5、信用减值损失

报告期各期，公司信用减值损失分别为-157.71 万元、-206.07 万元和-49.76 万元，主要为应收账款、其他应收款的坏账损失。

6、资产减值损失

报告期各期，公司资产减值损失分别为-8.97 万元、-75.48 万元和-154.44 万元，主要为存货跌价损失。

7、资产处置收益

报告期各期，公司资产处置收益分别为-1.41 万元、7.55 万元和 5.25 万元，均系固定资产处置形成，金额较小。

8、营业外收入

报告期各期，公司营业外收入分别为 141.70 万元、386.61 万元和 129.07 万元，主要系政府补助。

9、营业外支出

报告期各期，公司营业外支出分别为 14.60 万元、2.62 万元和 31.81 万元，主要为对外捐赠支出、滞纳金及罚款等。

10、所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	170.42	3.35	2.48
递延所得税费用	-335.23	-46.58	30.00
合计	-164.81	-43.23	32.48

（六）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

主要财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2.02	6.96	-1.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	300.11	671.87	603.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	223.99	406.51	62.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	15.86	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.26	-2.03	-14.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减：所得税影响额	76.77	190.55	101.23
少数股东权益影响额	-0.32	-	-
合计	423.42	908.62	549.26

报告期各期，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 549.26 万元、908.62 万元和 423.42 万元，占当期归属于母公司股东的净利润比例分别为 16.82%、27.14%和 8.27%，主要是计入当期损益的政府补助以及理财产品产生的收益。

七、现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	52,147.22	31,576.95	23,348.68
经营活动现金流出小计	44,039.42	34,048.81	31,801.86
经营活动产生的现金流量净额	8,107.80	-2,471.86	-8,453.18
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	56,137.84	53,626.68	16,849.09
投资活动现金流出小计	67,043.79	74,083.60	44,582.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,905.95	-20,456.92	-27,733.64
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	34,576.86	26,233.16	83,378.36
筹资活动现金流出小计	26,709.53	32,732.08	9,287.99
筹资活动产生的现金流量净额	7,867.33	-6,498.92	74,090.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60.37	-0.26	2.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,008.81	-29,427.96	37,905.55
加：期初现金及现金等价物余额	9,261.93	38,689.89	784.34
六、期末现金及现金等价物余额	14,270.74	9,261.93	38,689.89

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	51,092.59	29,563.73	21,282.39
收到的税费返还	208.07	209.35	1,212.45
收到其他与经营活动有关的现金	846.55	1,803.87	853.84

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计	52,147.22	31,576.95	23,348.68
购买商品、接受劳务支付的现金	30,491.07	23,324.20	21,023.77
支付给职工及为职工支付的现金	7,136.17	5,794.29	4,575.10
支付的各项税费	787.51	634.66	2,705.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,624.67	4,295.66	3,497.45
经营活动现金流出小计	44,039.42	34,048.81	31,801.86
经营活动产生的现金流量净额	8,107.80	-2,471.86	-8,453.18

1、经营活动现金流量变动分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-8,453.18 万元、-2,471.86 万元和 8,107.80 万元，公司经营活动现金流量净额持续改善。

报告期内，公司销售收款情况良好，但因部分下游客户采用票据结算，受票据收款以及票据处理方式等因素的影响，2023 年度和 2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负。

还原票据的影响，公司经营活动产生的现金流量净额情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额①	8,107.80	-2,471.86	-8,453.18
票据到期承兑计入经营活动现金流量金额②	4,418.69	8,445.08	2,400.72
票据收付款净额③	12,054.61	14,966.57	12,408.40
还原票据收付影响后的经营活动产生的现金流量净额 ④=①-②+③	15,743.72	4,049.63	1,554.50

还原票据收付后的经营活动产生的现金流量净额为 1,554.50 万元、4,049.63 万元和 15,743.72 万元，经营活动现金净流量与公司经营业绩相匹配。

2、净利润与经营活动现金流量净额的匹配情况

报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额的匹配情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	5,163.46	3,347.75	3,265.73
加：资产减值准备	154.44	75.48	8.97

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
信用减值损失	49.76	206.07	157.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,165.33	2,311.18	1,821.08
使用权资产摊销	70.64	46.18	41.41
无形资产摊销	174.18	54.51	53.18
长期待摊费用摊销	190.39	75.31	17.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-5.25	-7.55	1.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3.24	0.59	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	10.86	16.18	-22.40
财务费用（收益以“－”号填列）	-476.72	-627.60	-255.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-234.85	-422.68	-40.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-338.75	-0.39	7.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3.52	-46.19	22.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	-987.95	-1,367.71	-506.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,301.86	-23,402.00	-24,989.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,018.14	17,168.82	12,173.30
其他	449.22	100.20	-209.40
经营活动产生的现金流量净额	8,107.80	-2,471.86	-8,453.18

（二）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	55,680.65	52,661.01	16,513.31
取得投资收益收到的现金	446.74	965.67	335.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.45	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	56,137.84	53,626.68	16,849.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,480.60	9,221.42	6,249.44
投资支付的现金	52,563.18	63,315.09	38,333.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,547.09	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	67,043.79	74,083.60	44,582.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,905.95	-20,456.92	-27,733.64

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-27,733.64 万元、-20,456.92 万元和-10,905.95 万元，主要系报告期内购建固定资产及使用暂时闲置资金进行现金管理所致。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	792.60	-	57,131.54
取得借款收到的现金	33,784.26	26,233.16	26,246.82
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	34,576.86	26,233.16	83,378.36
偿还债务支付的现金	26,150.00	22,721.42	8,937.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455.18	1,890.22	293.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	104.35	8,120.44	57.79
筹资活动现金流出小计	26,709.53	32,732.08	9,287.99
筹资活动产生的现金流量净额	7,867.33	-6,498.92	74,090.37

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 74,090.37 万元、-6,498.92 万元和 7,867.33 万元。2023 年度，公司筹资活动现金流入金额较大，主要系公司公开发行股票取得募集资金所致。2024 年和 2025 年，公司筹资活动流入的现金主要为取得借款、票据贴现等收到的现金，筹资活动现金流出主要用于偿还债务、支付利息、分配股利等。

八、资本性支出分析

（一）报告期内公司重大资本性支出情况

报告期内，公司的资本性支出均围绕主营业务进行。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 6,249.44 万元、9,221.42

万元和 14,480.60 万元，主要系前次募投项目投入。

上述资本性支出均为与公司主营业务相关的支出，是为了公司日常经营正常开展、持续提升生产能力的必要投入，公司市场竞争力得以持续巩固和强化。

（二）未来可预见的重大资本性支出

公司已与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，拟在南通市经济技术开发区获取项目用地，并建设“艾森集成电路材料华东制造基地项目”，建设年产 23,000 吨集成电路材料生产线，产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等，其中一期项目为本次募集资金投资项目。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

报告期内，公司通过重大资本性支出投入有效增加产能，并通过“集成电路材料测试中心项目”的建设，聚焦于半导体光刻胶、电镀液及配套试剂进行研发、测试与性能评价，成功打造国内一流的集成电路关键材料研发测试平台。

公司未来可预见的重大资本性支出为“艾森集成电路材料华东制造基地项目”，项目将提高光刻胶配套树脂的生产能力，扩大光刻胶、湿电子化学品等高端产品的产能，进一步优化产品结构，为公司先进封装及晶圆领域产品的持续放量奠定坚实基础。

九、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司技术先进性及具体表现详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、与产品或服务有关的技术情况”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	所处阶段及进展	拟达到的目标	技术水平	主要应用领域	项目预算（万元）
1	先进封装用负性 PSPI	客户端验证阶段	（1）优异的材料稳定性和过程稳定性，满足在材料储存及使用过程中对 PSPI 的要求，具备良好的工艺窗口；（2）通过聚合物结构设计及纯化技术，保证材料具有优异的机械性能、电学性能以及热稳定性，满足先进封装制程对材料性能的要求；（3）通过特殊的结构和配方设计，保	对标国际竞品，公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路先进封装领域	1,625

序号	项目名称	所处阶段及进展	拟达到的目标	技术水平	主要应用领域	项目预算(万元)
			证 PSPI 对铜及其他材料具有优异的结合力。			
2	晶圆制造钝化防护层用正性 PSPI	小批量交付阶段	(1) 优异的材料稳定性和过程稳定性, 满足在材料储存及使用过程中对 PSPI 的要求, 具备良好的工艺窗口; (2) 通过聚合物结构设计及纯化技术, 保证材料具有优异的机械性能、电学性能以及热稳定性, 满足晶圆制造对材料性能的要求; (3) 通过特殊的结构和配方设计, 保证 PSPI 对各种基板具有优异的结合力。	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于半导体晶圆制造领域	1,320
3	大马士革铜互联工艺镀铜添加剂	量产阶段	(1) 解决公司在大马士革电镀领域的技术空白, 并为公司将来开发更高阶产品 (5-14nm 节点) 奠定技术和市场基础; (2) 协助客户实现 28nm 全流程国产化, 产品性能达到国际同类产品水平	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于半导体晶圆制造领域	2,150
4	IC 先进封装电镀铜添加剂	验证批次稳定性阶段	(1) 适应大电流镀铜应用; (2) 能同时应用 Bumping、RDL 等工艺应用; (3) 铜柱顶端平整, 凹陷或突起不超过 3 μ m	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路先进封装领域	1,010
5	AS7100 晶圆用化学放大正胶	客户端验证阶段	研发一款高膜厚应用的化学放大型正性光刻胶, 5 μ m 厚度下满足 AR>5, 分辨率 1 μ m 以内的应用要求; 金属杂质含量控制小于 10ppb	对标国外竞品, 公司产品目前在客户端的测试结果与国际竞品性能相当	应用于半导体晶圆制造领域	1,070
6	封装基板 (IC Substrate) 的酸铜添加剂	客户端验证阶段	(1) 通过精确控制电镀过程中的各项参数, 提高线路的细线精度和均匀性, 有效提高线路的集成度和性能。(2) 采用高填充率电镀技术, 有效提高线路的导电率, 降低线路的电阻, 减少线路发热, 有效提高线路的抗蚀性, 延长线路的使用寿命。(3) 通过提高添加剂的使用效率, 降低添加剂的用量, 减少电镀过程中的浪费, 提高生产效率, 有效降低线路的生产成本。	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路先进封装领域	230
7	PLP 封装基板用高性能电镀添加剂	实验室测试阶段	(1) 通过配方设计, 配合添加剂体系协同优化技术, 通过引入新型功能基团, 使得电镀添加剂具有更强的吸附能力或更广泛的分散性, 能够在电镀过程中更均匀地覆盖在基材表面, 从而避免局部过度沉积或不足的问题, 提高镀层的整体均匀性。(2) 采用一些具有特殊的化学结构的新型功能基团, 能够与镀层金属离子形成更稳定的化学键, 从而减少镀层内部的应力积累, 提高镀层的韧性和耐久性。(3) 采用新型功能基团优化镀层性能, 并通过建立完善的镀液性能表征体系, 使得开发的电镀添加剂在某些关键指标上超越竞争对手, 为 PLP 封装基板的应用提供更高质量的镀层解决方案。	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路先进封装领域	440
8	OLED 用银蚀刻液	实验室测试阶段	(1) 通过蚀刻液的配方设计, 为 OLED 阳极材料提供国产化的湿法蚀刻技术, 提高 OLED 制造的效率和品质, 推动 OLED 制造技术的进一步发展。(2) 通过优化蚀刻液的配方和蚀刻工艺参数, 为 OLED 厂商提供性能稳定、工艺窗口广泛的银蚀刻液产品。(3) 采用合适的蚀刻剂、抑制剂、表面活性剂等成分, 能够有效防止蚀刻过程中银蚀刻液对缝隙腐蚀和 Ag 析出, 为	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于半导体显示领域	800

序号	项目名称	所处阶段及进展	拟达到的目标	技术水平	主要应用领域	项目预算(万元)
			OLED 厂商提供材料相容性良好, 较长蚀刻寿命, 可靠性高的银蚀刻产品。			
9	高厚膜 KrF 光刻胶	实验室研发阶段	(1) 选用高透明性的新型 PSH 类及丙烯酸树脂作为光刻胶的主要成分, 使得光刻胶在高膜厚下仍能保持良好的透明性和成像效果。(2) 引入高活性低吸收的光致产酸剂, 优化光刻胶的化学反应过程, 不仅提高光刻胶的成像精度和分辨率, 还减少光线的吸收和散射, 提高光刻胶的灵敏度。(3) 采用 PHS 树脂和丙烯酸树脂的共混技术, 解决 KrF 光刻胶在高膜厚下的透明性问题, 不仅提高光刻胶的透明性, 还实现不同树脂之间的优势互补, 提高光刻胶的综合性能。	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于半导体晶圆制造领域	1,500
10	高速电镀锡银添加剂	客户端验证阶段	(1) 采用 U low α 甲基磺酸锡提纯技术, 通过创新性的电解技术和膜技术, 成功实现从普通锡球中提纯 U low α 甲基磺酸锡, 打破国外垄断, 为高性能锡银电镀液的开发提供可靠的原料来源。(2) 采用锡银电镀添加剂优化技术, 通过在高速纯锡电镀添加剂的基础上进行优化, 以满足锡银电镀的特殊需求, 不仅提高添加剂的适用性, 还确保镀层质量的稳定性和一致性。(3) 采用银离子络合剂的筛选测试技术, 选择具有优异络合效果的硫脲类化合物或硫醇类化合物作为银离子络合剂, 不仅稳定镀液, 还优化银离子在镀层中的分布, 提高镀层的质量和可靠性。	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路先进封装领域	500
11	OLED 的高感度光刻胶	客户端验证阶段	开发一种用于 oled 的高感度光刻胶。通过深入研究光刻胶主体树脂、感光剂、添加剂及溶剂等关键组分的种类选择和配比; 不同结构类型的线型酚醛及辅助树脂对光刻胶性能的影响; 增感剂、表面活性剂等对光刻胶均匀性、稳定性和感光速度的调节作用等, 优化试剂配方, 提升产品成膜均一性、感光速度、基板粘附性, 形貌, 耐刻蚀等关键核心性能指标, 建立完善的光刻胶性能测试体系, 包括光刻胶粘度、固含量、UV 吸收、水分含量、成膜均一性、灵敏度、残膜率、对比度、耐蚀刻性、热稳定性等关键性能指标的标准测试方法, 以实现批量稳定生产。	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于半导体显示领域	600
12	新型环保型 Deflux 产品	实验室研发阶段	研究一种环保型的半导体封装用助焊剂清洗剂, 通过研究无机碱与有机碱的效果差异, 优化最佳的碱组合; 优化配方中溶剂及其组合, 达到最佳的助焊剂清洗效果; 优化表面活性剂及其组合, 达到最好的清洗能力和水洗能力; 优选最佳的阻蚀剂及其组合, 达到材料相容性的要求, 最终形成一套完善的助焊剂清洗制备工艺, 提升清洗质量与效率	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路封装领域	600
13	先进封装金凸块制作的负性光刻胶	客户端验证阶段	研发一种高耐化学性, 特别是对氧化物的光刻胶, 通过采用高透明性丙烯酸树脂, 并结合高交联度交联剂以及高活性的光引发剂, 确保光刻胶在高膜厚条件下仍能实现良好的成像效果与卓越的耐电镀性能。同时, 引入增塑结构, 解决电镀应力释放问题, 达到国际产品同等水平, 打破国外公司的技术垄断	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路先进封装领域	400
14	fine-pitch RDL 制作的化学放大正性光刻胶	客户端验证阶段	研究一种用于 fine-pitch RDL 制作的化学放大正性光刻胶, 通过深入研究光刻胶主体树脂、感光剂、添加剂及溶剂等关键组分的种类选择和配比, 研究不同结构保护基团的 PHS/线性酚醛树脂对光刻胶性能的影响。探索此类光刻胶的制备工艺, 包括原材料混合、溶解、过滤等关键步骤	对标国际竞品, 公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于半导体晶圆制造领域	300

序号	项目名称	所处阶段及进展	拟达到的目标	技术水平	主要应用领域	项目预算(万元)
			对光刻胶批次稳定性的影响,建立完善的光刻胶性能测试体系,包括光刻胶粘度、固含量、UV吸收、水分含量、成膜均一性、灵敏度、残膜率、对比度、耐蚀刻性、热稳定性等关键性能指标的标准测试方法,以保证为客户提供稳定的光刻胶产品。			
15	TSV制作的高速镀铜添加剂	客户端验证阶段	研究一种用于TSV制作的高速镀铜添加剂,通过配方体系设计,开发基于 $\text{CuSO}_4\text{-H}_2\text{SO}_4\text{-Cl}^-$ 的基础电解液,优化加速剂、抑制剂、整平剂的配比;研究低应力铜沉积添加剂,减少TSV热机械应力。针对不同深宽比TSV调整电镀参数;匹配2.5D中介层与3D堆叠两种应用场景,并通过老化实验评估电镀铜的长期稳定性。	对标国外竞品,公司产品目前在实验室评估阶段与国际竞品性能相当	应用于集成电路先进封装领域	450
16	芯片用超纯硫酸铜	小批量交付阶段	配套大马士革电镀液使用,满足28nm电镀节点要求。技术指标为:溶液中金属杂质总量小于5ppm,有机物含量小于10ppm,颗粒($>0.20\mu\text{m}$)小于200unit/ml	对标国外竞品,公司产品目前在实验室评估阶段与国际竞品性能相当	应用于半导体晶圆制造领域	855
17	晶圆制造超纯硫酸钴电镀液	客户端验证阶段	研发一种超纯硫酸钴基液,通过隔膜电解加重结晶技术结合梯度电解法,精准控制离子膜参数与电解流程,实现硫酸钴金属杂质提纯;利用筛选出的高性能离子树脂,优化硼酸溶液流速等工艺,高效去除硼酸中的金属杂质。旨在产品纯度上达到国际先进标准,突破国外技术垄断,填补国内集成电路高端原料领域的技术空白。	对标国际竞品,公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于半导体晶圆制造领域	1,200
18	Ultra-low α 锡浓缩液	实验室测试阶段	研发一种Ultra-low α 锡浓缩液,通过多级提纯、深度除杂工艺,严格控制原料中的放射性物质与金属杂质;研发适配高浓度溶液的合成工艺,优化反应条件与配方比例,确保产品的稳定性与均匀性,实现300g/L的甲基磺酸锡溶液,放射性 α 粒子发射率	对标国际竞品,公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路先进封装领域	600
19	化学镍钯金材料	初步量产阶段	开发一整套的化学镍钯金药液配方,适用于晶圆高密度、细线宽产品的化镀。基于全新镀液配方,显著提高了镀液的稳定性和镀层的均匀性,减少了钯盐析出,解决了传统镀液中金属离子迁移和氯离子引起的电化学腐蚀问题。	对标国际竞品,公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于集成电路封装领域	953
20	晶圆水平电镀设备	客户端验证阶段	(1)通过优化电镀液配方和电流分布,结合精密的温度控制,确保电镀层在晶圆表面的均匀沉积,解决传统电镀设备在复杂结构芯片制造中的沉积不均问题。(2)引入先进的在线监测系统,能够实时检测电镀过程中的关键参数,如电流密度、电镀液成分及温度等,实现电镀过程的精准控制。(3)致力于减少电镀过程中的废弃物排放,通过高效电镀液循环系统和回收利用技术,显著降低化学品消耗和废水排放。	对标国际竞品,公司产品在实验室评估阶段与国际产品性能相当	应用于半导体晶圆制造领域	603

(三) 保持持续技术创新的机制和安排

公司通过加大研究投入,培养建设高素质的研发团队,保持公司核心技术的不断创新,形成丰富的技术储备。

公司保持持续技术创新机制和安排参见本募集说明书“第四节 发行人基本

情况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”之“（二）保持科技创新能力的机制或措施”相关内容。

十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至报告期末，发行人不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、仲裁、诉讼、其他或有负债和重大期后事项。根据《科创板上市规则》相关规定，本募集说明书所指的“重大诉讼、仲裁”系指涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计总资产或者市值 1%以上的未决诉讼、仲裁案件。

十一、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司的业务和资产规模将进一步扩大。本次发行募集资金拟投资于电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）及补充流动资金，均围绕公司主营业务展开。

本次募投项目实施以后，将有助于公司提高光刻胶配套树脂的生产能力，扩大光刻胶、湿电子化学品等高端产品的产能，进一步优化产品结构，为公司先进封装及晶圆领域产品的持续放量奠定坚实基础。

因此，本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，投向科技创新领域，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募投项目实施完成后，公司将建成高标准的光刻胶配套树脂及湿电子化学品产线，打造集光刻胶、光刻胶配套树脂及湿电子化学品研发、生产、检测、销售于一体的高端电子化学品生产基地，进一步强化公司在产品定价、市场份额争夺中的竞争优势，显著提升核心市场竞争力与行业影响力，提升公司的科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、报告期内发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

（一）发行人报告期内重大违法违规行为及行政处罚的情况

报告期内，公司的子公司存在一项行政处罚，罚款金额为 1.06 万元，不属于重大违法违规，不会对本次发行构成障碍。除上述处罚之外，报告期内发行人及其子公司不存在其他行政处罚的情况，具体情况如下：

2025 年 8 月 8 日，南通市生态环境局出具行政处罚决定书（通 09 环罚[2025]12 号）：南通艾森因未按规定开展环境隐患排查治理，违反了《突发环境事件应急管理办法》第六条第一款第三项和第十条第一款的规定，根据《突发环境事件应急管理办法》第三十八条第二项以及《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》表 19 “通用裁量表”的规定对南通艾森罚款 10,600 元，南通艾森已及时足额缴纳上述罚款并完成整改。

行政处罚决定书所述的《突发环境事件应急管理办法》第三十八条第二项规定：“企业事业单位有下列情形之一的，由县级以上环境保护主管部门责令改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：……（二）未按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案的；……”，因此，南通艾森上述罚款金额处于前述规定的较低档次，且南通市生态环境局已结合南通艾森的积极整改情节在行政处罚决定书中明确对南通艾森适用从轻处罚原则，因此南通艾森所受处罚不构成重大违法违规，不影响可转债的发行条件。

（二）发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

报告期内，公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在对外担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争

发行人控股股东为张兵，实际控制人为张兵、蔡卡敦夫妇。除发行人及其子公司外，张兵及蔡卡敦控制的其他企业为宁波艾森。宁波艾森为发行人持股平台，与发行人之间不存在同业竞争的情形。宁波艾森的基本情况见“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来变化情况”之“（二）控股股东和实际控制人投资的其他企业”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人于 2022 年出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“1、本人（含本人直接、间接控制的公司、企业，下同）目前不存在与发行人（含发行人直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。

2、本人未来不会在任何地域以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与发行人构成同业竞争的活动。

3、本人未来不会向与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。

4、本人不会利用对发行人控制关系损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证发行人的独立经营和自主决策。

本承诺将持续有效，直至本人不再控制发行人或者发行人从证券交易所退市

为止。在承诺有效期内，如果本人违反本承诺给发行人造成损失的，本人将及时向发行人足额赔偿相应损失。

本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给发行人及其他利益相关者造成的相关损失。”

（三）本次发行对公司同业竞争的影响

本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不会因本次发行产生同业竞争。

四、关联方和关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《科创板上市规则》等中国境内法律的规定，截至报告期末，发行人的主要关联方及关联关系如下：

1、直接或者间接控制发行人的自然人

序号	关联方姓名	关联关系
1	张兵	发行人的控股股东、实际控制人
2	蔡卡敦	发行人的实际控制人

2、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人

除发行人的控股股东、实际控制人外，不存在其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人。

3、发行人的董事及高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1	张兵	发行人的董事长
2	向文胜	发行人的董事、总经理
3	陈小华	发行人的董事、常务副总经理、董事会秘书
4	杨一伍	发行人的董事
5	沈鑫	发行人的董事

序号	姓名	关联关系
6	孙清清	发行人的独立董事
7	黄晓刚	发行人的独立董事
8	李挺	发行人的独立董事
9	赵建龙	发行人的副总经理
10	谢立洋	发行人的副总经理
11	程瑛	发行人的副总经理
12	吕敏	发行人的财务总监

4、与发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关系密切的家庭成员

与发行人控股股东、实际控制人、发行人的董事及高级管理人员关系密切的家庭成员（关系密切的家庭成员包括其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）均为发行人的关联方。

5、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	宁波艾森（执行事务合伙人为张兵）	直接持有发行人 6.66%的股份

6、由本项第 1 目至第 5 目所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织（发行人及其子公司或上述已披露的主体除外）亦为发行人的关联方，该等主体主要包括：

序号	关联方名称	关联关系
1	宁波艾龙	发行人董事、常务副总经理、董事会秘书陈小华担任执行事务合伙人的企业
2	宁波艾荣企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事、常务副总经理、董事会秘书陈小华担任执行事务合伙人的企业
3	上海鳍展信息科技合伙企业（有限合伙）	发行人独立董事孙清清控制的企业
4	宁波麟芯企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人独立董事孙清清控制的企业
5	上海微链和企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人独立董事孙清清控制的企业

7、发行人的子公司

截至报告期末，发行人共有 5 家纳入合并财务报表范围的子公司¹，其中 3 家境内子公司、2 家境外子公司，该等子公司的具体情况见“第四节 发行人基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）公司直接或间接控股公司情况”。

8、其他关联方

除上述已提及的关联方外，公司的其他关联方还包括报告期内与发行人曾经存在关联关系的自然人、法人或其他组织以及按照实质重于形式的原则应当认定为关联方的其他主体。发行人主要的其他关联方包括：

（1）报告期内曾经存在关联关系的自然人、法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	北京芯动能投资基金（有限合伙）	曾持有发行人 5%以上股份的企业
2	天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	曾持有发行人 5%以上股份的企业
3	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	通过持有天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）99.9674%合伙份额曾间接持有发行人 5%以上股份的企业
4	武汉境亦通科技有限公司	曾持有发行人 5%以上股东北京芯动能投资基金（有限合伙）控制的企业
5	合肥奕思集成电路有限公司	曾持有发行人 5%以上股东北京芯动能投资基金（有限合伙）控制的企业
6	芯动能科技（香港）有限公司	曾持有发行人 5%以上股东北京芯动能投资基金（有限合伙）控制的企业（已解散）
7	天津煜辉管理咨询有限公司	曾持有发行人 5%以上股东天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人
8	赵烨	曾任发行人董事，已于 2023 年 1 月离任
9	秦舒	曾任发行人独立董事，已于 2024 年 2 月离任
10	朱雪珍	曾任发行人独立董事，已于 2024 年 2 月离任
11	孙杨	曾任发行人董事，已于 2024 年 8 月离任
12	俞信华	曾任发行人董事，已于 2024 年 8 月离任
13	熊秋丽	曾任发行人监事，已于 2025 年 9 月发行人取消监事会后离任
14	庄建华	曾任发行人监事，已于 2024 年 9 月离任

¹ 发行人于 2026 年 2 月 11 日设立艾森芯材。截至本募集说明书签署之日，发行人共拥有 6 家纳入合并财务报表范围的子公司。

序号	关联方名称	关联关系
15	苏州微矩精密科技有限公司	发行人实际控制人蔡卡敦曾任董事的企业，已于 2023 年 6 月离任
16	宁波国芯微电子科技有限公司	发行人独立董事孙清清曾任执行董事、经理并控制的企业，该企业已于 2025 年 3 月注销
17	无锡中科龙源投资管理有限公司	发行人独立董事黄晓刚曾任执行董事、经理并控制的企业，该企业已于 2026 年 4 月注销
18	江苏中科龙源网络科技有限公司	发行人独立董事黄晓刚曾任董事长、总经理并控制的企业，该企业已于 2024 年 11 月注销
19	无锡合进企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人原独立董事秦舒曾担任执行事务合伙人并控制的企业，已于 2024 年 1 月离任
20	深圳市顶慧天合管理咨询有限公司	发行人原独立董事秦舒弟弟秦曦持股 50%并担任执行董事、总经理的企业，已于 2012 年 1 月 16 日吊销，未注销
21	深圳市知慧天合管理咨询有限公司	发行人原独立董事秦舒弟弟的配偶魏文莉控制并担任执行董事、总经理的企业，已于 2026 年 5 月 28 日注销
22	芯聆半导体（苏州）有限公司	发行人原董事孙杨担任董事的企业
23	欣旺达动力科技股份有限公司	发行人原董事俞信华担任董事的企业
24	北京奕斯伟计算技术股份有限公司	发行人原董事俞信华担任董事的企业
25	NewnagyHoldings,Inc.	发行人原董事俞信华担任董事的企业
26	高景太阳能股份有限公司	发行人原董事俞信华担任董事的企业
27	西安奇点能源股份有限公司	发行人原董事俞信华担任董事的企业
28	上海世禹精密设备股份有限公司	发行人原董事俞信华担任董事的企业
29	上海秀派电子科技股份有限公司	发行人原董事俞信华担任董事的企业
30	苏州腾圣技术有限公司	发行人原董事俞信华担任董事的企业
31	珠海迪安娜投资有限公司	发行人原董事俞信华担任执行董事、经理的企业
32	广州市远能物流自动化设备科技有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事的企业，该企业已于 2025 年 2 月注销
33	珠海博芯管理咨询有限公司	发行人原董事俞信华曾担任执行董事、总经理的企业，该企业已于 2024 年 11 月注销
34	珠海畅新游创投资有限公司	发行人原董事俞信华曾担任执行董事、总经理的企业，该企业已于 2025 年 3 月注销
35	瑞浦兰钧能源股份有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事的企业，已于 2025 年 6 月离任
36	上海爱旭新能源股份有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事的企业，已于 2023 年 2 月离任
37	京东方华灿蓝晶科技（云南）有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事的企业，已于 2023 年 11 月离任
38	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事的企业，已于 2023 年 10 月离任
39	北京昆兰新能源技术有限公司	发行人原董事俞信华曾担任副董事长的企业，已于 2023 年 10 月离任

序号	关联方名称	关联关系
40	珠海尚方清洁能源科技有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事的企业，已于2026年3月离任
41	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事的企业，于2023年3月由董事变更为该企业监事会主席，于2023年8月变更为该企业的监事，2026年1月离任
42	京东方华灿光电股份有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事的企业，于2023年8月由董事变更为该企业监事会主席，2025年11月离任
43	爱奇投资顾问（上海）有限公司	发行人原董事俞信华曾担任董事兼总经理的企业，已于2023年11月离任
44	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	发行人原董事赵烨曾担任董事的企业，赵烨已于2022年3月辞任，自2023年4月起赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司与发行人不存在关联关系

（2）中国证监会、上交所或者发行人根据实质重于形式的原则，认定其他与发行人有特殊关系，可能或者已经造成发行人对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人，也属于发行人的关联方，包括但不限于：

序号	关联方名称	关联关系
1	苏州钧华	发行人直接持有其5%股份

除上述报告期内主要关联方外，在交易发生之日前12个月内，或者相关交易协议或者安排生效后的12个月内，具有前文所列情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，视同发行人的关联方。

（二）关联交易

1、报告期内的关联交易情况

发行人及子公司报告期内与关联方发生的关联交易情况如下：

（1）销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
苏州钧华	商品销售	2.97	-	-

（2）采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
苏州钧华	商品采购	1,209.97	-	-

（3）关联管理人员报酬

单位：万元

关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	601.02	591.43	436.04

(4) 关联方共同投资

2025 年 11 月 28 日，鲍杰、昆山艾维森投资合伙企业（有限合伙）、昆山钧和创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波艾荣企业管理合伙企业（有限合伙）、发行人、杨军共同签署《增资协议》，约定苏州钧华注册资本由 500 万元增加至 2,000 万元，新增注册资本 1,500 万元由鲍杰、昆山艾维森投资合伙企业（有限合伙）、昆山钧和创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波艾荣企业管理合伙企业（有限合伙）、发行人、杨军以 1 元/注册资本的认购价格分别认购 500 万元、300 万元、300 万元、200 万元、100 万元、100 万元（以下简称“投资苏州钧华”）。其中，宁波艾荣企业管理合伙企业（有限合伙）为发行人的董事/高级管理人员持股平台，因此投资苏州钧华构成发行人与关联方的共同投资。

根据《公司章程》，发行人投资苏州钧华的投资金额为 100 万元，不属于与关联人发生的成交金额超过 300 万元且占发行人最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的关联交易，发行人与关联方宁波艾荣企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资苏州钧华无需履行发行人的董事会及股东会审议程序。

2、报告期内与关联方往来余额情况

报告期各期末，公司与关联方的往来款项余额情况具体如下：

(1) 预付款项

单位：万元

关联方	2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
苏州钧华	405.28	-	-	-	-	-

(2) 其他应付款

单位：万元

关联方	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
张兵	-	-	0.07
向文胜	0.70	0.31	-

关联方	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
沈鑫	0.51	-	-
杨一伍	0.42	1.97	-
赵建龙	-	3.69	-
谢立洋	-	-	3.11

（三）关联交易的必要性、合理性和公允性

公司根据自身生产经营需求与关联方发生交易，相关交易具有合理商业背景及现实需求，关联交易具有必要性与合理性。公司关联交易定价公允，未侵害公司股东利益，且各年度交易规模较小，对发行人经营不具有重大影响。

（四）关联交易履行的程序及独立董事的有关意见

公司报告期内的关联交易系基于公司经营需要而发生，具有必要性、合理性，公司按照《公司章程》《关联交易管理制度》及《科创板上市规则》等规定，履行了相应的关联交易决策程序，独立董事发表了同意的独立意见（如需）；关联交易遵守了自愿、有偿的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，且不影响公司的独立性。

（五）规范关联交易的制度安排

公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。就报告期内与关联方发生的交易，发行人均已按照相关法律、法规规定、《公司章程》及其他内部管理制度履行了必要决策程序。

第七节 本次募集资金运用

一、募集资金运用的基本情况

公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 51,400.00 万元（含本数），拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）	67,320.00	47,400.00
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		71,320.00	51,400.00

若扣除发行费用后的本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性

（一）电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）

1、项目实施的必要性

（1）完善公司高端产品产业化布局，提升公司竞争力

本次募集资金投资项目主要投向光刻胶、光刻胶配套树脂及湿电子化学品等高端产品的产能建设，是公司深化战略布局、响应市场需求、构筑核心竞争壁垒的关键举措。本次项目建成后，将形成光刻胶及配套树脂、湿电子化学品共计 13,000 吨/年的产能规模，产品覆盖多型号光刻胶、光刻胶配套树脂以及湿电子化学品，将大幅提升公司在先进封装及晶圆制造领域高端电子化学品的量产能力，强化公司在核心高端材料领域的产能支撑，从而进一步优化公司产品结构，实现向高附加值、高技术壁垒产品的战略升级。

通过本次项目实施，公司将进一步强化光刻胶树脂等关键原材料的自产能

力，增强对下游半导体核心客户的综合服务能力，提升客户粘性与合作深度。同时，规模化产能将有效降低单位生产成本，强化公司在产品定价、市场份额争夺中的竞争优势，显著提升核心市场竞争力与行业影响力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

（2）把握市场发展机遇，培育业绩增长新动能

当前，AI 芯片、高带宽存储（HBM）、数据中心光互联（CPO）等市场持续快速扩张。在三维集成与先进封装行业的高速发展下，先进封装对光刻胶及配套试剂的需求逻辑已发生根本性转变。过去，光刻胶需求主要跟随封装产量线性增长；如今，堆叠层数每翻一番，光刻工艺次数便大致翻倍，形成超线性增长的乘数效应。HBM 正从 8 层向 12 层、16 层演进，SK 海力士已展出全球首款 16 层 HBM4 样品。每一层 DRAM 堆叠都需要独立的光刻工艺，堆叠层数的指数级增长，直接驱动光刻胶及配套试剂的需求量呈超线性扩张。先进封装对光刻胶及配套试剂的需求逻辑，已从线性增长彻底转向以堆叠层数为自变量的超线性扩张新范式。

公司在先进封装光刻胶及电镀液领域深耕多年，已构建起从核心材料研发、配方优化到工艺量产的全链条成熟体系，技术储备与产业化能力处于行业前列。通过持续研发投入，公司已形成覆盖先进封装全部工艺环节的产品矩阵，产品关键性能指标已达到国际同类产品水平，可充分匹配下游先进封装技术路线的应用需求。同时，经过长期技术验证与合作磨合，公司已与长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微等国内头部封测厂商建立稳定合作关系，产品通过客户批量验证并实现常态化供货，获得下游市场高度认可。

本次募集资金投资项目将进一步扩大先进封装相关高端产品的产能规模，优化生产工艺与供应链布局，精准匹配下游客户在 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进技术路线下的需求增长。依托在细分领域的技术先发优势与客户资源积累，公司可快速抢占先进封装电子化学品增量市场份额，将技术优势转化为市场竞争力与盈利增长力。同时，高附加值的先进封装配套产品将持续提升公司整体营收规模与盈利水平，培育形成可持续的业绩增长新动能，为公司实现跨越式发展注入核心动力。

（3）加速自主创新进程，保障供应链安全

光刻胶是半导体制造的核心关键材料。当前，全球高端电子化学品市场长期被日本 JSR、东京应化、信越化学及巴斯夫等少数企业垄断，尤其是高端光刻胶、光刻胶配套树脂及高纯度电子化学品，国内自给率极低，存在严重的供应链安全风险。

本次募集资金投资项目精准聚焦高端光刻胶及配套树脂、湿电子化学品两大核心品类。其中，光刻胶及配套树脂包括先进封装光刻胶、晶圆制造光刻胶、新型显示光刻胶以及相关配套树脂；湿电子化学品则包括蚀刻液、清洗液等。

依托公司多年积累的核心技术储备、成熟产业化经验及下游客户资源，项目建成后将实现上述高端产品的规模化、高品质量产，显著提升国内高端电子化学品的自给率，降低国内半导体企业对进口材料的依赖度，保障我国半导体产业链供应链高质量发展。

2、项目实施的可行性

（1）国家政策高度支持高端电子化学品行业的发展

国家高度重视高端电子化学品产业发展，出台一系列政策文件与扶持措施，形成全方位支持体系。在顶层设计层面，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将高端电子化学品纳入鼓励类范畴，明确支持关键核心技术攻关与产业化落地；《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》专门提出加快发展电子化学品等高端材料，助力战略性新兴产业升级。在资金支持方面，国家集成电路产业投资基金（大基金）三期拟投入 500 亿元推动“材料-设备-晶圆厂”联合研发，重点支持光刻胶、超纯电子化学品等品类的研发与量产，缩短验证周期。

本次募集资金投资项目精准聚焦高端光刻胶及配套树脂、湿电子化学品两大核心品类，产品符合国家产业升级和战略性新兴产业发展方向，可享受相关优惠政策，有效降低项目投资风险和运营成本，为项目实施提供了明确的政策支撑，具备充分的政策可行性。

（2）下游应用领域发展，产品市场空间广阔

当前，全球半导体材料市场在经历 2023 年的周期性回调后，正步入新一轮

增长周期。与此同时，AI 产业的爆发式增长也正从“算力、存储、互联”三维重构半导体材料需求，形成“周期复苏+技术创新”的双重增长引擎，直接驱动半导体材料需求呈现“量价齐升+结构升级”的双重发展空间。

根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的报告，2025 年全球半导体材料市场规模约 730 亿美元，其中，AI 相关需求贡献超 30%增量，成为行业增长的核心驱动力。2026-2030 年预计复合增速达到 8.5%-12%，其中先进封装材料与第三代半导体增速最快。

（3）持续推进产品验证，为项目实施奠定客户基础

作为国内半导体材料领域的领军企业，公司始终专注于关键电子化学品的自主研发与产业化应用。经过多年努力，公司已构建起覆盖半导体全产业链的材料解决方案，在先进封装和晶圆制造等领域，持续推进产品的客户验证。

先进封装领域，公司前瞻性布局先进封装全工艺链条，构建起覆盖硅通孔（TSV）、再布线层（RDL）、微凸点（Bumping）等核心工艺的完整产品矩阵。目前，公司先进封装光刻胶已通过主流客户认证并持续放量，高纯硫酸铜基液也已实现头部客户的稳定供应，另有多项前沿产品已进入商业化关键阶段：电镀锡银添加剂（包括超低 α 粒子的锡浓缩液、锡阳极）小批量生产并在多家头部客户同步验证中；电镀铜添加剂处于关键批次稳定性验证阶段；TSV 电镀添加剂在客户端测试验证中。

晶圆制造领域，公司大马士革电镀铜添加剂覆盖 7-55nm 全制程节点，确保铜互连具有优异的填充能力与低缺陷率，可满足不同客户的工艺需求；针对 5-14nm 节点对互连阻抗和可靠性的更高要求，公司硫酸钴电镀液提供优异的电迁移耐受性与界面稳定性。目前公司 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂，5-14nm 超高纯硫酸钴基液已在主流晶圆客户端小批量供货中，同步在头部存储客户端验证顺利；适应不同深宽比孔型的 TSV 工艺高速镀铜添加剂也在客户端验证中。公司先进封装和晶圆制造领域产品在下游客户持续验证通过，为项目实施奠定客户基础。

（二）补充流动资金项目

补充流动资金主要是为了满足公司业务发展和规模扩张对流动资金的需求。

流动资金的增加将有利于公司正在或即将开发和实施的项目能够顺利推进，同时降低公司的经营风险，增强公司资本实力，有助于增强后续融资能力，拓展发展空间。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度对上述补充流动资金进行管理，根据公司的业务发展需要进行合理运用，对于上述流动资金的使用履行必要的审批程序。

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）

1、项目概述

本项目实施主体为公司全资子公司艾森芯材，项目建设地点位于江苏省南通市经济技术开发区通达路以东，江河路以南。项目投资总额 67,320.00 万元，项目建设面积约 70,030 平方米，旨在打造集光刻胶、光刻胶配套树脂及湿电子化学品研发、生产、检测、销售于一体的高端电子化学品生产基地。

项目建成后，将形成光刻胶及配套树脂、湿电子化学品共计 13,000 吨/年的产能规模。项目建设有助于公司提高光刻胶配套树脂的生产能力，扩大光刻胶、湿电子化学品等高端产品的产能，进一步优化产品结构，为公司先进封装及晶圆领域产品的持续放量奠定坚实基础。

2、项目投资概算

项目投资预算总额为 67,320.00 万元，拟使用募集资金投入 47,400.00 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额		拟使用募集资金金额		是否资本性支出
		金额	占比	金额	占比	
1	土地购置费	5,720.00	8.50%	47,400.00	100.00%	是
2	建筑安装工程费	24,345.32	36.16%			
3	设备购置及安装费	28,300.00	42.04%			
4	固定资产其他费用	2,821.35	4.19%			
5	基本预备费	2,773.33	4.12%	-	-	-

序号	项目	投资金额		拟使用募集资金金额		是否资本性支出
		金额	占比	金额	占比	
6	铺底流动资金	3,360.00	4.99%	-	-	-
合计		67,320.00	100.00%	47,400.00	100.00%	-

3、项目选址及实施主体

公司已与南通市经济技术开发区管委会签署《投资协议》及相关补充协议，项目意向实施用地位于南通市经济技术开发区通达路以东，江河路以南地块，项目规划总用地面积约 158.82 亩（最终以土地招拍挂的土地挂牌面积及不动产权证登记为准）。截至本募集说明书签署日，公司尚未取得本次募投项目用地的土地使用权证书。南通市经济技术开发区管委会已出具说明，明确本项目用地符合国家及省市国土规划相关规定，相关招拍挂程序正在正常推进中，南通市经济技术开发区管委会将积极协助艾森芯材办理土地相关手续，推动本项目尽快开工建设。因此，预计本次募投项目用地取得不存在实质障碍。

4、项目实施进度安排

本项目建设期为 2026 年 7 月-2028 年 9 月，约为 26 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试运行投产等，具体规划进度情况如下：

序号	内容	进度（月）							
		T	T+4	T+8	T+12	T+16	T+20	T+24	T+26
1	项目前期工作	△	△						
2	施工设计		△	△					
3	土建工程			△	△	△	△		
4	设备安装及调试				△	△	△	△	
5	竣工								△

5、项目效益分析

本项目完全达产后，预计每年可实现营业收入 196,567 万元；本项目预计税后内部收益率为 30.12%，税后静态投资回收期为 6.84 年，具有良好的经济效益。

项目效益预测假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入

本项目计算期 12 年，其中建设期为 26 个月，此后为运营期。项目预计 2035 年开始满负荷生产。本项目达产后正常年营业收入（不含税）196,567 万元，运营期内年均营业收入（不含税）138,312 万元。

（2）成本费用

项目生产成本由原辅材料、燃料动力、工资成本及制造费用组成。主要原辅材料费根据产品的消耗量及采购价格进行估算；直接燃料及动力费按生产预计及年度产能进行估算；工资及福利费参考公司历史工资及福利费平均水平及年度人力预算进行估算。固定资产按直线法提取折旧，生产及动力设备按 10 年折旧，残值率为 5%；房屋建筑按 20 年折旧，残值率为 5%；土地使用权按 30 年摊销；其它制造费用、其他管理费、其他研发费用及其他销售费用均参考公司历史年度水平和本项目规模进行计提。

（3）税金及附加

项目缴纳增值税，销项税税率及进项税税率均为 13%，城市维护建设税按应交增值税的 5%计算，教育费附加（含地方教育费附加）按应交增值税的 5%计算。本项目产品销售价格及材料采购价格均按不含税价计算。本项目所得税税率为 25%。

6、立项环评等报批事项

本项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规定，已完成项目备案（备案证号：通开发行审备〔2026〕218 号）及环评批复（批复文号：通开发环复（书）2026062 号）。

（二）补充流动资金项目

1、项目概述

公司拟将本次募集资金中的 4,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司资金需求，降低经营风险，保持公司的核心竞争优势。

2、补充流动资金的必要性

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司营业收入和业务规模取得显著增长，实现营业收入分别为 36,003.93 万元、43,218.84 万元和 59,264.37 万元。随着公

公司业务规模的快速扩张，公司货币资金、应收账款、存货等流动资金需求逐步增加。因此，本次向不特定对象发行可转换公司债券将为公司补充与业务规模相适应的流动资金，有效缓解公司的资金压力，为公司业务持续发展提供保障，实现公司长期持续稳定发展。

同时，公司营运资金得到有效补充，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化，具有必要性。

3、补充流动资金的可行性

（1）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

本次发行募集资金部分用于补充流动资金符合《注册办法》《证券期货法律适用意见第18号》中关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。

（2）公司内部治理规范，内控完善

公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）发行人的实施能力

公司的实施能力具体详见本节之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性”的相关内容。

（二）资金缺口的解决方式

本次募投项目投资总额为67,320.00万元，拟使用募集资金不超过47,400.00万元（含）。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。

五、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系

作为国内半导体材料领域的领军企业，公司始终锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道，通过电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大核心业务板块，为先进制程芯片制造提供关键材料支撑，同时逐步向半导体显示及 IC 载板等高附加值领域延伸。

本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务开展，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”和“补充流动资金项目”。

“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”旨在打造集光刻胶、光刻胶配套树脂及湿电子化学品研发、生产、检测、销售于一体的高端电子化学品生产基地，提升公司在先进封装及晶圆制造领域高端电子化学品的量产能力，强化公司在核心高端材料领域的产能支撑，有助于公司未来业绩的增长。

“补充流动资金项目”有利于改善公司财务状况，降低财务费用，提升公司盈利能力，为公司主营业务发展提供有力资金保障。

六、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性

（一）本次募投项目相关既有业务的发展概况

公司锚定半导体材料产业高端化、国产化、全球化发展趋势，紧扣下游晶圆制造、先进封装客户对先进制程材料的迫切需求，致力于从“单一产品供应商”向“综合材料服务商”战略升级，为客户提供从材料选型到工艺优化的整体解决方案。

本次募投项目整合公司现有技术和项目实践经验，是对公司既有业务进行产业链的延伸拓展。“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”项目精准聚焦高端光刻胶及配套树脂、湿电子化学品两大核心品类，扩大光刻胶、湿电子化学品等高端产品的产能。

本次募投项目与公司当前主营业务方向相符合，是对公司现有业务的产业链延伸与业务拓展，有利于公司巩固行业地位，进一步提升公司的技术水平和生产

制造能力，从而增强公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司“成为全球领先的半导体关键材料供应商”的战略发展目标。

（二）扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性

本次募集资金投资项目精准聚焦高端光刻胶及配套树脂、湿电子化学品两大核心品类，产品符合国家产业升级和战略性新兴产业发展方向，有利于公司进一步扩大光刻胶等高端产品的产能，优化产品结构，巩固和提高公司的市场地位，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力，具有必要性。具体分析详见本节“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性”的相关内容。

七、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C3985 电子专用材料制造”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造（3985 电子专用材料制造）”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司属于“新材料领域”的科技创新企业。

本次募投项目“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”围绕公司主营业务展开，旨在打造集光刻胶、光刻胶配套树脂及湿电子化学品研发、生产、检测、销售于一体的高端电子化学品生产基地，提升公司在先进封装及晶圆制造领域高端电子化学品的量产能力，强化公司在核心高端材料领域的产能支撑，符合国家大力发展电子化学品产业政策的要求。

综上，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向围绕科技创

新领域开展。

（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

自设立以来，公司始终锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道，以技术创新为核心驱动力深耕行业多年。凭借持续高强度的研发投入与关键技术突破，公司已构建起覆盖半导体全产业链的材料解决方案体系，不仅在半导体封装化学品领域成长为国内市场的核心主力供应商，更在晶圆制造领域已实现深度卡位，通过电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大核心业务板块，为先进制程芯片制造提供关键材料支撑，同时逐步向半导体显示及 IC 载板等高附加值领域延伸。目前，公司已成为国内少数具备半导体封装、晶圆制造和半导体显示全链条电子材料供应能力的企业，为我国半导体产业的发展提供关键支撑。

公司锚定半导体材料产业高端化、国产化、全球化发展趋势，紧扣下游晶圆制造、先进封装客户对先进制程材料的迫切需求，制定了未来 5-10 年研发路线图，聚焦光刻胶技术升级、先进制程电镀液突破、高纯试剂等新品类拓展三大核心方向，致力于从“单一产品供应商”向“综合材料服务商”战略升级，为客户提供从材料选型到工艺优化的整体解决方案。

本次募投项目实施完成后，公司将建成高标准的光刻胶配套树脂及湿电子化学品产线，打造集光刻胶、光刻胶配套树脂及湿电子化学品研发、生产、检测、销售于一体的高端电子化学品生产基地。本次募集资金投资项目精准聚焦高端光刻胶及配套树脂、湿电子化学品两大核心品类，扩大光刻胶、湿电子化学品等高端产品的产能，有利于公司进一步扩大光刻胶等高端产品的产能，优化产品结构，进一步强化公司在产品定价、市场份额争夺中的竞争优势，显著提升核心市场竞争力与行业影响力，提升公司的科技创新水平。

八、本次募集资金投资项目的资本化情况

公司本次募集资金投资项目中非资本性支出及其占比情况如下：

单位：万元

项目名称	序号	项目投入构成	投资金额	拟投入募集资金	是否属于资本性支出	其中：资本性投入
电子制造关键材料	1	土地购置费	5,720.00	47,400.00	是	47,400.00
	2	建筑安装工程费	24,345.32			

项目名称	序号	项目投入构成	投资金额	拟投入募集资金	是否属于资本性支出	其中：资本性投入
华东研发和制造基地项目（一期）	3	设备购置及安装费	28,300.00			
	4	固定资产其他费用	2,821.35			
	5	基本预备费	2,773.33	-	-	-
	6	铺底流动资金	3,360.00	-	-	-
	小计		67,320.00	47,400.00	-	47,400.00
补充流动资金项目	1	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	否	-
募投项目合计	非资本性支出合计		4,000.00			
	非资本性支出占比		7.78%			

由上表可见，公司本次募投项目中非资本性支出为 4,000.00 万元，占本次发行拟使用募集资金总额的 7.78%，未超过 30%，符合《注册办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等关于募集资金运用的相关规定。

第八节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

公司于 2023 年 12 月首次公开发行股票并在科创板上市，除此之外，公司最近五年不存在其他募集资金的情形。2023 年首次公开发行股票募集资金的基本情况如下：

经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266 号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 28.03 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户状态
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391064700013000424409	21,076.83	1,655.28	使用中
	苏州银行股份有限公司昆山分行	51433700001579	15,527.35	5,062.32	使用中
	昆山农村商业银行中华园支行	2010020247364	15,527.35	4,614.42	使用中
	宁波银行苏州高新技术产业开发区支行	75050122000714459	5,000.00	-	已注销
合计		-	57,131.54	11,332.02	-

注：上表中截止日余额包括使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额。

二、前次募集资金运用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票的募集资金使用进度如下：

投资项目			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 12,000 吨半导体专用材料项目	年产 12,000 吨半导体专用材料项目	21,076.83	21,076.83	18,592.45	-2,484.38	2024 年 2 月
2	集成电路材料测试中心项目	集成电路材料测试中心项目	45,000.00	28,372.88	20,429.22	-7,943.66	2027 年 12 月
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	5,009.46	9.46	不适用
合计			71,076.83	54,449.71	44,031.13	-10,418.58	-
实际投资金额比例			80.87%				

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金累计投入 44,031.13 万元，前次募集资金使用比例为 80.87%。

（二）前次募集资金变更或项目延期的情况

1、前次募集资金实际投资项目变更的情况

公司前次募集资金不存在变更的情况。

2、前次募集资金投资项目延期的情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“集成电路材料测试中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月。

集成电路测试中心大楼已完工并投入使用，公司已顺利完成多个产品测试平台的仪器配套与调试工作，使用情况良好，延期主要系剩余部分仪器设备，涉及

较多类型的精密设备及仪器，相关设备投资金额大，设备安装与调试周期长，且部分进口设备受到国际贸易摩擦和关税壁垒等外部因素的影响，项目预计无法在原定计划时间内完成全部工作。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额存在差额。其中，“年产12,000吨半导体专用材料项目”已达到预定可使用状态，实际投资额与承诺投资额金额差异系募集资金节余。“集成电路材料测试中心项目”的实际投资总额与承诺投资总额存在差额，原因是该项目尚未实施完毕，尚有部分款项未支付所致。补充流动资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差额，系募集资金账户产生的利息收入与理财收益所致。

（四）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2026年3月31日，公司募集资金投资项目未对外转让。

2、前次募集资金投资项目置换情况

2024年2月5日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计24,975.72万元。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

公司于2023年12月9日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资

金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，对 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 26 日期间公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项进行补充审议通过并同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将继续按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目包括“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”、“集成电路材料测试中心项目”和“补充流动资金项目”。其中，“集成电路材料测试中心项目”的主要内容为建设研发测试中心，购置研发设备，搭建研发测试平台，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。补充流动资金项目为公

司经营活动提供可靠现金流，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”作为公司生产基地，前次募集资金未承诺效益。该项目于 2024 年 2 月达到预定可使用状态，并逐步进行产能爬坡。按照“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”生产产品对外销售产生的经济效益测算，2025 年度和 2026 年一季度，“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”产生的经济效益分别为 5,035.89 万元和 1,590.58 万元。

（七）前次募集资金节余情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”已结项，公司将该项目节余募集资金 2,549.63 万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）用于募投项目“集成电路材料测试中心项目”。

截至 2026 年 3 月 31 日，补充流动资金已使用完毕，集成电路材料测试中心项目仍处于建设期，不存在募集资金节余的情况。

（八）未使用完毕的前次募集资金计划和安排

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金余额 11,332.02 万元（包括累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额），尚未使用募集资金（不含孳息及手续费净额）占前次募集资金净额比例为 19.13%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

公司前次募集资金投资项目包括“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”、“集成电路材料测试中心项目”和“补充流动资金项目”。

“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”有效改善和提升公司自身的工艺与技术水平，进一步扩大公司电子化学品的供应能力，巩固行业龙头位置。

“集成电路材料测试中心项目”可以大幅提高公司产品研发和测试能力，增

强整体研发能力，为未来拟拓展业务进行技术储备，增强公司在行业中的技术领先优势和地位。

“补充流动资金项目”有利于改善财务状况，降低财务费用，提升公司盈利能力，为公司科技创新提供有力资金保障。

综上所述，上述项目均系根据公司业务发展和技术创新需求进行的规划，项目的实施有利于公司进一步扩大业务规模、巩固市场地位，提升研发实力、增强核心竞争力。

四、会计师事务所对前次募集资金运用出具的专项报告结论

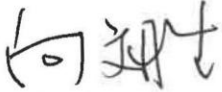
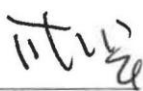
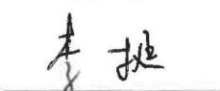
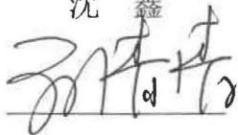
上会会计师于 2026 年 4 月 24 日出具《关于江苏艾森半导体材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（上会师报字（2026）第 8390 号），认为公司编制的截至 2026 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2026 年 3 月 31 日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。

第九节 声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

		
张 兵	向文胜	陈小华
		
杨一伍	沈 鑫	黄晓刚
		
李 挺	孙清清	

除董事外的高级
管理人员：

		
赵建龙	谢立洋	程 瑛
		
吕 敏		


江苏艾森半导体材料股份有限公司
2020 年 8 月 7 日

第九节 声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

张 兵

向文胜

陈小华

杨一伍

沈 鑫

黄晓刚

李 挺

孙清清

除董事外的高级
管理人员：

赵建龙

谢立洋

程 瑛

吕 敏



江苏艾森半导体材料股份有限公司

2026 年 8 月 7 日

二、发行人审计委员会成员声明

本公司全体审计委员会成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会全体
成员：


李 挺


杨一伍


孙清清



江苏艾森半导体材料股份有限公司

2026 年 8 月 7 日

三、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

张 兵

张 兵

实际控制人：

张 兵

张 兵

蔡卡敦

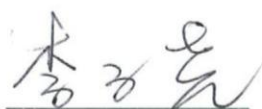
蔡卡敦

2016年8月7日

四、保荐机构声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

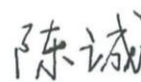


李子尧

保荐代表人：



石 伟



陈 诚

法定代表人（或授权代表）：



江 禹

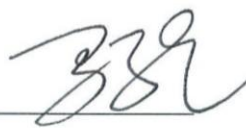
华泰联合证券有限责任公司

2026年8月7日



本人已认真阅读江苏艾森半导体材料股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：


马 骁

保荐机构董事长（或授权代表）：


江 禹

华泰联合证券有限责任公司

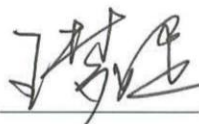
2026年8月7日

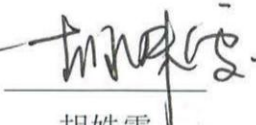


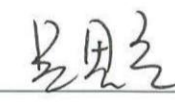
五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书, 确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

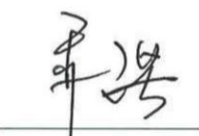
经办律师:


王梦婕


胡姝雯


吴思灵

律师事务所负责人:


李 诺



上海市方达律师事务所

2026年8月7日

六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告(如有)等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告(如有)等文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

耿磊 周思艺

耿磊 周思艺

张扬

会计师事务所负责人:

张晓荣

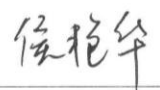
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



信用评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任¹。

资信评级人员（签名）： 
任志娟


侯艳华

评级机构负责人（签字）： 
崔磊

东方金诚国际信用评估有限公司



¹ 募集说明书中引用的评级报告的内容并非是对某种决策的结论或建议，本机构不对任何机构或个人因不当使用评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。

八、董事会声明

本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。


江苏艾森半导体材料股份有限公司

2016 年 8 月 7 日

第十节 备查文件

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- （五）盈利预测报告及其审核报告（如有）；
- （六）拟收购资产的评估报告及有关审核文件（如有）；
- （七）资信评级报告（如有）；
- （八）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
- （九）其他与本次发行有关的重要文件。